

股票代號：3455



一一四年度 年報

本年報查詢網址：(1)公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw/>
(2)本公司網址 <http://www.utechzone.com.tw/>

中 華 民 國 1 1 5 年 4 月 3 0 日 刊 印

■ 發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

<u>發言人</u>	<u>代理發言人</u>
姓名：張文杰	姓名：林慧盆
職稱：總經理	職稱：財會處經理
電話：(02)8226-2088	電話：(02)8226-2088
電子郵件信箱：jack@utechzone.com.tw	電子郵件信箱：fin.acct@utechzone.com.tw

■ 總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司地址	： 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1	電話：(02)8226-2088
南科分公司	： 台南市新市區創業路 16 號 1 樓	電話：(06)505-8989
工廠地址	： 台南市新市區創業路 16 號 1 樓	電話：(06)505-8989
	桃園市平鎮區東勢里東龍街 609 號	電話：(03)450-7799

■ 股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：	台新綜合證券股份有限公司	地址：	台北市中山區建國北路 1 段 96 號地下 1 樓
網址：	http://www.tssco.com.tw/	電話：	(02)2504-8125

■ 最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：楊樹芝會計師、洪士剛會計師
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓 電話：(02) 8101-6666
網址：<http://www.kpmg.com.tw/>

■ 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及其資訊查詢方式：不適用。

■ 公司網址：<http://www.utechzone.com.tw/>

由田新技股份有限公司

一一四年度年報

目錄

壹、致股東報告書-----	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	6
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金-----	11
三、公司治理運作情形-----	14
四、簽證會計師公費資訊-----	43
五、更換會計師資訊-----	43
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會 計師所屬事務所或其關係企業之期間-----	44
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形-----	44
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關 係之資訊-----	45
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數，並合併計算綜合持股比例-----	45
參、募資情形	
一、資本及股份-----	46
二、公司債辦理情形-----	50
三、特別股辦理情形-----	50
四、海外存託憑證辦理情形-----	50
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形-----	50
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	50
七、資金運用計劃執行情形-----	50
肆、營運概況	
一、業務內容-----	51
二、市場及產銷概況-----	86
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均 年齡及學歷分布比率-----	93
四、環保支出資訊-----	93
五、勞資關係-----	93
六、資通安全管理-----	95
七、重要契約-----	96

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況-----	97
二、財務績效-----	97
三、現金流量-----	98
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	98
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫-----	98
六、風險事項分析評估-----	99
七、其他重要事項-----	101
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料-----	101
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	101
三、其他必要補充說明事項-----	101
柒、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項-----	101

壹、致股東報告書

一、114 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	114年度		113年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,675,344	100	1,851,973	100	(176,629)	(10)
營業毛利	901,067	54	1,001,330	54	(100,263)	(10)
營業淨利	129,884	8	190,418	10	(60,534)	(32)
稅前淨利	167,152	10	321,891	17	(154,739)	(48)
稅後淨利	159,912	9	316,558	17	(156,646)	(49)
每股盈餘(元)	2.67		5.29			

(二)預算執行情形：本公司因未對外公開財務預測，故不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

本公司114年度流動比率為239.78%，速動比率為175.67%，顯見償債能力尚屬允當。

2.獲利能力分析

項目		%
獲利能力	資產報酬率	4.15
	權益報酬率	6.11
	稅前純益佔實收資本比率	27.93
	純益率	9.55
	每股盈餘(元)	2.67

(四)研究發展狀況

本公司 114 年主要研發成果如下：

研發成果	
半導體螢光光阻殘留檢測設備	半導體巨觀/微觀/側面檢測設備
半導體 RDL 細線路檢測設備	半導體應力檢測設備
半導體 IR Saw 檢測設備	半導體 CPO 封裝檢測設備
半導體 Particle 檢測設備	半導體複拍檢測設備
半導體3D 量測設備	載板2D+3D 量測設備
半導體各尺寸面板級封裝檢測設備	

二、115 年度營運計劃概要

(一)經營方針

本公司秉持「We serve with vision.」之經營理念，朝向多元領域之機器視覺先進技術的方向研發，以速度、精準及服務為新世代產品持續努力的目標，研製各式符合客戶需求之產品，為股東創造更大利益而努力。

(二)重要之產銷政策

- 1.貫徹中長期之經營策略理念，聚焦於高附加價值之產品，並同時針對現有產品持續優化與精進，以維持公司產品之高競爭力。
- 2.在市場行銷策略面上，採取靈活、多面向的創新思維，隨時掌握外部環境變化並調整適應，透過不同溝通管道及媒介方式強化產品在市場的曝光度及口碑，以深化本公司在自動光學檢測產業的優勢印象。
- 3.致力與各地經銷及代理商發展長遠關係與互惠互榮的合作模式，有效建立大中華地區與東亞地區之地緣關係，強化公司產品銷售與能見度。
- 4.持續強化成本改善力道以創造產品利潤，有效進行供應鏈管理，緊密維繫與合作夥伴、供應商、外包商及相關團體之關係，以達公司、客戶及下游廠商之三贏局面。
- 5.提升客戶服務之廣度與精度，建立暨維持與客戶之間長期合作關係，爭取並深耕客戶群以提高客戶對本公司的依存度，亦藉由擴大市場佔有率與市場滲透率，維持公司每年設定之成長目標。
- 6.有效利用現有研發資源，以自動化光學檢測之核心技術為基礎，提高產品藍圖之拓展性，強化資源配置，主力推動半導體 Wafer 級與 Panel 級各式檢測設備，致力於產品轉型與毛利優化，同時持續針對 IC substrate、COF、LCD…等產品進行升級研究與開發，完整多角化市場佈局。
- 7.有效培養有關視覺、光學、軟體、機械與產品應用之人才，加強產官學研之技術交流合作，提昇創新能量及研發水平。

(三)未來公司發展策略

本公司基於過去所建立的市場、技術與品牌基礎，未來將持續堅守公司的經營理念與方針，專注並致力於自動光學檢測設備的研發精進，以先進高品質的優良產品，輔以完善即時的支援與服務，提供客戶低成本、高效益的全方位專業解決方案，並以不斷創新的精神，開發領先業界、滿足客戶需求的各項產品。

- 1.以利基型產品導入市場，獲取較高利潤。
- 2.現有產品優化升級與新產品開發雙頭並進，穩定利潤並開發營收。
- 3.持續拓展合作夥伴，積極與國內外廠商建立友好合作關係。
- 4.於各地區建立專有服務據點，延伸服務涵蓋範圍，提供即時在地服務。
- 5.建立與執行高標準作業模式，提高各段流程效能，以達產品如期開發、如質生產之綜效。
- 6.培養管理人才與高專業人員，並維持高員工滿意度，以提高工作品質及生產力。
- 7.以客戶滿意為導向，提升服務品質與效率，並成為公司成長的重要利基。
- 8.加強專利與智慧財產權的申請及保護，並提高公司技術屏障。
- 9.善盡企業社會責任，關心弱勢族群，回饋社會公益。

(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1.外部競爭環境

2026年全球AOI（自動光學檢測）市場受AI、高效能運算(HPC)與先進封裝需

求強勁推動，進入高速成長期。AI伺服器與半導體封測（如CoWoS）的高精密度檢測需求，促使AOI設備從傳統SMT向高階AI-AOI轉型。預估2024-2030年複合年增率(CAGR)高達19.03%，2030年市場規模上看29.74億美元。

AOI 市場關鍵趨勢與分析：

- (1)半導體與先進封裝帶動需求：隨著台積電等大廠積極擴產，微凸塊（Micro Bump）、中介層（Interposer）瑕疵檢測需求爆發，推升高端檢測設備市場。
- (2)AI 與邊緣計算(Edge AI)的整合：AOI系統正引入AI技術（即AI-AOI）進行缺陷即時檢測、分類與優化，能顯著降低誤檢率並提升檢測效率。
- (3)市場結構：雖然中低端市場國產化率提高，但高階AOI設備仍由日韓及歐美廠商主導。台廠正加大研發投入，專注高階封裝與PCB應用。
- (4)重點應用領域：半導體封測、AI伺服器、5G設備及高階IC載板。

作為全球製造業重鎮，中國對AOI 檢測的需求斜率最為強勁，特別是中國政府持續推動「中國製造 2025」等政策，鼓勵製造業轉型升級，這給予了智慧 AOI 檢測市場發展的長期利多。預計未來幾年，中國智慧 AOI 檢測市場將保持高速成長。近年來中國大陸本土競爭者林立，帶動產業活化動能，此外，世界級設備廠於技術及資金方面亦為重要的外部競爭因素。隨近年產業併購重組風潮興起，預計AOI領域將呈大者恆大之激烈競爭場面。

本公司三十餘年來深耕自動光學檢測領域，除已於高階IC載板與顯示面板領域站穩領頭，持續鞏固在產業界的優勢地位外，亦於2025年正式轉型為半導體檢測商，高階半導體封測檢測設備營收占比大幅提升，顯見公司不斷增進本身之業務與研發能力、廣化產品涵蓋、開發銷售渠道，以深植於公司文化的服務技術、速度及品質，積極爭取客戶的支持與肯定，開發高利基、高技術含量的差異性商品，誓於高度競爭的同業中脫穎而出。

2.法規環境

主導性新產品計畫、業界科專計畫及研發投資抵減等獎勵措施，可激勵以創新為主的公司開拓新產品。

3.整體經營環境

2025年全球總體經濟呈現「謹慎樂觀」的軟著陸格局，預計成長率在2.7%至3.3% 區間，處於低增速新常態。AI技術應用與科技需求成為主要引擎，通膨放緩推動各國央行降息，但受美國關稅政策、地緣政治衝突及中國經濟放緩影響，成長動能趨緩且面臨顯著下行風險。總體而言，2025年雖然沒有步入衰退，但全球貿易、投資與供應鏈將因貿易保護主義抬頭而面臨巨大變動

2025年台灣經濟在AI與高效能運算(HPC)強勁需求帶動下，表現亮眼。主計總處概估2025年全年經濟成長率高達8.63%，創近15年新高。出口動能強勁且固定資產投資回升，人均GDP更向4萬美元邁進，呈現「外熱內溫」格局，表現優於鄰近南韓與中國。2025年可說是台灣科技製造業榮景的一年，不僅在GDP成長上寫下驚人紀錄，更透過半導體產業穩固了全球供應鏈的核心位置。

綜觀全球半導體產業發展趨勢，地緣政治局勢的加劇，如烏俄戰爭和中美貿易戰，皆導致企業風險不確定性攀升，影響整個半導體生態系。為了分散地緣政治風險，各國紛紛提高供應鏈彈性，生產基地逐漸從中國擴及越南、新加坡、馬來西亞、美國等地，東南亞成為半導體後段製程的擴產重鎮，同時各國強化半導體自主供應鏈，主要國家積極扶植半導體產業，祭出振興政策，形塑產業發展優勢，力圖提升本土產業量能和關鍵技術自主性。2025年產業最大亮點來自先進封裝需求爆發。在AI、高效能運算與資料中心帶動下，採用重布線(RDL)、凸塊

(Bumping)、矽穿孔(TSV)等技術的晶圓級封裝(WLP)、系統級封裝(SiP)及2.5D/3D封裝比重持續增加。先進封裝已成為半導體產業進入後摩爾時代，提升系統效能與整合度的關鍵解方。此外，面板級封裝(Panel Level Packaging)亦逐漸成熟。隨GPU、FPGA等高階晶片尺寸突破60mm以上，傳統晶圓曝光面臨產能與良率限制，面板級封裝因具備更高產出效率與成本優勢而受市場關注。

2025年台灣半導體產業產值預估突破新台幣6.5兆元，成長率高達22.2%，IC製造業(含晶圓代工、封測)是成長最大引擎。AI伺服器、高效能運算與2奈米先進製程為核心動能，台積電持續擴大資本支出，台廠深化AI晶片與先進封裝(CoWoS)技術，維持全球晶圓製造與封測領先地位。同時產業積極投入CPO(矽光子)等新興技術，並強化IC設計向「硬體+軟體」整合服務模式轉型，並因應地緣政治與客戶需求，台廠加速海外產能佈局(如日本、美國、德國)，但維持台灣仍為2奈米最先進製程的首發量產地，保留技術優勢，使台灣可持續站在半導體產業領頭。2026年台灣半導體資本支出由台積電領軍，預估資本支出將介於520億至560億美元之間，其中約70%至80%用於先進製程，10%至20%用於先進封裝、特殊製程與光罩，整體較2025年的409億美元大幅增長，創下歷史新高，同時也顯示高階半導體技術的投資門檻持續提高。

本公司自2018年即開始布局半導體檢測，近年產品研發及轉型有成，以多元光學優勢推出各式產品，包含以專利螢光對應黃光製程精密線路及殘留檢出、以IR光檢測切割後之內部隱崩等缺陷、結合巨觀/微觀與多元分析工具提供獨創OM檢測，目前本公司產品線可完整對應晶圓級、面板級、玻璃TGV、以及封裝後的單顆檢測，隨著不斷廣化檢測站點及強攻高階封裝領域，半導體業務呈多點開花，新品開發屢獲突破。除黃光段RDL檢測設備已成功打入黃光製程應用，打破國外大廠壟斷局面外，自動巨觀及微觀檢測設備亦取得重大進展。此外，本公司更成為台廠首家取得面板級封裝(FOPLP)檢測設備訂單的廠商，為進一步廣化產品線，公司近期開發客製化In-situ模組，可搭配既有AOI設備，不僅精簡占地更提升檢出效能。

長期來看，隨著各應用領域半導體含量的提升，將有利於相關設備持續放量。本公司整體在先進封裝領域的耕耘已收成效，多樣設備完成完整客戶認證，並為台系檢測設備首位完成百萬片晶圓檢測里程碑，預期技術及業務優勢將持續發酵擴展，目前本公司不僅已斬獲兩岸一線封測大廠訂單，於東南亞亦佈局有成，2025年半導體營收占比已近五成，顯見公司正式轉型為半導體檢測設備商，同時公司不斷優化產品精度與解析度，將從微米級進入到奈米級，不僅箭指半導體封測廠，預期更可於前段晶圓廠有所斬獲，目前多樣高階方案與客戶密切接觸中，2026將成半導體營收發酵元年。

除半導體產業外，本公司另一重要基石為載板相關檢測設備。2025年載板產業走出2023-2024年的低潮期，台廠欣興、景碩、南電等營運迎來復甦，資本支出提升。展望2026年，預期將因AI伺服器、高效能運算與特殊應用晶片需求爆發，進入十年一遇的高成長期。高階ABF與BT載板持續呈現量價齊揚。本公司以長期積累的專業精密檢測know how穩站載板檢測領頭，除原本長期服務之台系主要客戶外，亦持續收穫中國新投入高階製程之客戶訂單，新舊客戶加持下，將穩步推升公司技術量能，公司樂觀看待載板市場復甦燈號。另一部分，公司原已於面板檢測具領先優勢，為業界惟一完成完整布局、可避免單一產業波動造成偏廢之設備商。近年顯示器檢測設備雖因整體產業景氣循環而調降營收占比，但受惠於削價競爭態勢減弱，相關顯示器設備毛利率可望顯著拉抬。公司掌握中國少數LCD前段擴廠需求，同時積極掌握改造升級商機、另以點燈設備成功打入高階車載面板檢測，公司持續觀望面板產業景氣，把持技術優勢並隨時勢進行調整布局，目

標以高利基設備避免過往削價競爭態勢，穩步提升公司毛利率。

由田自1992年成立以來，三十餘年專精於自動光學檢測設備之研發與推動，提供高效高速的精準檢測以提升產品品質，致力於協助客戶導入智慧化生產解決方案。並推出AI深度學習系統，可有效降低人力成本、減少人工複判、成功縮短檢測時間，並以多元化產品線平衡各產業波動。本公司近年在產品組合優化調整下，半導體、高階載板、PCB、顯示器各領域設備營收占比持續動態調整，2026年除持續廣化產業涵蓋及深化產業植基外，另因應東南亞產業聚落逐漸形成，公司穩步布局大中華區域外之銷售能量，中長期成長值得期待。

由田新技股份有限公司

董事長：鄒嘉駿



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

1.董事之姓名、性別、年齡、國籍或註冊地、主要經(學)歷、持有股份及性質

115年4月26日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人		
							股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	鄒嘉驥	男 61~70 歲	112/6/16	3年	81/5/23	2,112,881	3.53	1,112,881	1.85	422,009	0.70	1,004,000	1.67	交通大學 計算機工程系	本公司執行長 UTECHZONE GLOBAL CORP.董事 EVERVISION GLOBAL(SAMOA)CO.,LTD.董事 科吉凱亞(股)公司董事長 宙福投資(股)公司董事長 由田信息技術(上海)有限公司執行董事 Utechzone 株式會社代表取締役 蘇州井則田科技股份有限公司執行董事 瑞泉文嘉股份有限公司董事長	無	無	無
董事	中華民國	張文杰	男 51~60 歲	112/6/16	3年	84/10/26	1,324,616	2.21	724,616	1.21	—	—	600,000	1.00	實踐大學 企業創新與創 業管理研究所 肄業	本公司總經理 科吉凱亞(股)公司董事 宙福投資(股)公司董事 Utechzone 株式會社取締役	無	無	無
董事	中華民國	林芳隆	男 61~70 歲	112/6/16	3年	89/4/19	1,245,207	2.08	644,207	1.07	23,821	0.03	700,000	1.16	中山大學 企研所	宙福投資(股)公司監察人 佳測新技(股)公司監察人	無	無	無
董事	中華民國	葉惠德	男 71~80 歲	112/6/16	3年	100/6/21	616,151	1.03	1,016,151	1.69	—	—	—	—	逢甲大學 電子計算機 科學系	國福欣欣(上海)實業有限公司董事長 龍德投資有限公司董事長 惠晶生物科技(股)公司董事 列特博生技(股)公司董事	無	無	無
獨立 董事	中華民國	丘邦翰	男 61~70 歲	112/6/16	3年	94/5/12	—	—	—	—	—	—	—	—	中山大學 企管博士	元智大學副教授兼數位金融學群召集人	無	無	無
獨立 董事	中華民國	呂英誠	男 61~70 歲	112/6/16	3年	94/5/12	—	—	—	—	—	—	—	—	美國德州大學 達拉斯分校 電機博士	明安國際企業(股)公司副總經理	無	無	無
獨立 董事	中華民國	蔡熊光	男 61~70 歲	112/6/16	3年	109/6/17	—	—	—	—	—	—	—	—	臺灣大學電機 工程學研究所 博士	—	無	無	無
獨立 董事	中華民國	端木玉	女 61~70 歲	114/6/25	註	114/6/25	—	—	—	—	—	—	—	—	伊利諾大學香 檳分校會計研 究所	—	無	無	無

註：於114年6月25日股東常會當選後即就任，任期與本屆董事會相同。

2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

115 年 4 月 26 日

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
鄒嘉駿	鄒嘉駿董事長具有五年以上公司業務所需之工作經驗，現任本公司董事長兼執行長，致力於檢測設備領域逾30年經歷，擁有營運管理、策略規劃、研發能力，且兼具專業市場競爭判斷力及創新領導力。 未有公司法第30條各款情事。	不適用	無
張文杰	張文杰董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，現任本公司總經理，致力於檢測設備領域逾30年經歷，擁有豐富之市場策略及業務推廣之產業經驗。 未有公司法第30條各款情事。		無
林芳隆	林芳隆董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾擔任本公司行政財務部副總，具有超過30年產業經歷，熟悉本公司組織運作，具備行政管理、財務規劃等經驗。 未有公司法第30條各款情事。		無
葉惠德	葉惠德董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有超過40年產業經歷，深具國際觀且熟悉兩岸區域經濟與市場，適時提供公司建言，推動企業永續經營。 未有公司法第30條各款情事。		無
丘邦翰	丘邦翰獨立董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，擁有中山大學企管博士學位，現任元智大學管理學院副教授兼任數位金融學群召集人，專精於財務管理、區塊鏈金融、機械學習及金融風險管理等領域。 未有公司法第30條各款情事。	本公司獨立董事均符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第一項之規定。	無
呂英誠	呂英誠獨立董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人，現任明安國際企業(股)公司副總經理，擁有美國德州大學達拉斯分校電機博士學位，具有電機工程專業知識，並擅長企業領導、營運判斷與管理。 未有公司法第30條各款情事。		無
蔡熊光	蔡熊光獨立董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具有超過30年產業經歷，擁有臺灣大學電機工程學研究所博士學位，具備電機工程專業知識、產業發展與營運管理經驗。 未有公司法第30條各款情事。		無
端木玉	端木玉獨立董事具有五年以上公司業務所需之工作經驗，擁有伊利諾大學香檳分校會計研究所碩士學位，曾任上市櫃公司會計主管，具有會計或財務專長，並擅長經營管理、會計財務等實務。 未有公司法第30條各款情事。		無

3.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化：

本公司訂有「公司治理實務守則」及「董事選任程序」，要求董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，除基本條件與價值：性別、年齡、國籍以外，亦包含專業背景，如行銷、財務會計、科技專長及產業經驗。另要求董事會整體應具備之能力如下：營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

目前本公司個別董事落實董事會成員多元化政策情形如下：

多元化 核心 董事 姓名	基本組成									專業背景				專業知識與技能							
	國籍	性別	具有 員工 身分	年齡			獨立董事任期年資			行銷	財務 會計	科技 專長	產業 經驗	營業 判斷	會計 財務	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 能力	決策 能力
				51 至 60	61 至 70	71 至 80	3年 以下	3年 至 9年	9年 以上												
鄒嘉駿	中 華 民 國	男	✓		✓							✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
張文杰		男	✓	✓						✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
林芳隆		男			✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉惠德		男				✓							✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
丘邦翰		男			✓				✓		✓			✓			✓		✓		✓
呂英誠		男			✓				✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡熊光		男			✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
端木玉		女			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

目前本公司董事會因分別於各自領域之專業知識與技能皆具豐富經驗，且對本公司各項營運適時提供重要建言，故任一性別董事席次未達三分之一，目前本公司董事會成員中有一位女性董事，未來本公司將依性別平等之原則，擬規畫增加不同性別之董事達董事席次三分之一，以落實董事成員多元化政策。

(2)董事會獨立性：

本公司設有獨立董事四席，占董事成員比重50%，四位獨立董事中呂英誠董事及丘邦翰董事已擔任本公司獨立董事連續達三屆，惟兩位獨立董事分別於產業業務研發專業領域及財務會計專業領域皆具豐富經驗，皆能為本公司各項營運或財務面向提供重要建言。雖已連任本公司三屆以上之獨立董事，然對公司歷年董事會議程之各項討論內容相當熟捻，本公司仍需持續借重其專業之處，給予董事會監督並提供各式專業意見。本公司獨立董事皆符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事皆無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115 年 4 月 26 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例%	股數	持股比例%	股數	持股比例%			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	鄒嘉駿	男	102/04/16	1,112,881	1.85	422,009	0.70	1,004,000	1.67	交通大學計算機工程系	(註 1)	—	—	—	(註 3)
總經理	中華民國	張文杰	男	94/05/12	724,616	1.21	—	—	600,000	1.00	實踐大學企業創新與創業管理研究所肄業	(註 2)	—	—	—	
業務本分管理副總	中華民國	邱彥博	男	114/03/11	—	—	—	—	—	—	澳洲昆士蘭科技大學資訊工程系 艾慕思生物科技國外業務	無	—	—	—	
檢量技術部本分管理副總	中華民國	林伯聰	男	114/03/11	21,801	0.03	—	—	—	—	元智大學工業工程所	無	—	—	—	
自控技術部本分管理副總	中華民國	王人傑	男	114/03/11	—	—	—	—	—	—	臺灣科技大學工業管理科學及技術系 晉速科技工程師	無	—	—	—	
檢量技術部本分管理副總	中華民國	廖佐華	男	114/03/11	—	—	—	—	—	—	義守大學資訊管理所 欣技科技軟體工程師	無	—	—	—	
業務本分管理副總	中華民國	葉丁源	男	114/03/11	50,640	0.08	100	0.00	890,000	1.48	交通大學資訊工程所 中華電信研究所副研究員	無	—	—	—	
業務本分管理副總	中華民國	陳健銘	男	114/03/11	673	0.00	—	—	—	—	華夏工商專科學校 電機工程科 志聖工業經理	上海星朋晶信息技術有限公司董事	—	—	—	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份	配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	備註
運管部 本分管理	中華民國	蔡茂岳	男	109/01/01	36,946 0.06	50 0.00	—	元智大學工業工程所 集星達數位科技副理	科吉凱亞(股)有限公司董事 宙福投資(股)公司董事 Utechzone 株式會社取締役 學文科技(股)公司監察人	—	—
財務主管 會計主管	中華民國	林慧盆	女	110/04/01	1,000 0.00	—	—	東吳大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所副理	無	—	—
稽核主管	中華民國	許玉潔	女	107/06/28	—	—	—	淡江大學會計系 彥臣生技(股)公司稽核主管	無	—	—

註 1：UTECHZONE GLOBAL CORP. 董事、EVERVISION GLOBAL(SAMOA) CO., LTD. 董事、科吉凱亞(股)公司董事長、宙福投資(股)公司董事長、由田信息技術(上海)有限公司執行董事、Utechzone 株式會社代表取締役、蘇州井則田科技有限公司執行董事、瑞泉文嘉股份有限公司董事長

註 2：科吉凱亞(股)公司董事、宙福投資(股)公司董事、Utechzone 株式會社取締役

註 3：本公司董事長兼任執行長，係為提升經營效率及決策執行力；此外，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況及計畫方針落實公司治理，本公司以設置四席獨立董事之方式提升董事會職能及強化監督功能。目前本公司已有下列具體措施：

- 1.現任四席獨立董事分別在財務會計與產業業務研發專業領域學有專精，能有效發揮其監督職能。
- 2.本公司依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會，強化董事會監督功能，且本公司之半數董事未兼任經理人。
- 3.每年度安排各董事參加證基會等外部機構專業董事課程，以增進董事會之運作效能。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金
(一)一般董事及獨立董事之酬金

114 年度 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)	兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)				領有來自國外資產報酬之董事				
		報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬金(C)			業務執行費用(D)	薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)	員工酬勞(G)(註1)		本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		
				本公司	財務報告內所有公司			本公司	財務報告內所有公司		現金金額	股票金額						現金金額	股票金額
董事長	鄒嘉駿	—	—	1,178	30	30	1,208 0.76%	13,717	—	—	—	—	14,925 9.33%	14,925 9.33%	無				
董事	張文杰	—	—	1,178	30	30	1,208 0.76%	11,603	—	—	—	—	12,811 8.01%	12,811 8.01%	無				
董事	林芳隆	—	—	620	30	30	650 0.41%	—	—	—	—	—	650 0.41%	650 0.41%	無				
董事	葉惠德	—	—	620	30	30	650 0.41%	—	—	—	—	—	650 0.41%	650 0.41%	無				
獨立董事	呂英誠	—	—	620	72	72	692 0.43%	—	—	—	—	—	692 0.43%	692 0.43%	無				
獨立董事	丘邦翰	—	—	620	72	72	692 0.43%	—	—	—	—	—	692 0.43%	692 0.43%	無				
獨立董事	蔡熊光	—	—	620	72	72	692 0.43%	—	—	—	—	—	692 0.43%	692 0.43%	無				
獨立董事	端木玉	—	—	310	30	30	340 0.21%	—	—	—	—	—	340 0.21%	340 0.21%	無				

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司給付獨立董事酬金包含董事酬勞及車馬費。董事酬勞依本公司章程所訂，如有獲利提撥不高於百分之三為董事酬勞，其訂定之程序請參考註2說明，經董事會決議通過後提報股東會；車馬費係參考同業水準，依董事會出席董事會及隸屬董事會下之功能性委員會情況支付。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

註1：依113年度實際取得員工酬勞比例原則計算114年度擬議分派金額。

註2：本公司給付董事酬金包含董事酬勞及車馬費。董事酬勞依本公司章程所訂，如有獲利提撥不高於百分之三為董事酬勞，其訂定之程序，除參考整體營運績效，並參酌各董事對本公司績效貢獻度，含對營運參與之程度及個別績效表現(包含公司核心價值之實現、董事職責之實踐、決策品質之提升及董事之專業與進修等)，經董事會決議通過後提報股東會；車馬費係參考同業水準，依董事會出席董事會及隸屬董事會下之功能性委員會情況支付。董事兼任員工之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任及公司獲利狀況等因素，並考量對公司績效貢獻度及個別績效表現(包含公司目標及任務之掌握及內部關係經營與溝通等)，經薪資報酬委員會審核，董事會通過後執行。

(二)總經理及副總經理之酬金

114 年度 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (註 1)				A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅後純 益之比例(%)		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
執行長	鄒嘉駿													
總經理	張文杰													
業務部	邱彥博													
本部分管副總		26,250	26,250	324	324	22,721	22,721	—	—	—	49,295 30.83%	49,295 30.83%		無
檢量技術部	林伯聰													
本部分管副總														
自控技術部	王人傑													
本部分管副總														

註1：依113年度實際取得員工酬勞比例原則計算114年度擬議分派金額。

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	—	—
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	—	—
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	—	—
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	邱彥博、林伯聰、王人傑	
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	鄒嘉駿、張文杰	
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	5	5

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年度 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額(註)	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	鄒嘉駿	—	—	—	—
	總經理	張文杰				
	業務部 本部分管副總	邱彥博				
	檢量技術部 本部分管副總	林伯聰				
	自控技術部 本部分管副總	王人傑				
	業務部 本部分管協理	葉丁源				
	業務部 本部分管協理/地區總經理	陳健銘				
	檢量技術部 本部分管協理	廖佐華				
	運管部 本部分管協理	蔡茂岳				
	財會處 本部分管經理	林慧盆				

註 1：依 113 年度實際取得員工酬勞比例原則計算 114 年度擬議分派金額。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

職稱	酬金總額占稅後純益比例(%)			
	114 年度		113 年度	
	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司
董事	19.66	19.66	10.14	10.14
總經理及副總經理	30.83	30.83	6.53	6.53

依本公司公司章程第 29 條規定，依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有盈餘應提撥員工酬勞百分之五~十五及董事酬勞不高於百分之三。本公司給付董事酬金，係授權董事會按同業通常水準議定之，並考量公司營運成果，參酌其對公司貢獻度，給予合理報酬；而個別董事酬勞及經理人之酬金給付程序，除參考整體營運績效，並參酌個別董事酬勞對本公司績效貢獻度，含對營運參與之程度及個別績效表現(包含公司核心價值之實現、董事職責之實踐、決策品質之提升及董事之專業與進修等)，經董事會決議通過後提報股東會；個別經理人之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，係依所擔任之職位、所承擔之責任及公司獲利狀況等因素，並考量對公司績效貢獻度及個別績效表現(包含公司目標及任務之掌握及內部關係經營與溝通等)，相關績效考核及年度薪資調整皆經薪酬委員會討論決議再送交董事會同意通過。本公司亦將視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

本公司經營管理階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之；重要決策之績效將反映於公司獲利情形，亦即其薪酬與未來風險控管績效相關。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託 出席次數	實際出 (列)席率(%)	備註
董事長	鄒嘉駿	5	0	100%	—
董事	張文杰	5	0	100%	—
董事	林芳隆	5	0	100%	—
董事	葉惠德	5	0	100%	—
獨立董事	丘邦翰	5	0	100%	—
獨立董事	呂英誠	5	0	100%	—
獨立董事	蔡熊光	5	0	100%	—
獨立董事	端木玉	3	0	100%	—

最近年度各次董事會獨立董事出席情形：

◎：親自出席；★：委託出席；*：未出席

114 年度	3 月 11 日	5 月 12 日	6 月 25 日	8 月 13 日	11 月 12 日
丘邦翰	◎	◎	◎	◎	◎
呂英誠	◎	◎	◎	◎	◎
蔡熊光	◎	◎	◎	◎	◎
端木玉			◎	◎	◎

其他應記載事項：

- 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司設置審計委員會，故不適用。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

- 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
鄒嘉駿 張文杰	案由： 本公司薪資報酬委員會 審議經理人 114 年度年終 獎金核發案。	與董事自身有利 害關係	不參與表決	114 年第 5 次
鄒嘉駿 張文杰	案由： 本公司薪資報酬委員會 審議經理人 115 年度薪資 調整案。	與董事自身有利 害關係	不參與表決	114 年第 5 次

- 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

(1)本公司於 108 年 10 月 17 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，明訂每年應執行內部董事會績效評估，並應於次一年度第一季結束前完成，另董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

(2)本年度執行情形請詳下表，評估結果已於 115 年 3 月 12 日提報本公司董事會：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估(包含審計委員會、薪資報酬委員會)。	董事會內部自評、董事成員自評	1.董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。 2.董事成員自我績效評估之衡量項目包括下列六大面向： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。 3.功能性委員會績效評估之衡量項目包括下列五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)提升功能性委員會決策品質。 (4)功能性委員會組成及成員選任。 (5)內部控制。	1.整體董事會：評估結果為符合標準，顯示董事會有善盡管理及監督公司各項經營策略、重大業務及風險評估之責任，並能建立及監督內部控制制度之有效性，整體運作情形完善，尚符合公司治理之要求。 2.個別董事成員：評估結果為超越標準，顯示本公司董事對於各項指標之效率及效果皆為正向評價。 3.審計委員會：評估結果為超越標準，顯示審計委員會整體運作情形完善，尚符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。 4.薪資報酬委員會：評估結果為超越標準，顯示薪資報酬委員會整體運作情形完善，尚符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估

(1)加強董事會職能

- A.本公司董事會之運作皆依董事會議事規範辦理。
- B.本公司本屆董事係於 112 年 6 月 16 日選任，公司董事間均未具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- C.本公司董事會成員於任期中參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之進修課程。
- D.本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，藉以發揮監督職責，達到加強董事會職能之目標，各委員會主席並定期向董事會報告運作情形。
- E.本公司 114 年度向國泰世紀產物保險股份有限公司投保美金 8,000 仟元之董事及經理人責任險。

(2)提昇資訊透明度等

- A.本公司及子公司之財務報表，均委託安侯建業聯合會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，以確保各項重大資訊能及時

允當揭露

B.本公司所架設網站可連結至公開資訊觀測站，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

(二)審計委員會運作情形

本屆審計委員會委員任期為 112 年 6 月 16 日至 115 年 6 月 15 日，最近年度審計委員會開會 4 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
獨立董事	丘邦翰	4	0	100%	
獨立董事	呂英誠	4	0	100%	
獨立董事	蔡熊光	4	0	100%	
獨立董事	端木玉	2	0	100%	

其他應記載事項：

- 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

開會日期	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114/03/11	本公司113年度內部控制制度聲明書	委員會全體成員照案通過	提請董事會決議
	本公司113年度財務報表案		
	本公司113年度營業報告書案		
	本公司113年度盈餘分派表案		
	資本公積發放現金案		
	修訂本公司「公司章程」案		
	修訂本公司「薪工循環」案		
	修訂本公司「審計委員會組織規程」案		
	修訂本公司「董事會議事規範」案		
	本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則案		
	本公司配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師		
114/05/12	民國114年度第1季合併財務報告案	委員會全體成員照案通過	提請董事會決議
	辦理現金增資私募普通股案		
	現金增資私募普通股終止案		
114/08/13	民國114年度第2季合併財務報告案		
	本公司114年度會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案		
114/11/12	民國114年度第3季合併財務報告案		
	訂定民國115年度稽核計畫		
	本公司風險管理運作情形		

- 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

- 2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
- 3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：

本公司內部稽核主管定期向獨立董事呈報稽核報告；會計師不定期參與審計委員會就會計師查核事項、本公司財務狀況及近期重要法令之更新進行溝通，必要時獨立董事亦得隨時與會計師召集會議。除上所述，平時稽核主管及會計師亦得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

114 年度獨立董事對會計師與內部稽核主管溝通情形摘要。

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
114/03/11	例行報告	會計師 2024 年第四季與公司治理單位溝通報告
114/08/13	例行報告	會計師 2025 年第二季與公司治理單位溝通報告
114/11/12	例行報告	會計師 2025 年第三季與公司治理單位溝通報告 會計師與獨立董事單獨溝通年度查核規劃

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公司網站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		為確保股東權益，本公司設有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項，且建立發言人及代理發言人制度與投資關係，並設有投資人電子郵件信箱處理股東建議或意見等問題。	無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司設有股務專責人員，管理相關資訊並委任股務代理機構協助辦理股務相關事宜，以掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之變動情形。	無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		本公司與關係企業間有財務、業務往來時，皆依「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」規定辦理。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		1.本公司訂有「公司治理實務守則」及「董事選任程序」，要求董事會成員組成應考量多元化，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、專業背景、技能及產業經歷。 2.本公司注重董事會成員多元化，現任8席董事中，學歷包含電機領域、企業管理領域、財務會計、企業創新與創業管理領域等，其中每位董事的專業背景亦有不同。公司之多元化目標為：領域多元化，要求董事於專業知識與技能上應涵蓋四項以上，且至少一席董事具備財務會計能力，目前達成情形如下：於營運判斷、領導決策、經營管理且具產業知識者，有鄒嘉駿、張文杰、林芳隆、葉惠德、呂英誠及蔡熊光董事；張文杰董事亦具行銷經驗；邱邦翰、林芳隆及端木玉董事則長於財務領域，據此，足表示目前董事於學歷與專長多元化及互補。 3.個別董事落實董事會成員多元化政策情形請參閱第8頁董事會多元化及獨立性說明。	無重大差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	本公司目前僅依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，相關組織規程均經董事會決議通過，惟並未設置其他各類功能性委員會。	尚於評估設置其他功能性委員會之階段

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		1.本公司於108年10月17日董事會通過「董事會績效評估辦法」，明訂每年應執行內部董事會績效評估，並應於次一年度第一季結束前完成，另董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。 2.本年度執行情形請參閱第14~15頁董事會運作情形，評估結果已於115年03月12日提報本公司董事會。	無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司每年定時檢視會計師之獨立性與適任性，針對簽證會計師之財務利益、融資及保證、商業關係、親屬關係、聘僱關係等面向評估，並取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書。本公司同時亦參考審計品質指標(AQIs)，針對專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等五大構面及十三項指標，逐一評估聘任會計師之適任性。並將結果提報114年8月13日審計委員會及114年8月13日董事會審議並通過。經本公司評估安侯建業聯合事務所楊樹芝會計師及洪士剛會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，會計師並出具聲明函，詳細評估報告請參閱第42~43頁。	無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已於112年5月11日設置公司治理主管，提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等，及負責統籌公司治理相關事務推動與執行。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司設有中、英文網站，建置相關公司治理、財務業務及股東專區等資訊並隨時更新揭露，提供利害關係人參考；並設置專責人員妥適回應利害關係人所關切之相關議題。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任台新綜合證券(股)公司之股務代理機構協助辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		本公司已於公司網站之投資人服務專區揭露財務業務及公司治理相關資訊。	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		本公司設有中、英文網站，且設置發言人及代理發言人各一名，並由專人負責公司各類資訊之蒐集及揭露，並適時更新於公司網站。	無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	本公司於法定限期內公告並申報年度財務報告，並於規定限期前公告申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進	✓		(一)員工權益與僱員關懷： 本公司向來秉持穩健、永續之經營理念，對員工福利極其重視，每月依法提撥福利金，安排各項促進員工身心健康之活動，如員工聚餐、年度健康檢查、旅遊經費補助、提供婚喪喜慶慰助金、團體壽險及意外險等福利事	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?			項。另本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，組成勞工退休準備金監督委員會，依每月薪資總額一定比率提撥勞工退休準備金儲存於台灣銀行專戶中，以充作未來支付職工退休準備金之用。依勞工退休金條例，自94年7月1日起，每月按不低於薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。本公司有關勞資關係之一切規定措施，均依相關法令，實施情形良好。 (二)投資者關係： 本公司秉持公平公開原則對待所有股東，在股東會方面，每年依公司法及相關法令之規定召集股東會，鼓勵股東積極參與股東會之董事選舉或修改公司章程等議案，並將取得處分資產、背書保證等重大財務業務行為提報股東會，本公司亦給予股東充分發問或提案之機會，俾達制衡之效並依法訂定股東會議事規則，妥善保存股東會議事錄及於公開資訊觀測站上充分揭露相關資料。另本公司為確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利，設有發言人及代理發言人之職務，妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。 本公司自93年度公開發行及96年股票上櫃以來，本著資訊公開原則，依公開發行公司應公告或申報事項一覽表及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序有關資訊揭露之規定辦理資訊公開事宜，並建立公開資訊之網路申報作業，指定財會處專門人員負責公司資訊之蒐集及揭露工作，經相關權責主管審核確認後，辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務 守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(三)供應商關係： 本公司與供應商之關係良好，亦不定期對供應商進行評鑑，以確保其品質。 (四)利害關係人之權利： 本公司對於往來銀行定期提供財務資訊，以利往來銀行對本公司之融資作出判斷及進行決策。本公司與關係企業間並無共同使用貸款額度，且已訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」，並經董事會通過。 (五)董事進修之情形： 本公司董事均依規定進修與公司治理主題相關課程。114年度董事進修情形請參閱第42頁董事進修之情形。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司內部控制制度及必要之管理規章皆經董事會或股東會決議。 (七)客戶政策之執行情形： 與客戶溝通之情形良好，且本公司有專業客服人員可適時機動性將客戶提出之需求予以滿足，故產品已有良好迅速之售後維護服務，且內控中設有完善之客訴處理作業。 (八)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司於94年5月12日經股東常會決議通過將購買董監責任險納入公司章程，114年度係向國泰世紀產物保險股份有限公司投保美金8,000仟元之董事及經理人責任險。 (九)資訊安全風險管理： 為提升公司資訊安全管理，已於資管處下設置資安課，負責制定資安治理政策，監督資安管理運作情形，並定期向管理階層報告資安治理情況。 於資安風險控管上，本公司已建立並落實資訊安全管理系統，訂定資訊安全政策規範公司資訊安全相關作業，同時每年定期進行資訊安全風險評估及資訊安全稽核作業，以確保管理有效性並符合法令規範，故資安風險非	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			屬本公司重大營運風險，暫無投保資安險之需求。	
九、請就台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司於民國114年第十二屆公司治理評鑑中，排名列在36%至50%內，顯示本公司對於各項公司治理機制之重視。針對本公司部分尚未得分項目，將於115年度陸續執行，以期符合公司治理精神。				

(四)薪資報酬委員會組成及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
召集人 獨立董事 呂英誠	請參閱第7頁附表一董事資料「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」表格		無
獨立董事 丘邦翰			無
獨立董事 蔡熊光			無

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)組成：本公司於100年12月26日由董事會通過設置薪酬委員會，其成員由董事會決議委任之，委員計三人，均為本公司獨立董事，相關人選資格皆符合法令規定之規範。

(2)職責：主要職責如下，並將所提建議提交董事會討論。

A.訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(3)運作情形

本屆薪酬委員會委員任期為112年6月16日至115年6月15日，最近年度已開會3次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託 出席次數	實際出 (列)席率(%)	備註
召集人	丘邦翰	3	0	100%	
委員	呂英誠	3	0	100%	
委員	蔡熊光	3	0	100%	

3.其他應記載事項：

(1)近年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理

薪資報酬委員會日期	薪資報酬委員會期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
114/03/11	114年第1次	113年度董事及員工酬勞總額案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		113年度董事酬勞分配案		
		新任及晉升之經理人薪酬案		
114/08/13	114年第2次	本公司擬實施員工持股信託計畫暨本公司經理人參與該計畫之公司提撥獎勵金案		
114/11/12	114年第3次	本公司經理人114年度年終獎金核發案		
		本公司經理人115年度薪資調整案		

(2)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。

(3)薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司為有效推動企業永續發展，由運管部兼職統籌本公司推動永續發展作業，就企業永續發展重大性原則，進行重要議題之相關評估，依據評估後之結果，訂定策略及目標，並每年定期向董事會報告推動成果，由董事會評估政策及執行情形是否符合目標，並至少一年一次向董事會報告執行成果(於114年11月12日向董事會報告)，由董事會監督及審視公司執行情形是否符合目標。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司風險評估邊界包含本公司、由田信息技術(上海)有限公司及其他子公司。本公司秉持在追求企業永續發展與獲利的同時，持續推動企業永續發展，重視利害關係人之權益，注重環境、社會與公司治理之議題，並依照重大性原	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明			
			則，進行重要議題之相關風險評估，訂定相關風險管理政策或策略如下：			
			重大議題	風險評估項目		風險管理政策或策略
			治理面向	資訊安全		已於 2022 年11 月取得資訊安全管理系統國際標準 ISO/IEC 27001：2013 驗證，每三年會執行證書重新驗證的程序，目前證書有效期至 2028 年 8 月 10 日。
				創新管理		為保護公司營運自由、強化產業領導地位，並維護先進技術成果，截至2025年底，本公司全球專利申請總數已累計1,009件，全球專利核准數已累計563件，加強保護智慧財產權。
				法規遵循		2023年3月新增「法規鑑別管理程序」辦法，開始定期評估公司制度規章的適法性，已於2025年6月完成法規鑑別程序。
			環境面向	永續供應鏈管理		制定「供應商企業社會責任承諾書」，由供應商夥伴閱讀、瞭解並簽署確認，企業社會責任承諾書回收率達100%。。承諾書內容包括誠信經營、勞工權益與人權、健康安全、環境保護等四個面向，期與供應鏈合作夥伴共同成長，建立永續夥伴關係，一同致力於企業社會責任之落實。
氣候與能源	1.本公司已依時程規劃於 2024 年底前完成					

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
				溫室氣體盤查專(兼)職單位與人員之設置。相關編組同仁均已完成第三方輔導機構之專業課程培訓，具備自主盤查與數據品質管理能力。此舉不僅確立了內部盤查數據的精準度與合規性，亦讓後續與第三方查證機構(如 ISO 14064-1)之查證對接工作順利進行。
			社會面向	人才吸引與留任 1.提供社團費用補助，鼓勵同仁參與社團活動，透過正當休閒活動來促進同仁身心健康及彼此情誼，本年新增露營社，與原有社團親山社、羽球社、高爾夫球社皆在持續運作中。 2.設立健身房以及每週2堂有氧課程，除可增進員工身心健立，亦可改善工作壓力、聯絡員工感情，經常運動有助於提高專注力和工作效率
				人才發展 本年度訓練課程反應評估實體課程及線上課程得分均為4.5(滿分5.0)。
				人權 優於法令的友善制度：平日工時為七小時；工作滿一年，每年給予七日公司假；媽媽彈性工時。
				職業安全與衛生 1.依勞工健康保護規則，雇主對在職勞工，應依規定期限，定期實施一般健康檢查；目前公司更優於勞工健康保護規則，

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			於每年對在職員工進行健康檢查管理。 2.依消防法及其施行細則，對所屬辦公處所依期限每年進行辦公處所環境之消防檢查並向消防隊進行申報；滅火器數量雙倍優於法規，每半年之自衛消防編組演練提升為每季演練。 3.為確保同仁作業環境品質，委託合格作業環境測定廠商，定期進行環境照度、空氣品質檢測。	
			社會參與 1.贊助樹林區體育會主辦之「2025兒童樂活一夏」活動，推廣兒童體育夏令營，將專業技能薪火相傳，延續體育人才培育計畫，推展健康的運動休閒，加強年輕學子體能、專業與團結力。 2.贊助由中部八所大學院校聯合舉辦的「2025永續智慧創新黑客松」競賽由學生提出創意方案，期待能優化產業的經營管理與服務創新，並攜手打造友善共好的社會。 3.捐款予「財團法人台北市整合心臟醫學基金會」，該基金會主要協助心臟醫學研究、專案獎助心臟內外科醫療人員出國進修與國際交流，使台灣在心臟外科學術與技術更為精進，以期未來能嘉惠更多病患。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司現各廠處所已全面進行一般事業廢棄物委由專業環保公司回收與處理及持續推行資源類垃圾分類、回收再利用政策，推廣辦公室二次利用廢紙影印，並向員工宣導節約用水用電之生活習慣，以期資源再利用與垃圾不造成二次汙染與資源浪費措施。 公司持續推動無紙化政策，導入電子簽核系統取代傳統紙本簽核流程，降低紙張、碳粉及文件運送等資源耗用，減少行政流程所產生之環境負荷。透過電子化管理，提升文件傳遞效率及保存便利性，作為企業減碳與數位轉型之一環。	本公司主要為機械設備組裝及測試，未產生有害物質及廢水，故僅推動左列事項，並無通過國際相關驗證標準，應與永續發展實務守則無重大差異。												
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司採取多項措施降低對環境之衝擊，例如：照明設備改用節能燈管、減少燈管數量、隨手關閉未使用電源、控制空調溫度、廢紙回收、垃圾分類、降低廢棄物量，針對生產過程中產生之餘料或存貨中之呆滯料件，皆會不定期評估並進行活化提升利用率，以線上文件取代紙質，以達成提升能源使用效率的目標及降低對環境負荷。	無重大差異												
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		<table><tr><th>潛在風險及結果</th><th>機會</th><th>因應措施</th></tr><tr><td>碳排總量與碳交易、碳費及碳稅制度將增加公司營運成本。</td><td>參與碳/再生能源交易</td><td>1.密切注意相關法令。</td></tr><tr><td>1.衝擊生產作業，影響交貨。 2.廠房及設備損壞致營運成本增加。</td><td>提升天災防禦能力</td><td>1.啟動天災預應機制。 2.廠區已設有抽水機及防洪池，可降低廠區淹水之風險。</td></tr><tr><td>用電量上升致營運成本及碳排量增加。</td><td>推動使用節能產品</td><td>廠區增設風扇，加強循環及降溫效率，減少能源使用及碳排量。</td></tr></table>	潛在風險及結果	機會	因應措施	碳排總量與碳交易、碳費及碳稅制度將增加公司營運成本。	參與碳/再生能源交易	1.密切注意相關法令。	1.衝擊生產作業，影響交貨。 2.廠房及設備損壞致營運成本增加。	提升天災防禦能力	1.啟動天災預應機制。 2.廠區已設有抽水機及防洪池，可降低廠區淹水之風險。	用電量上升致營運成本及碳排量增加。	推動使用節能產品	廠區增設風扇，加強循環及降溫效率，減少能源使用及碳排量。	無重大差異
潛在風險及結果	機會	因應措施														
碳排總量與碳交易、碳費及碳稅制度將增加公司營運成本。	參與碳/再生能源交易	1.密切注意相關法令。														
1.衝擊生產作業，影響交貨。 2.廠房及設備損壞致營運成本增加。	提升天災防禦能力	1.啟動天災預應機制。 2.廠區已設有抽水機及防洪池，可降低廠區淹水之風險。														
用電量上升致營運成本及碳排量增加。	推動使用節能產品	廠區增設風扇，加強循環及降溫效率，減少能源使用及碳排量。														

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否	摘要說明																									
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(1)最近2年度溫室氣體排放量(範疇二)：<table><tr><td></td><td>113年</td><td>114年</td><td>變動%</td></tr><tr><td>二氧化碳排放量(噸)</td><td>754</td><td>739.82</td><td>(1.88)</td></tr></table> (2)最近2年度用水量：<table><tr><td></td><td>113年</td><td>114年</td><td>變動%</td></tr><tr><td>用水量(度)</td><td>7,364</td><td>8,833</td><td>19.94</td></tr></table> (3)最近2年度廢棄物總重量：<table><tr><td></td><td>113年</td><td>114年</td><td>變動%</td></tr><tr><td>一般事業廢棄物(公斤)</td><td>11,500</td><td>4,500</td><td>(60.87)</td></tr></table> 本公司主要為機械設備組裝及測試，僅產生一般廢棄物，公司統計範疇二溫室氣體排放量及用水量進行統計，面對氣候變遷本公司在環保及節能上已建立具體政策、目標、措施及成效，本公司以112年為碳排放量為基準年，目標119年碳排放量較112年降低10%，措施主係空調及照明節能的管理及優化，並推動無紙化。		113年	114年	變動%	二氧化碳排放量(噸)	754	739.82	(1.88)		113年	114年	變動%	用水量(度)	7,364	8,833	19.94		113年	114年	變動%	一般事業廢棄物(公斤)	11,500	4,500	(60.87)	本公司依上市櫃公司永續發展路徑圖之規劃，屬第三階段(115年度)適用對象，故雖尚未完成左列各項資訊之驗證情形，應與永續發展實務守則無重大差異。
	113年	114年	變動%																									
二氧化碳排放量(噸)	754	739.82	(1.88)																									
	113年	114年	變動%																									
用水量(度)	7,364	8,833	19.94																									
	113年	114年	變動%																									
一般事業廢棄物(公斤)	11,500	4,500	(60.87)																									
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司秉持著尊重人權的精神，遵守國際人權公約相關規範，致力於創造員工福祉： 1.公平晉用：確保員工在招募、任用及晉升等僱用過程不受歧視對待。 2.禁用童工：公司遵守勞動基準法規定，不僱用15歲以下之勞動者。 3.性騷擾防治：公開揭示設有性騷擾防治措施、申訴及懲戒準則，並設置申訴專線及專用電子郵箱。 4.縮短工時：本公司平日工時為七小時，優於勞動基準法的八小時。 5.退休制度：依勞動法規規定保障員工之合法權益，並提例退休金。	無重大差異																								
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		1.本公司秉持與員工利潤共享的理念，吸引、培育與員工利潤共享之理念，薪資報酬結合員工績效考核制度與經營績效，本公司113年度非擔任主管職務之全時員工「薪資中位數」為新台幣97.6萬元，占全體上市櫃公司前21%。	無重大差異																								

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			2.本公司重視員工的身心健康與福利，提供完善的多元化福利措施，例如：每日上班工時7小時、每日午休1.5小時、工作满一年享有 7天公司假、年度旅遊補助金、喜慶婚喪生育禮金、員工生日禮券、私車公用損害補償、各類社團活動及社團補助、每季部門員工聚餐、年度健康檢查、員工半日遊等。 3.本公司於人力資源結構方面，於114年底員工總數為352人，其中經理人共30人，一般員工322人，男性員工292人，女性員工60人，另本公司致力提供身心，另本公司致力提供身心障礙人士就業機會，共進用2名身心障礙者，符合相關規定。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司提供員工一個整潔的環境，並提供員工安全與健康上所需之安全防護設備，定期辦理員工健康檢查並定期對員工實施安全與健康教育。 本公司實施措施簡述如下： 1.員工所處場所之安全檢查之保護措施：依建築法及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法對辦公處所廠區進行建築物公共安全檢查，期使辦公場所為合法安全無虞場所。 2.員工身體健康保護措施：依勞工健康保護規則，於每年對所屬員工及承攬商進行法定項目之勞工在職健康檢查管理。 3.辦公處所及製造廠區之消防安全保護措施：依消防法及其施行細則，對所屬辦公處所依期限每年進行辦公處所環境之消防檢查並向消防隊進行申報。 4.本公司今年未有火災案件，同時對於員工於發生火災及災害之應變措施及訓練：依消防法每年兩次進行員工自衛消防演練及急救訓練，俾使員工有良好救災及應變能力。 5.員工辦公處所之電力及用電安全措施：依職業安全衛生法，定期委託專業電器顧問公司進行電器技術人員執照之取得及進行每月電氣設備安全檢	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			查，以確保員工辦公處所用電安全。 6.員工安全衛生教育訓練之培訓及保護措施：依勞工安全衛生教育訓練規則，規定新進同仁接受安全衛生教育訓練，以確保同仁進入公司後可以有足夠安全衛生知識以資防止職業災害發生。 7.製造廠區使用危險性機械設備之合格操作人員派訓：為使同仁合法並安全使用及操作廠區之吊掛設備，規定須先派至合格勞工安全衛生訓練單位受訓，並參加考試取得證照才可以操作以確保同仁工作安全。 8.辦公環境之作業場所定期實施消毒。 9.本公司114年度未有職災案件，本公司重申公司職業安全重要性，立即協助送醫並啟動主管關懷注意同仁身心狀態。 10.本公司114年度內未發生任何火災事故，因此火災之件數、死傷人數均為零，死傷人數占員工總人數比率亦為0%。雖無實際火災事故發生，惟本公司仍持續強化消防安全管理，以降低火災風險並保障員工安全。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司以全面提升員工專業技能、工作效率及產品品質為目標，制定年度教育訓練計劃，並依核心、管理、專業職能模組，在兼顧公司發展及同仁滿足的需求下，分別展開標準化、階層別與部門別之訓練課程。114年度教育訓練共計完成305人次，總時數為1,904小時。	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司配置多名客服人員進行售後服務，與客戶間保持良好之溝通管道，維護消費者權益並對產品與服務提供有效之客訴處理程序。	無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		公司已訂定「採購及供應商管理辦法」，不定期對供應商進行評鑑，並要求供應商承諾所提供之所有產品、零件、材料及其附屬物之物質需符合環保標準之規定，並同意遵守包括勞工安全衛生在內之所有法律法規，若違反以上條款，本	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			公司得解除或終止相關之採購合約或訂單。 本公司於第一次進貨後一個月內，依廠商營業性質，進行廠商評核；每年三月以廠商評核報告表中所列項目逐項評核，定期評核項目就其價格競爭力、交貨狀況、品質及服務態度等依其評核內容給予評核等級。 本公司制定「供應商企業社會責任承諾書」，由供應商夥伴閱讀、瞭解並簽署確認。承諾書內容包括誠信經營、勞工權益與人權、健康安全、環境保護等四個面向，期與供應鏈合作夥伴共同成長，建立永續夥伴關係，一同致力於企業社會責任之落實。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司為自動視覺檢測設備商，主為機械設備組裝及測試，製造過程未產生工業廢氣及工業汙水排放等高汙染環境之情形，故不適用ISO14001認證。	本公司將視實際需求研議辦理
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展實務守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於105年11月由董事會通過訂立「企業社會責任實務守則」，並於111年3月更名為「永續發展實務守則」，有關永續發展之運作，悉依該實務守則之內涵與相關規定辦理，並確實遵循。 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司自成立以來，守法守分並重視公司所應負擔之永續發展推動，目前本公司推動永續發展情形如下： (一)營運績效方面 本公司為落實公司治理，建立有效之內部控制制度，設有獨立董事，借重獨立董事之專業經驗，增加經營團隊之實務經驗，訂定董事會議事規則以及投保董事責任險，以強化董事會職能。而為保障股東權益及提昇資訊透明度，本公司設置發言人及代理發言人，及時公開公司各項重大資訊，並由專人負責處理與股東之溝通事宜。此外，本公司專注於自動光學檢測設備產品研發、生產製程改善及拓展銷售國內外客戶，努力創造股東價值。另外，本公司專注產品品質，以提高顧客滿意度為目標，所生產之產品均依相關作業程序及辦法來進行生產，提供客戶安全、可信賴及高品質之產品。銷售之產品均經過客戶驗證，並於售後提供客戶保固及維護服務。 (二)環境保護 本公司產品製造過程中無產生有害事業廢棄物、廢有機溶劑，確保環境績效能符合環保法令承諾持續改善與污染預防，另外本公司於94年10月亦已回覆經濟部RoHS服務團相關問卷、產品現況及外銷情形，經經濟部RoHS服務團判定無涉及歐盟環保指令（RoHS）相關規範。此外，				

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
本公司由過去消極被動遵守環保法令的態度，改變為積極主動的降低環境衝擊、節能減廢、增進環境績效等環境自覺理念，確保其環境績效能符合環保法令及承諾持續改善與污染預防，且本公司亦推行資源回收及分類，降低耗電量，為維護地球環境盡一份心力，達成企業永續經營，環境永續發展，使經濟發展與環境保護獲得雙贏之目標。				
(三)社會服務方面				
1.在就業聘雇方面，本公司提供多種職缺，進用身心障礙且具有能力者數人。				
2.於文化發展方面，將部門半日遊的主題訂為藝文之旅，規劃各部門到不同藝文類型的場館參觀，以行動支持國內文化發展，並啟發同仁創意與創新能力。				
3.贊助樹林區體育會主辦之「2025兒童樂活一夏」活動，推廣兒童體育夏令營，將專業技能薪火相傳，延續體育人才培育計畫，推展健康的運動休閒，加強年輕學子體能、專業與團結力。				

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司關注全球因氣候變遷所引發之環境危機、財務影響及其他風險，由運管部負責評估及管理氣候風險，擬定及推動具體措施並評估相關因應作為。會議討論之鑑別結果將向高層彙報目前針對氣候變遷相關風險與機會之管理情形，並於董事會中報告關於氣候變遷之相關議題。另定期召開會議，依據 TCFD 架構進行風險與機會分析。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	短期影響： ● 因強化排放量報導義務、廢棄物回收、廢水排放及節能減碳相關法規趨嚴，可能增加營運成本。 ● 無預警限電或停電，可能導致研發中心及實驗室無法正常運作，需額外向緊急供電廠商購買電力。 ● 極端降雨、淹水及異常高溫等氣候事件，可能影響員工上下班交通、工作安全及日常營運。 ● 本公司已推動能源管理措施，包括裝設 UPS 不斷電系統、租用發電機設備及加強員工節電宣導，以降低營運中斷風險。 中期影響： ● 因應低碳轉型趨勢，可能增加低碳設備建置、低碳技術轉型及再生能源購買等成本。 ● 隨著碳費或碳稅制度推動，可能進一步增加營運支出。 ● 本公司將持續推動 LED 節能燈具汰換及低耗能分析檢測服務研發，以降低能源使用及提升營運效率。 ● 低碳與高效率省電技術之研發，可提升市場競爭力並增加客戶訂單。 長期影響： ● 氣候變遷及淨零排放趨勢可能改變市場需求與產業結構，公司需持續投入低碳分析檢測服務研發，以維持市場競爭力。 ● 發展高階低碳分析檢測服務，有助於拓展新市場及增加營運收入。 ● 本公司已訂定長期目標，預計於 2045 年達成各營運據點淨零排放。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	營運成本增加： ● 無預警限電或停電，可能導致研發中心、實驗室無法正常運作，需額外向緊急供電廠商購買電力 ● 廢棄物回收、廢水排放、土壤及地下水污染相關政策或法規趨嚴，可能增加營運成本 ● 碳費或碳稅徵收增加營運成本 ● 購買低碳設備或開發低碳產品及技術增加成本支出

項目	執行情形
	營運收入增加： ● 低碳與高效率省電技術研發可增加客戶訂單及營運收入 ● 發展高階低碳檢測服務可增加營運收入
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司以定期召開會議方式，參考 TCFD 風險分析架構，找出未來營運潛在風險與機會。未來將依循公司評鑑程序，透過衝擊程度及發生機率之風險矩陣分析方法排序風險強度，定義顯著風險來源，並逐步規劃將氣候變遷風險因子納入公司風險準則中。 具體方式包括： ● 參考同產業研究資料 ● 參考國際機構報告 ● 蒐集相關法規資訊 ● 訪談權責部門主管 ● 蒐集各部門氣候相關資料 ● 透過問卷分析及矩陣分析鑑別氣候變遷相關風險
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	在低碳轉型情境下，未來碳費/碳稅制度逐步推行、再生能源使用要求提高、溫室氣體管理規範趨嚴，以及客戶對供應鏈減碳要求持續提升，公司後續主要評估之分析因子包括： ● 能源成本及用電需求增加 ● 碳費或碳稅政策衝擊 ● 客戶低碳與ESG管理要求 ● 供應鏈交期與零組件供應風險 ● 極端氣候造成之停工或運輸延遲 ● 廠務設施與設備穩定性
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司因應氣候相關風險之措施包括： ● 致力研發更高階、更低耗能之分析檢測服務 ● 能源管理措施： ○ 實驗室重要設備裝設 UPS 不斷電系統 ○ 限電時租用發電機設備作為緊急供應電源 ○ 加強員工節電宣導 ● 全面汰換 LED 節能燈具 ● 委託合法廢棄物處理廠商並定期稽核 ● 定期檢測汙水排放，確保符合法規要求 相關指標與目標包括： ● 每年執行溫室氣體範疇一及範疇二盤查 ● 2027年減少4%溫室氣體排放 ● 2030年減少10%溫室氣體排放 ● 2045年達成淨零排放
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司持續關注國內外碳費及碳管理政策發展，作為未來氣候風險管理與低碳轉型規劃之參考。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫	涵蓋活動與排放範疇：本公司溫室氣體盤查邊界涵蓋中和總部以及生產廠區（包含樹林廠區及後續搬遷之平鎮新廠區的轉移

項目	執行情形
室氣體排放範疇、規劃期程， 每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應 說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	銜接)。盤查作業依循 ISO 14064-1 標準，現階段優先針對範疇一及範疇二進行全面性數據收集與清冊建立。 氣候目標與規劃期程：為響應全球減碳趨勢與國家淨零政策，本公司目前正處於「溫室氣體盤查與基線建立」階段。 ● 短期目標（2024 - 2026年）：完成個體公司之溫室氣體盤查規劃與數據收集，建立排放基準年。 ● 中長期目標：待平鎮廠區產能穩定且基準年數據確信完成後，預計將以基準年為基礎，制定具體之年度減碳百分比目標（如每年自主減量 1%~2%），並導入廠務節能改善與自動化設備。 每年達成進度：2025年度已完成內部溫室氣體盤查。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1 及1-2)。	請詳下表1-1溫室氣體盤查資訊及確信情形及1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫說明。

1.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO ₂ e)、密集度(公噸CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。		
本公司溫室氣體盤查係依據ISO 14064-1:2018 標準辦理，以營運控制權為基礎設定組織邊界，盤查範圍涵蓋由田新技股份有限公司中和總公司、樹林廠、平鎮廠及台南辦公室。 本次盤查結果以112年度為基準年，據以掌握各營運據點之溫室氣體排放現況及趨勢，作為後續減碳目標與管理策略擬訂之依據。		
114 年度經盤查之各範疇溫室氣體排放量與排放密集度如下：		
年度 \ 範疇(類別)	113年	114年
範疇一	165	162.68
範疇二	754	739.82
總排放量合計(單位:公噸CO ₂ e)	919	903
排放密集度	0.506	0.558

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

項目	114年
確信範圍	中和總公司、樹林廠、平鎮廠及台南辦公室
確認機構	尚未委任
確信準則	預計採用 ISO 14064-1

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

1.減量基準年及其數據：本公司以 2023 年為溫室氣體減量基準年。基準年之溫室氣體總排放量為 985 tCO₂e。

- 範疇一（直接排放）：217 tCO₂e
- 範疇二（間接排放）：842 tCO₂e

2.減量目標：本公司響應國家 2050 淨零排放政策，以 2023 年為基準年，設定以下減量目標：

- 短期目標（2026 年）：較基準年減量 10%
- 中期目標（2030 年）：較基準年減量 25%
- 長期目標（2050 年）：達成 100% 淨零排放

3.減量策略及具體行動計畫：本公司透過能源管理、廢棄物管理、水資源管理與資源數位化等具體行動推動落實：

能源管理：於生產廠區導入自動控制系統，針對空壓機及照明空調等高耗能設備進行優化設備運轉參數，以降低用電量與溫室氣體排放。

廢棄物管理：公司所有事業廢棄物均以安全且符合環保法規之方式處理，一般事業廢棄物委託具甲級或乙級清除處理資格之環保公司辦理，杜絕事業廢棄物不當流出造成環境污染。

水資源管理：公司重視水資源之有效使用及品質管理，除每三個月定期更換飲水設備濾芯，確保員工飲用水品質外，並透過內部節水宣導、裝設自閉式水龍頭等措施，降低不必要之耗水行為。

紙本減量與數位化管理：本公司積極推動流程數位化與線上簽核系統，逐步取代傳統紙本表單作業，減少紙張生產過程之能源消耗與碳排放，落實資源節約與減碳目標。

4.減量目標達成情形

114 年度實際績效：114 年度總排放量為 903 tCO₂e，較基準年（112 年）下降 14.7%。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司訂有「公司誠信經營守則」，於內部管理及外部商業活動中確實執行；另本公司之「董事會議事規範」，亦載明董事利益迴避制度，對董事會所討論之議案，如涉有其自身或其代表法人利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有損及公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	無重大差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		本公司訂有「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，已針對較高之不誠信行為所產生之風險，訂定相關防範措施。	無重大差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		本公司訂有員工「工作規則」，載明員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、餽贈、收受回扣、侵佔公款或其他不法利益，以杜絕不誠信行為影響商業關係或交易行為。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		本公司遵循公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。	無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		本公司於109年8月成立隸屬董事會之專責單位，由企劃、人資、財會與法務等單位主管共同組成「誠信經營推動小組」，協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，以確保誠信經營守則之落實，且每年至少一次向董事會報告推動誠信經營之計畫及執行情形。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		員工之意見可透過多重管道與管理階層或是人資單位反映。定期與員工訓練及溝通，於防範不誠信行為之同時，保障員工權益。	無重大差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		本公司訂有「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，作為落實誠信經營之依據。並為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。	無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		公司不定期舉辦新人訓練，宣導誠信經營觀念，使同仁清楚瞭解誠信經營理念與規範。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		公司訂有「員工獎懲辦法」，可透過多重管道與管理階層或是人資單位檢舉，公司方經由受理、調查、申訴、審議等程序執行懲戒。藉由建立良好之公司治理、風險控管機制及完善之內部規章，防範不誠信行為之發生，以創造公司永續發展之經營環境。	無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		本公司訂有「違反誠信經營守則檢舉辦法」，載明本公司受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。	無重大差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司訂有「違反誠信經營守則檢舉辦法」，載明本公司保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		已於公司網站架設「公司治理」專區，並於該項下設置「誠信經營」專區，揭露誠信經營相關資訊情形。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：				
本公司為建立良好商業運作及誠信企業文化，訂有「公司誠信經營守則」，明訂董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：				
本公司將隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進公司誠信經營政策，以提昇公司誠信經營之成效。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

- 1.內部控制聲明書：請至公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告查詢<<https://mops.twse.com.tw/mops/#!/web/t06sg20>>。
- 2.委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.114 年度股東常會議事錄詳見第 103~108 頁。

2.114 年度至年報刊印日止股東會重要決議

股東會日期	重要決議
114/06/25 (股東常會)	1.承認本公司 113 年度決算表冊案 執行情形：已按決議執行。 2.修訂本公司「公司章程」案 執行情形：已按決議執行。 3.本公司辦理現金增資私募普通股票案 執行情形：已按決議執行，截止本年報刊印日止，本私募案尚未完成辦理。 4.增額補選獨立董事 獨立董事當選名單：端木玉

3.114 年度至年報刊印日止董事會重要決議

董事會日期	重要決議
114/03/11	1.本公司 114 年度合併損益表預算案。 2.公司 113 年度內部控制制度聲明書。 3.113 年度員工及董事酬勞案。 4.113 年度董事酬勞分配案。 5.經理人晉升任用案。 6.新任經理人 114 年薪資範圍案。 7.本公司 113 年度財務報表案。 8.本公司 113 年度營業報告書案。 9.本公司 113 年度盈餘分派表案。 10.資本公積發放現金案。 11.修訂本公司「公司章程」案。 12.修訂本公司「薪工循環」案。 13.113 年度基層員工範圍及員工酬勞分配比例案。

董事會日期	重要決議
	14.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 15.修訂本公司「董事會議事規範」案。 16.增額補選獨立董事案。 17.新任獨立董事競業禁止解除案。 18.本次股東會受理獨立董事候選人之提名、股東之提案方式、提案期間及其受理處所案。 19.召開本公司 114 年度股東常會。 20.本公司截至 113 年 12 月 31 日新增應收帳款逾期三個月案。 21.本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則案。 22.本公司配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師。
114/05/12	1.民國 114 年度第 1 季合併財務報告案。 2.本公司截至 114 年 3 月 31 日新增應收帳款逾期三個月案。 3.追認新光銀行額度案。 4.追認玉山銀行額度案。 5.追認國泰世華銀行額度案。 6.董事會於本次股東會擬提名之董事候選人名單。 7.檢查獨立董事候選人提名文件相關事宜。 8.辦理現金增資私募普通股案。 9.現金增資私募普通股終止案。 10.新增及刪除本公司 114 年度股東常會討論事項議案。 11.配發現金股息及資本公積之配息基準日案。
114/06/25	1.追認合作金庫額度案。
114/08/13	1.民國 114 年度第 2 季合併財務報告案。 2.本公司 114 年度會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案。 3.本公司截至 114 年 6 月 30 日新增應收帳款逾期三個月案。 4.追認銀行額度案。 5.本公司擬實施員工持股信託計畫暨本公司經理人參與該計畫之公司提撥獎勵金案。
114/11/12	1.民國 114 年度第 3 季合併財務報告案。 2.申請中國輸出入銀行額度案。 3.訂定民國 115 年度稽核計畫。 4.本公司截至 114 年 9 月 30 日新增應收帳款逾期三個月案。 5.本公司薪資報酬委員會審議經理人 114 年度年終獎金核發案。 6.本公司薪資報酬委員會審議經理人 115 年度薪資調整案。
115/03/12	1.本公司 115 年度合併損益表預算案。 2.公司 114 年度內部控制制度聲明書。 3.114 年度員工及董事酬勞案。 4.114 年度董事酬勞分配案。 5.本公司 114 年度財務報表案。 6.本公司 114 年度營業報告書案。 7.本公司 114 年度盈餘分派表案。 8.資本公積發放現金案。 9.114 年度基層員工薪資水準定義案。 10.修訂本公司「薪酬委員會組織規程」及「薪酬委員會運作管理辦法」案。

董事會日期	重要決議
	11.董事選舉案。 12.新任董事競業禁止解除案。 13.本次股東會受理董事候選人之提名、股東之提案方式、提案期間及其受理處所案。 14.召開本公司 115 年度股東常會。 15.本公司截至 114 年 12 月 31 日新增應收帳款逾期三個月案。 16.本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則案。 17.追認元大商業銀行額度案。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。

(十二)董事進修之情形

職稱	姓名	課程名稱	時數	日期
董事長	鄒嘉駿	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	114/07/09
董事	張文杰	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	114/07/09
董事	林芳隆	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	114/07/09
董事	葉惠德	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	114/07/09
獨立董事	呂英誠	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	114/07/09
獨立董事	丘邦翰	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	114/07/09
獨立董事	蔡熊光	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	114/07/09
獨立董事	端木玉	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12	114/09/23~ 114/09/24

(十三)會計師獨立性及適任性評估報告

- 1.簽證會計師事務所：安侯建業聯合會計師事務所
- 2.簽證會計師：楊樹芝會計師及洪士剛會計師
- 3.評估日期：114 年 8 月
- 4.獨立性評估內容：

評估項目	評估結果	符合獨立性
簽證會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
簽證會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
簽證會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
簽證會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
簽證會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
簽證會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
簽證會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
簽證會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是

5.適任性評估內容：

評估項目	評估結果	符合適任性
是否如期完成本公司各期財務簽證	是	是
是否如期完成轉投資公司各期財務查核	是	是
是否不定期提供本公司財務、稅務諮詢服務	是	是

6.評估結果

依據上述獨立性及適任性之評估結果，簽證會計師與本公司並無其他財務利益及業務關係，楊樹芝會計師及洪士剛會計師與本公司具獨立性，另取得會計師事務所提供之審計品質指標(AQIs)，針對專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等五大構面及十三項指標，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。經與聘任會計師充份溝通後逐一評估聘任會計師之適任性，本公司並未察覺有可能會影響簽證會計師獨立性及適任性之情事。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	楊樹芝	114.01~114.12	2,130	610	2,740	(註)
	洪士剛	114.01~114.12				

註：上述所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。本年度給付非審計公費共計 610 仟元，其中 580 仟元為稅務簽證費用，30 仟元係為複核本公司非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表之服務工作酬金。

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	114年03月11日		
更換原因及說明	配合會計師事務所內部調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止委任	✓	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	✓	
	說明		

更換日期	114年03月11日
更換原因及說明	配合會計師事務所內部調整
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	不適用

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	楊樹芝、洪士剛
委任之日期	114年03月11日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情事。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及持股比例超過 10%之股東股權變動及質押情形

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 4 月 26 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長暨經理人	鄒嘉駿	—	—	—	—
董事暨經理人	張文杰	—	—	—	—
董事	林芳隆	(76,000)	—	(114,000)	—
董事	葉惠德	—	—	—	—
獨立董事	呂英誠	—	—	—	—
獨立董事	丘邦翰	—	—	—	—
獨立董事	蔡熊光	—	—	—	—
獨立董事	端木玉(註)			—	—
經理人	林伯聰	—	—	—	—
經理人	邱彥博	—	—	—	—
經理人	王人傑	5,000	—	(5,000)	—
經理人	蔡茂岳	—	—	—	—
經理人	葉丁源(註)			—	—
經理人	廖佐華(註)			—	—
經理人	陳健銘(註)			—	—
經理人	林慧盆	1,000	—	—	—

(註)本公司新任獨立董事於 114/6/25 就任及新任經理人於 114/3/11 就任故無 114 年完整年度持股變化資訊。

(二)股權移轉或質押之相對人為關係人者：無此情事。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115 年 4 月 26 日

姓名		本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係	
		股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱(或姓名)	關係
匯豐託管坎布里亞新興股東收益 ETF		1,800,998	3.00	—	—	—	—	—	—
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶		1,505,000	2.51	—	—	—	—	—	—
鄒嘉駿		1,112,881	1.85	422,009	0.70	1,004,000	1.67	瑞泉文嘉股份有限公司	代表人為同一人
志聖工業股份有限公司	法人	1,096,000	1.83	—	—	—	—	—	—
	代表人梁茂生	—	—	—	—	—	—	—	—
葉惠德		1,016,151	1.69	—	—	—	—	—	—
曾繼輝		1,005,000	1.67	—	—	—	—	—	—
瑞泉文嘉股份有限公司	法人	1,004,000	1.67	—	—	—	—	鄒嘉駿	代表人為同一人
	代表人鄒嘉駿	1,112,881	1.85	422,009	0.70	1,004,000	1.67	—	—
三葉股份有限公司	法人	890,000	1.48	—	—	—	—	—	—
	代表人葉丁源	50,640	0.08	100	0.00	890,000	1.48	—	—
隆華群資投資股份有限公司	法人	800,000	1.33	—	—	—	—	—	—
	代表人劉素華	23,821	0.03	644,207	1.07	—	—	—	—
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶		742,000	1.23	—	—	—	—	—	—

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

114 年 12 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例 %	股數	持股比例 %	股數	持股比例 %
Utechzone Global Corp.	12,313,816	100.00	—	—	12,313,816	100.00
科吉凱亞(股)公司	10,500,000	100.00	—	—	10,500,000	100.00
宙福投資(股)公司	500,000	100.00	—	—	500,000	100.00

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	59,850,750股	60,149,250股	120,000,000股	上櫃公司股票

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
8809	10	2,500	25,000	2,500	25,000	現增 12,695 仟元	無	註 1
8903	10	5,050	50,500	5,050	50,500	現增 25,500 仟元	無	註 2
9005	10	14,000	140,000	7,500	75,000	現增 15,752 仟元 盈轉 7,485 仟元 資轉 1,263 仟元	無	註 3
9103	12	14,000	140,000	10,500	105,000	現增 30,000 仟元	無	註 4
9409	12	40,000	400,000	18,907	189,070	認股權轉換 4,070 仟元	無	註 5
	10					盈轉 76,707 仟元		註 6
	10					資轉 3,293 仟元		
9508	6.9	40,000	400,000	27,861.2	278,612	認股權轉換 1,992 仟元	無	註 7
	10					盈轉 87,550 仟元		註 8
9512	100	40,000	400,000	32,661.2	326,612	現增 48,000 仟元	無	註 9
9608	4.7	80,000	800,000	44,363.5	443,635	認股權轉換 1,565 仟元	無	註 10
	10					盈轉 115,458 仟元		註 11
9612	35	80,000	800,000	50,278.5	502,785	現增 59,150 仟元	無	註 12
9709	10	80,000	800,000	51,232	512,320	盈轉 9,535 仟元	無	註 13
9904	32.1	80,000	800,000	51,392.5	513,925	認股權轉換 1,605 仟元	無	註 14
9909	32.1	80,000	800,000	51,910	519,100	認股權轉換 5,175 仟元	無	註 15
9912	31.1	80,000	800,000	51,997.75	519,977.5	認股權轉換 877.5 仟元	無	註 16
10003	31.1	80,000	800,000	52,063.25	520,632.5	認股權轉換 655 仟元	無	註 17
10005	31.1	80,000	800,000	52,304.75	523,047.5	認股權轉換 2,415 仟元	無	註 18
10005	50	80,000	800,000	60,304.75	603,047.5	現增 80,000 仟元	無	註 19
10007	31.1	80,000	800,000	60,324.75	603,247.5	認股權轉換 200 仟元	無	註 20
10009	28.1	80,000	800,000	60,327.25	603,272.5	認股權轉換 25 仟元	無	註 21
10104	21.6	80,000	800,000	60,582.75	605,827.5	認股權轉換 2,555 仟元	無	註 22
10109	21.6	80,000	800,000	60,590.25	605,902.5	認股權轉換 75 仟元	無	註 23
10205	20.5	80,000	800,000	60,735.50	607,355	認股權轉換 1,452.5 仟元	無	註 24
10209	20.5	80,000	800,000	60,747.50	607,475	認股權轉換 120 仟元	無	註 25
10212	20.5	80,000	800,000	60,757.50	607,575	認股權轉換 100 仟元	無	註 26
10304	20.5	80,000	800,000	60,868.75	608,687.5	認股權轉換 1,112.5 仟元	無	註 27
10312	20.5	80,000	800,000	60,888.75	608,887.5	認股權轉換 200 仟元	無	註 28
10401	20.5	80,000	800,000	61,003.75	610,037.5	認股權轉換 1,150 仟元	無	註 29
10405	20.5	80,000	800,000	61,078.75	610,787.5	認股權轉換 750 仟元	無	註 30
10408	20.5	80,000	800,000	61,108.75	611,087.5	認股權轉換 300 仟元	無	註 31
10503	20.2	80,000	800,000	61,208.75	612,087.5	認股權轉換 1,000 仟元	無	註 32
10511	18.7	80,000	800,000	61,213.75	612,137.5	認股權轉換 50 仟元	無	註 33

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
10603	18.7 38.9	80,000	800,000	61,438.75	614,387.5	認股權轉換 550 仟元 認股權轉換 1,700 仟元	無	註 34
10605	38.9	80,000	800,000	61,458.75	614,587.5	認股權轉換 200 仟元	無	註 35
10608	38.9	80,000	800,000	61,468.75	614,687.5	認股權轉換 100 仟元	無	註 36
10808	-	120,000	1,200,00	61,468.75	614,687.5	變更核定資本額	無	註 37
11011	10	120,000	1,200,00	59,850.75	598,507.5	註銷庫藏股減資	無	註 38

註：該次增資之生效(核准)日期與文號：

- 1.88 年 10 月 29 日，經(八八)中字第八八九七四八七八號。
- 2.89 年 04 月 26 日，經(八九)中字第八九四一六一〇三號。
- 3.90 年 08 月 14 日，經(九〇)中字第〇九〇三二六四〇一五〇號。
- 4.91 年 09 月 05 日，經授商字第〇九一〇一一三一六七〇號。
- 5.94 年 09 月 23 日，經授中字第〇九四三二八五五一四〇號。
- 6.94 年 07 月 22 日，金管證一字第〇九四〇一二九八九一號。
- 7.95 年 08 月 21 日，經授中字第〇九五三二七一二一四〇號。
- 8.95 年 06 月 09 日，金管證一字第〇九五〇一二三二〇四號。
- 9.95 年 10 月 03 日，金管證一字第〇九五〇一四六一一八號。
- 10.96 年 08 月 23 日，經授中字第〇九六三二六六二七六〇號。
- 11.96 年 06 月 25 日，金管證一字第〇九六〇〇三一九五七號。
- 12.96 年 11 月 09 日，金管證一字第〇九六〇〇六三〇〇七號。
- 13.97 年 09 月 10 日，經授商字第〇九七〇一二三三〇六〇號。
- 14.99 年 04 月 30 日，經授商字第〇九九〇一〇八八二五〇號。
- 15.99 年 09 月 02 日，經授商字第〇九九〇一一九七〇一〇號。
- 16.99 年 12 月 01 日，經授商字第〇九九〇一二六八一六〇號。
- 17.100 年 03 月 14 日，經授商字第一〇〇〇一〇四九二九〇號。
- 18.100 年 05 月 06 日，經授商字第一〇〇〇一〇九一三八〇號。
- 19.100 年 05 月 31 日，經授商字第一〇〇〇一一〇九一四〇號。
- 20.100 年 07 月 06 日，經授商字第一〇〇〇一一四三〇〇〇號。
- 21.100 年 09 月 15 日，經授商字第一〇〇〇一二一五五九〇號。
- 22.101 年 04 月 13 日，經授商字第一〇一〇一〇六五〇二〇號。
- 23.101 年 09 月 20 日，經授商字第一〇一〇一〇九四八五〇號。
- 24.102 年 05 月 10 日，經授商字第一〇二〇一〇八五四五〇號。
- 25.102 年 09 月 06 日，經授商字第一〇二〇一一八五二二〇號。
- 26.102 年 12 月 02 日，經授商字第一〇二〇一二四一二九〇號。
- 27.103 年 04 月 15 日，經授商字第一〇三〇一〇六五六四〇號。
- 28.103 年 12 月 10 日，經授商字第一〇三〇一二四五〇九〇號。
- 29.104 年 01 月 14 日，經授商字第一〇四〇一〇〇二九一〇號。
- 30.104 年 05 月 25 日，經授商字第一〇四〇一〇九三六五〇號。
- 31.104 年 08 月 25 日，經授商字第一〇四〇一一七四七五〇號。
- 32.105 年 03 月 17 日，經授商字第一〇五〇一〇五〇九二〇號。
- 33.105 年 11 月 29 日，經授商字第一〇五〇一二七六〇一〇號。
- 34.106 年 03 月 27 日，經授商字第一〇六〇一〇三九二〇〇號。
- 35.106 年 05 月 18 日，經授商字第一〇六〇一〇六三七〇〇號。
- 36.106 年 08 月 25 日，經授商字第一〇六〇一一一八一六〇號。
- 37.108 年 08 月 16 日，經授商字第一〇八〇一〇九三四九〇號。
- 38.110 年 11 月 02 日，經授商字第一〇〇一〇九九二一〇號。

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115 年 4 月 26 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例%
匯豐託管坎布里亞新興股東收益 ETF		1,800,998	3.00
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶		1,505,000	2.51
鄒嘉駿		1,112,881	1.85
志聖工業股份有限公司		1,096,000	1.83
葉惠德		1,016,151	1.69
曾繼輝		1,005,000	1.67
瑞泉文嘉股份有限公司		1,004,000	1.67
三葉股份有限公司		890,000	1.48
隆華群資投資股份有限公司		800,000	1.33
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶		742,000	1.23

(三)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

項目		年度	113 年 (114 年分配)	114 年 (115 年分配)	當年度截至 115 年 4 月 30 日
每股市價	最 高		151.00	122.00	243.00
	最 低		70.00	72.70	104.00
	平 均		120.07	100.07	146.54
每股淨值	分配前		44.58	42.88	—
	分配後		40.08	尚未分配	—
每股盈餘	加權平均股數(仟股)		59,851	59,851	59,851
	每 股 盈 餘		5.29	2.67	—
每股股利	現 金 股 利		4.50	3.50	—
	無償配股	盈餘配股	—	—	—
		資本公積配股	—	—	—
	累積未付股利		—	—	—
投資報酬分析	本益比		22.70	37.48	—
	本利比		26.68	28.59	—
	現金股利殖利率		3.75%	3.50%	—

(四)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司每年結算，如有盈餘，除依法完納稅捐及彌補歷年虧損外，應先提列法定盈餘公積百分之十，並依證券交易法規定提列或迴轉特別盈餘公積；如有餘額，得優先分派特別股當年度得分派之股息；如尚有餘額，併同期初未分配盈餘，由董事會擬具分配盈餘分派案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積，以發放現金之方式為之，並報告於股東會。

本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五~十五及董事酬勞不高於百分之三。員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合條件之之控制或從屬公司員工。

為配合科技產業成長特性及整體環境，本公司股利政策採穩健平衡原則，並參酌獲利狀況、財務結構及公司未來發展等因素決定股利發放水準。股利之發放方式得依公司整體資本預算規劃，股票股利配發以不超過百分之九十為上限。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	1,094,569,276
加：本年度稅後淨利	159,912,265
當年度淨確定福利負債再衡量數	2,069,000
迴轉特別盈餘公積	5,607,454
減：提列法定盈餘公積	(16,198,127)
本年度可供分配盈餘	1,245,959,868
分派項目：	
股東股利-現金	(143,641,800)
期末未分配盈餘	1,102,318,068

(五) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本次並無無償配股之計劃，故對公司營業績效及每股盈餘並無影響。

(六) 員工及董事酬勞

1. 本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五~十五及董事酬勞不高於百分之三。員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會決議行之並報告於股東會。員工酬勞給股票或現金之對象，包括符合條件之從屬公司員工。
2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司估列之員工及董事酬勞，係以本公司 114 年度之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上章程擬訂定之員工及董事酬勞分派成數為估計基礎。本公司依當年度獲利狀況扣除累計虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五~十五及董事酬勞不高於百分之三。
3. 董事會通過分派酬勞情形：
 - (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：
114 年度估列員工酬勞金額 19,213 仟元，董事酬勞為 5,764 仟元。若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將差異列為 115 年度之損益。
 - (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：
本公司本期未配發員工股票紅利金額，故不適用。
4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
 - (1) 113 年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：113 年度員工酬勞實際分派金額為 36,999 仟元，董事及監察人酬勞實際分派金額為 11,100 仟元。
 - (2) 113 年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：113 年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派金額與財務報告認列數並無差異。

(七) 公司買回本公司股份情形：無此情事。

- 二、公司債辦理情形：無此情事。
- 三、特別股辦理情形：無此情事。
- 四、海外存託憑證辦理情形：無此情事。
- 五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無此情事。
- 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情事。
- 七、資金運用計劃執行情形

本公司前一次發行有價證券已於 100 年第 3 季完成資金之運用且其效益亦顯現，故不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務之主要內容

(1)研究、開發、生產、製造及銷售自製檢測系統，含下列產品：

- A.PCB/IC 載板自動光學檢測設備。
- B.TFT-LCD/OLED/觸控面板 自動光學檢測設備。
- C.半導體自動光學檢測設備
- D.微小硬度自動量測系統。
- E.影像處理系統(包括影像處理發展工具)。
- F.自動光學導引製造設備

(2)前各項產品之技術及諮詢服務。

(3)前各項產品之進出口業務。

(4)代理相關產品之報價經銷等業務。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

產品項目	114年度營業收入	營業比重%
SEMI 檢測系統	699,768	41.77
PCB/IC 載板	476,696	28.45
LCD 檢測系統	376,418	22.47
其他	122,461	7.31
合計	1,675,343	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目

產品項目	
IC 載板出貨前成品自動光學檢測設備	IC 載板製程中自動光學檢測設備
堆疊式/彈匣式兩用 SiP 自動光學檢測設備	Flip Chip 自動光學檢測設備
PCB 線路檢查設備	PCB AFVI 自動最終光學檢測系統
PCB 高速檢孔設備	類載板自動光學檢測設備
載板全面 2D+3D 量測設備	載板阻抗分析設備
COF Chip 卷對卷自動外觀檢查機	Roll to Roll 軟板檢孔設備
Roll to Roll 軟板線路檢查設備	半導體晶圓級/面板級封裝檢測設備
Wafer 切割道 SWIR 檢查設備	半導體自動巨觀+微觀檢測設備
半導體高速 Review 拍照設備	先進封裝多面檢測設備
LCD 顯示器 Cell 段自動光學檢測設備	LCD 顯示器 Module 段自動光學檢測設備
Array 自動光學檢測設備	Color Filter 彩色濾光片自動光學檢測設備
PI 配向膜自動光學檢測設備	SEAL 框膠自動光學檢測設備
Burr Check 毛邊檢測機	偏光膜自動光學檢測系統
Digital Macro Mura 自動光學檢測系統	Mura 自動檢修設備
Bare Glass AOI 表面檢/端邊檢	OLED 面板自動光學檢測設備
觸控面板檢測設備	保護玻璃檢測設備
車載異型 Panel 自動檢查設備	AR 眼鏡光學檢測設備
小尺寸面板點燈檢測設備	API 自動/半自動檢測設備
LCM 來料檢查機/最終成品檢測設備	外觀光學六面檢測設備
OD/膜厚/色度量測設備	自動光學導引製造設備
AI 自動拍照機	AI 自動缺陷判定暨分類

4.計畫開發之新商品(服務)

計畫開發項目	
FOPLP 黃光製程檢測設備	高精度 Bump 高度量測設備
半導體 In-Situ 檢測模組	螢光殘留及光譜分析系統
半導體 CPO 檢測設備	晶圓巨觀/微觀 Bevel/Apex 檢測系統
半導體 ADI 檢測設備	奈米級 Particle 檢測設備
矽晶圓應力量測系統	半導體 3D 量測設備
半導體 TGV 檢測設備	晶圓級封裝多製程段檢測設備

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

產業之現況

縱觀 2025 年，全球經濟在地緣政治與貿易摩擦的夾擊下，整體表現仍維持相對平穩。雖反覆調整的關稅與不穩定局勢一度阻礙貿易與投資決策，但另一方面，AI 浪潮帶動的科技投資成為重要支撐，特別是在北美與亞洲地區，增長動能依然強勁，這幾股分化力量在相互抵銷後，使全球經濟在波動中仍保持溫和增長。就台灣而言，受到美國關稅政策不確定性及金融市場波動影響，部分傳統產業動能趨緩，惟受益於 AI 需求強勁，帶動相關供應鏈投資與出口成長，加上台灣在全球半導體產業中具備關鍵技術與製造優勢，整體經濟成長展現一定韌性。

展望 2026 年，人工智慧仍將持續扮演全球經濟成長的核心驅動引擎，帶動整體投資與技術升級，據國際貨幣基金（IMF）預估，全球經濟成長率可望達 3.3%。然而，若市場對 AI 所帶來的生產力成長過於樂觀，而實際成效不如預期，恐觸發金融市場短期修正風險。此外，地緣政治緊張局勢與貿易戰仍將是影響全球供應鏈穩定性與市場信心的重要不確定因素。在台灣方面，儘管全球政策變數與供應鏈重組趨勢帶來挑戰，然中央政府持續推動 AI 產業結構性成長，從智慧應用、關鍵技術與數位基礎建設三大面向全面布局，加上出口持續暢旺，預估全年將呈穩健成長態勢。

全球及主要國家經濟成長率預估

(Real GDP, annual percent change)	ESTIMATE	PROJECTIONS	
	2025	2026	2027
World Output	3.3	3.3	3.2
Advanced Economies	1.7	1.8	1.7
United States	2.1	2.4	2.0
Euro Area	1.4	1.3	1.4
Germany	0.2	1.1	1.5
France	0.8	1.0	1.2
Italy	0.5	0.7	0.7
Spain	2.9	2.3	1.9
Japan	1.1	0.7	0.6
United Kingdom	1.4	1.3	1.5
Canada	1.6	1.6	1.9
Other Advanced Economies	1.8	2.0	2.1
Emerging Market and Developing Economies	4.4	4.2	4.1
Emerging and Developing Asia	5.4	5.0	4.8
China	5.0	4.5	4.0
India	7.3	6.4	6.4
Emerging and Developing Europe	2.0	2.3	2.4
Russia	0.6	0.8	1.0
Latin America and the Caribbean	2.4	2.2	2.7
Brazil	2.5	1.6	2.3
Mexico	0.6	1.5	2.1

資料來源：IMF（2026 年 1 月），部分摘錄

人工智慧 (AI) 浪潮席捲全球，製造業正經歷著前所未有的轉型。近年 AI 帶旺先進封裝需求，更高效率、更高品質、更低成本為各廠商共同追求的目標。隨 5G、AI、雲端運算、物聯網及車用電子應用技術日益進步，電子元件的發展趨於微型化、低耗能化、超薄化、高集成、高密度等方向發展，促使整體電子產業技術朝向更高挑戰目標前進。為了滿足未來應用的相關技術，進而帶動 PCB 與載板層數增加、線寬及線距縮小、線路設計複雜度增加等；同時電子產品也在設計上強調多功能整合，晶片朝 2.5D/3D 先進封裝異質整合發展，使晶片的體積更小、效能更強。這些技術變革不僅推動產業升級，更進一步加速智慧製造市場的成長，根據 Research Nester 預估，2026 年智慧製造市場規模將達到 1,439.3 億美元，展現出高階技術在現代製造業中的關鍵地位。在此情況下，電子製造業對於檢測、量測的精細度要求也不斷提高，先進製程技術發展趨勢將帶動自動光學檢測(AOI)朝向極精密的方向發展，並成為整體光學檢測應用成長的主要驅動動能。

AOI 結合光學感測、訊號處理、智慧分析等技術，以機器視覺做為標準技術來檢出各式線路或外觀缺陷等瑕疵，主要應用於電子元件生產過程中的檢測環節，取代大多數的人工檢測，快速穩定且一致的檢測結果大幅提高製程的完整性及正確性，減少返工和報廢，並提高客戶滿意度，同時提升最終產品品質、產能與市場競爭力。此外，隨著智慧製造趨勢形成，製造業快速轉型，走向更自動化、數位化的方向，整合機器視覺與製程的重要性愈加突出，AOI 不僅以其精準、智能、高效之特性大幅推升產業發展，更將 AI 深度學習整合應用於檢測領域中，利用成熟的光學檢測技術，輔以 AI 演算法進行分析與分類，取代人力達到全檢的目標，已成為製造領域檢測方案的發展主流。根據 Research Nester 預估，2035 年 AOI 全球市場規模將達 123.5 億美元，2026-2035 複合年均成長率為 24.5%，隨著智慧製造浪潮的持續推動下，整體檢測市場需求預計將迎來爆發性成長。

本公司主要為專業研發產製印刷電路板/載板、平面顯示器與半導體之光學檢測設備，擁有光學、軟體、機械、電控及高階演算法等多項優勢。於載板外觀檢測、高世代 LCD 光學檢測、LCM 模組點燈檢測市占皆穩佔龍頭，另延伸技術優勢，持續投入研發，成功開發對應市場新製程需求之多元產品，近年推出之晶圓級封裝檢測設備、面板級封裝檢測設備、單顆級封裝檢測設備、載板全板量測設備、AI 拍照複判機...等亦廣受業界好評，公司不斷深化在各領域的製程覆蓋，且銷售範圍遍及大中華地區、日本、韓國、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、德國...等地，同時持續關注產業鏈南移趨勢，於東南亞提早佈建相關代理及銷售渠道，穩定掌握相關商機。另外也推出 AI 深度學習軟體，與檢測設備相結合，進一步實現智慧製造，強化公司於自動光學檢測設備市場之競爭力。

公司長期深耕 PCB 領域，除主推並持續優化領先市佔的 IC 載板相關外觀檢測設備，另針對高密度連接板 (HDI)、軟性印刷電路板 (FPC) 亦不斷投入研發精力，同時由後段外觀檢測領域切入前段製程檢測，廣化產品線覆蓋。本公司持續跟進產業發展脈動，已成功開發各式機台、對應多元產品需求，目前已具備外觀檢測、線路檢測、2D/3D 量測、雷射清除、檢孔等一系列設備，於銷售市場獲得顯著成果。中長期目標將持續擴展大陸、日韓、東南亞等地區銷售通路，掌握產業移動趨勢，以代理或合資等策略合作方式，拓展新市場及新客戶、提升市場競爭力。

另以平面顯示器產業而言，全球主要生產據點以中國為主，本公司設備早已導入大陸各世代面板大廠，銷售實績傲人，目前各世代線專用 TFT-LCD AOI 包括 CF、Seal、PI AOI...等，已廣泛銷售至兩岸大廠，多項產品市占率穩佔全球第一。近年公司專注高值化及差異化、投入車載及後段模組檢測，可對應各式料片大小及尺寸，點燈+外觀檢測設備成功打入歐系車載供應鏈，進一步穩固技術壁壘，同時提供

Demura 設備，全方位對應顯示器相關檢測需求；此外面對面板市場需求下降、產能吃緊之挑戰，本公司因應市場變化，以新機銷售及升級優化等多元利基強化市場競爭力，加以競爭廠商相繼退出市場，對公司顯示器設備毛利表現將有正向影響。

在 PCB 及顯示器檢測產業站穩灘頭後，本公司持續強化產品多元佈局，以順應全球半導體技術革新趨勢，並成功將經營重心轉向半導體光學檢測設備之研發與製造，進而挹注營收及優化產品組合。公司於半導體檢測設備已開發一系列產品線，完整對應晶圓級、面板級、先進封裝、凸塊…等各式製程，以獨家專利螢光檢測有效偵測有機殘留物，並以 IR 光檢測內層隱崩隱裂缺陷，同時對於最新的 FOPLP 與 TGV 等亦提供完整方案，可檢測 Bare Wafer、Framed Wafer、WLCSP、CoWoS、Bipolar、Driver IC、CIS、Micro/Mini LED、FOPLP、TGV…等多項產品，並已完成主要大廠訂單出貨，銷售實績延伸兩岸及東南亞一線大廠，達到多廠多機量產里程碑。

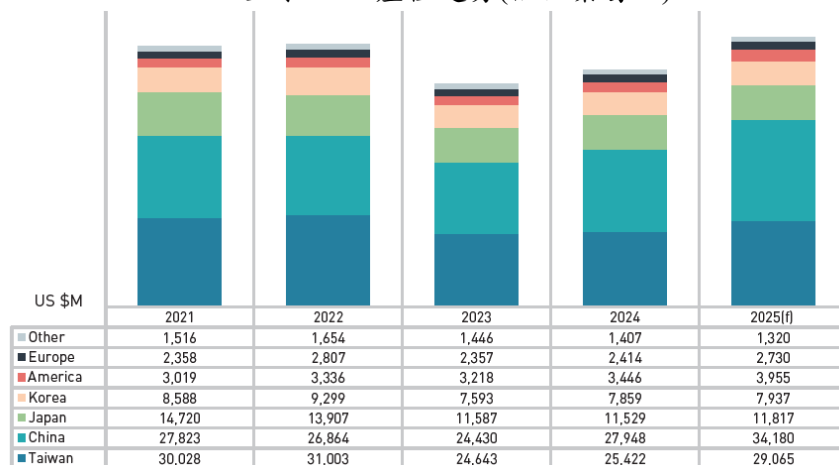
(1)印刷電路板(PCB)產業

A.全球印刷電路板產業

2025 年儘管全球經濟受地緣政治、貿易關稅壁壘及匯率震盪等多重考驗，PCB 產業仍憑藉 AI 伺服器與高效能運算（HPC）的爆發性成長，成功向高階與高附加價值產品轉型。根據台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所統計，2025 年全球 PCB 產值規模躍升至約 923.6 億美元，年成長率達 15.4%，顯示 PCB 產業正邁入新一階段的增長動能。進一步觀察全球各區域產值，中國大陸受惠於在地供應鏈與新能源汽車市場的垂直整合優勢，預估占比將達 38.2%，持續領先全球；台灣則以高階技術著稱，以 31.5% 的占比位居第二；而日、韓分別為 12.7% 與 8.9% 分居第三、四位。

另一方面，在產業快速成長之際，上游材料供應成為了影響 PCB 發展的重要變數，尤以高階玻璃纖維布供給最為關鍵。由於玻纖布是 IC 載板與 PCB 之核心基礎材料，而用於高階載板的先進玻纖布，幾乎是由日本日東紡獨家供應，即便國際一線大廠皆積極爭取貨源，仍呈現供不應求的狀況，預計此供需失衡的情景將持續到 2027 下半年，新產能開出後才能顯著改善。此外，掌握先進封裝關鍵材料的日系廠商也展現了較強的議價能力與價格轉嫁空間，如指標大廠 Resonac 已調升 PCB 相關材料價格，相關成本壓力預期將逐步向下游傳導，對 PCB 廠商的成本與獲利皆產生實質影響。

全球 PCB 產值趨勢(依企業屬地)



資料來源：TPCA、ITRI/ISTI（2025 年 09 月）

展望 2026 年，受益於 AI 伺服器與高階運算需求強勁成長帶動，TPCA 預估，全球 PCB 產值可望攀升至 1,052 億美元，年增率達 13.9%，顯示 AI 正引領 PCB 產業進入結構升級與價值鏈重塑的新階段。從技術面來看，高層數板、高階 HDI 及 ABF 載板等核心供應鏈產品，產能將因應龐大需求與規格提升而持續增長，成為市場主要動能。同時，這一趨勢也將吸引更多板廠投入高階領域，使高附加價值技術產品成為推動整體 PCB 市場發展的關鍵力量。

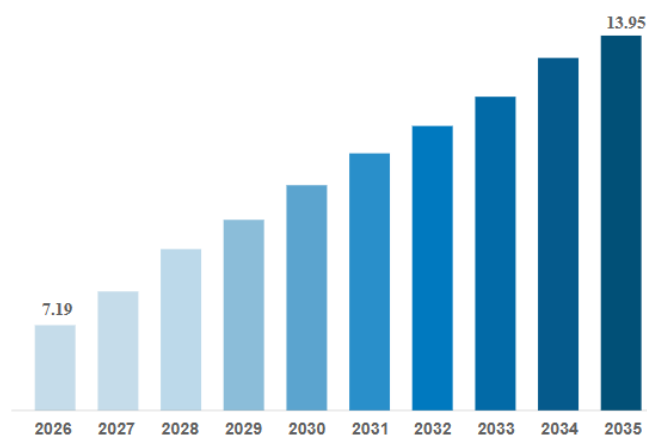
然而，儘管 AI 應用持續擴張，PCB 產業整體仍持續面臨產品線復甦不均的挑戰。消費性電子受制於手機市場疲軟及記憶體成本上升，除摺疊機等特定題材外，成長力道持續偏弱；車用 PCB 則因中國電動車價格競爭加劇，台廠面臨明顯降價壓力。此外，雖 AR 智慧眼鏡與人形機器人等新興應用具備潛力，但短期內仍處於技術萌芽階段，對市場產值貢獻有限。整體而言，PCB 在 2026 年仍是以 AI 伺服器為發展重心，面對非 AI 領域的訂單波動與庫存調整風險，各大廠商須審慎評估實際供需情況，並透過提升產能調度靈活性與強化庫存管理，以降低終端需求放緩對營運造成的影響。

進一步分析 PCB 2025 年主流領域，可以分為產品、應用及供應鏈三大主題，以下將針對各主題中最為顯著的趨勢及其發展狀況做說明：

a. 產品領域 – ABF 載板供不應求

隨著全球 AI 伺服器的建置潮從單一雲端中心滲透至邊緣運算與大型企業端應用，PCB 產業正迎來關鍵的結構性轉型，特別是在 ABF 載板領域。作為半導體晶片與電路板之間的核心電性橋樑，ABF 憑藉其優異的熱處理效能、低損耗及高精密佈線能力，需求核心已由傳統的個人電腦與手機市場，轉向技術門檻較高的高效能運算領域，成為 AI GPU、5G 通訊及先進封裝技術不可或缺的基石。除此之外，由於高階玻纖布目前受限於少數供應商，產能短期難以追上市場需求，使得產業技術升級的同時，材料稀缺也同步推動 ABF 進入產值與投資同步增長的新週期。根據 Business Research INSIGHTS 預估，2026 年全球 ABF 載板市場規模將超過 70 億美元，2035 年更有望達到 130.95 億，顯示強勢且長時間的市場動能。

全球 ABF 市場規模預估



資料來源：Business Research INSIGHTS（2026 年 2 月）

細看 ABF 載板供應鏈，主要大廠正積極透過大規模資本支出與報價調整，精準對應 AI GPU 及 ASIC 晶片的強勁需求，形成結構性成長。以台灣載板三雄為例，欣興受惠於 AI 伺服器及 ASIC 晶片強勁拉貨，且利用穩定

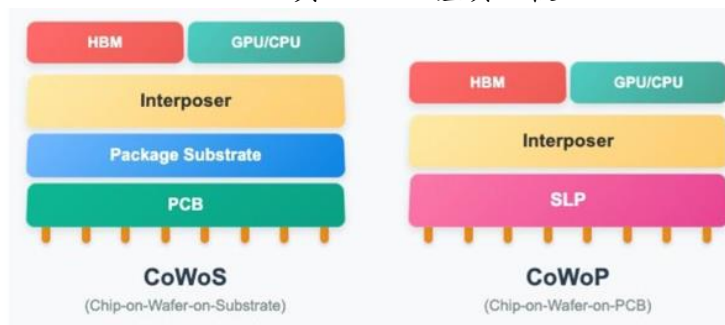
的原材料採購體系，成功消化關鍵玻纖布短缺衝擊，並透過調升產品單價以維持毛利率穩定；景碩則規劃三年內投入約新台幣 235 億元資本支出，擴建以 AI 晶片為核心的 ABF 產線，目標帶動高階產品的產能比重；南電方面，同樣受益於 AI 及高階 ASIC 需求強勢拉升，以及搭配非長約訂單使結構保持彈性，加上透過調升載板價格，顯著增強獲利能力。整體而言，隨著 AI 與高速網通應用需求爆發、關鍵原物料供給緊張推升載板報價，以及各廠商積極提升相關資本支出，皆共同驅動 ABF 產業進入新一輪成長期，形成在技術與供應能力的競爭態勢。

b. 應用領域 – CoWoP 架構興起

CoWoP (Chip on Wafer on PCB) 為 NVIDIA 於 2025 年提出的新一代先進封裝架構，其核心概念是將晶片與中介層整合後，省略傳統封裝基板，直接安裝於採 mSAP 製程的 PCB 類載板上。相較於既有的 CoWoS 架構，CoWoP 可縮短訊號傳輸路徑，提升高速傳輸效率與訊號完整性。此外，整體模組體積更有望縮減至少 30%，有助於提升 CPU、GPU 等高階晶片模組的設計彈性與整合自由度。然而，此革新也為技術帶來挑戰，有別於一般 20/20 μm 的級距，市場必須開發出符合 10/10 μm 線寬與線距的 PCB 類載板，才能支援更高密度的互連需求。

供應鏈佈局方面，CoWoP 目前已成為下世代 NVIDIA Rubin Ultra 平台的技術重心，根據 DIGITIMES 表示，相關生產設備已計畫於 2026 年第一季進駐矽品台中廠區，最快於第二季啟動試產。同時，多家 PCB 廠商如臻鼎、欣興、華通，以及 CCL 材料供應商台光電、台耀與聯茂等，也相繼投入技術開發並展開合作，顯示 CoWoP 技術自 2026 年起將逐步落地，並朝量產與供應鏈擴張邁進。

CoWoS 與 CoWoP 差異比較



資料來源：財經新報（2025 年 9 月），部分截取

c. 供應鏈領域 – 泰國 PCB 產業鏈逐步成型

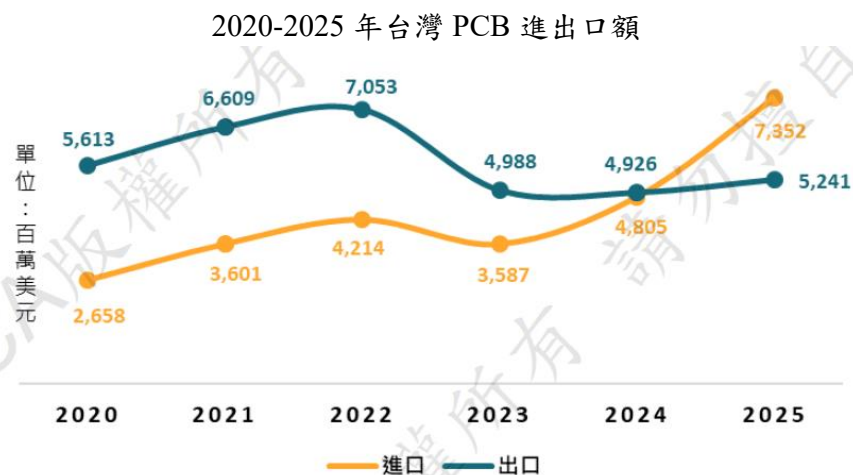
在全球企業為分散營運風險並尋求較穩定經濟環境的驅使下，泰國憑藉優越的基礎設施與投資獎勵，已成為東南亞最大、全球前五大的 PCB 生產基地。根據泰國投資委員會 (BOI) 統計，2022 年至 2025 年間，共收到 180 件 PCB 相關投資申請，總值超過 2,000 億泰銖，顯示國際資金與產能正持續向泰國集中。其中，中國大陸廠商為應對地緣政治與產能轉移，積極將泰國視為海外布局首選；台灣則在「中國加一」的策略下，由華通、欣興、臻鼎、敬鵬等 PCB 大廠進駐投資。對各企業來說，此全球化布局不僅能有效分散風險，更能藉此開拓新客戶並提升全球市佔率。

進入 2026 年，美國去中化政策與關稅壓力持續牽動全球供應鏈走勢，各廠商為迴避關稅的溯源規則，且符合泰國 BOI 的投資優惠門檻，紛紛採購更高比例的當地原物料，並加速在泰國的投產進程。以台灣 CCL 廠商為例，台耀、聯茂與騰輝預計將在 2026 年於泰國春武里府與羅勇府等地擴充產能，而華通、耀華也因應客戶需求陸續於泰國擴充低軌衛星板產能。綜合來說，隨著 PCB 與材料廠產能逐步到位，泰國不僅強化了 PCB 供應鏈的完整性，並有望在電子製造中扮演更關鍵的角色。

B.台灣印刷電路板產業

2025 年台灣 PCB 產業受惠於 AI 伺服器、高效能運算（HPC）及低軌衛星需求噴發的帶動下，展現強勁的成長動能，特別是載板、高階多層板（HLC）及 HDI 等產品表現尤為突出。同時，在全球地緣政治影響下，美系客戶為降低供應鏈風險，積極推動「非中製造」策略，促使台灣於 2025 年超越中國大陸，成為美國最大的 PCB 進口來源國，象徵全球供應鏈重心的轉移。此外，根據 TPCA 統計，2025 年台灣 PCB 產值更創下 291.3 億美元的亮眼成績，鞏固其於全球高階 PCB 供應鏈的關鍵地位。

儘管整體產值表現亮眼，然 2025 年台灣 PCB 卻出現貿易結構性反轉，全年 PCB 進口額為 73.5 億美元，高於出口的 52.4 億美元，形成約 21 億美元的貿易逆差，與過往順差格局形成對比。此現象主要因為台灣雖具備高階供應能力，但在特定高階規格及短期需求快速提升下，仍需透過外國進口補足供應缺口。因此，為強化供應鏈自主性，台廠積極深耕上游關鍵材料，如南亞塑膠與日本日東紡（Nittobo）展開策略合作生產高階玻纖布，藉此降低對海外單一供應商的依賴。同時，泰國也已成台灣業者分散風險的新據點，包括臻鼎、欣興、華通及金像電等大廠在泰國的產線已於 2025 年第四季陸續進入試產及量產階段，逐步提升整體供應鏈的彈性與靈活性。



資料來源：財政部關務署、TPCA 整理（2026 年 1 月）

展望 2026 年，台灣 PCB 市場將正式進入資本支出高峰期，主要將聚焦於高階伺服器、AI 運算及載板應用，並同步推進全球產能配置，整年產值據 TPCA 預估將提升至 332.5 億美元，年成長率約 14.1%。而在政策方面，目前台灣 PCB 輸美關稅預計降至 15%，相較於中國大陸產品高達 45% 的關稅，將有助於台灣廠商持續擴大在北美市場的競爭優勢，惟產業仍須持續強化技術能力與供應鏈韌性，以因應快速變化的市場需求。

觀察台灣各 PCB 板廠 2026 年布局，以臻鼎的擴產力道最為強勁，投資逾 500 億元於中國大陸、泰國、台灣等地建置高階產能；載板領域則由欣興與景碩領軍，分別斥資數百億元導入先進 ABF 載板產線以對應 AI 晶片需求，南電亦成功切入美系雲端服務供應商的 ASIC 載板供應鏈；高階多層板方面，金像電持續推動各地產能投產；而 HDI 代表華通則聚焦低軌衛星及 AI 伺服器應用，並持續規畫國內外新廠布局。同時，健鼎與定穎等業者皆加速海外產能建置與設備導入，以強化高階應用供應能力。隨著各項投資計畫於 2026 年陸續開花結果，台灣 PCB 產業將進一步鞏固在 AI 與高階運算供應鏈中的核心角色，並持续提升全球市場競爭力。

應用領域方面，2025 年的市場需求與技術發展仍然主要聚焦於 AI 伺服器／高效能運算（HPC）、低軌衛星兩大市場，以下將進一步說明：

a. AI 伺服器／高效能運算（HPC）

儘管 2025 年全球經濟受到地緣政治、關稅政策及匯率波動等不確定因素影響，在 AI 伺服器與高效能運算（HPC）需求的強勁帶動下，台灣 PCB 產業正加速朝向高階化與高值化轉型。應用端方面，不僅採用來自 NVIDIA GPU 伺服器的以穩固領導地位，更受惠於各大雲端服務供應商積極開發並導入自研 ASIC 晶片，進一步推升高階 PCB 與載板需求。在此多元化的架構下，高技、金像電、臻鼎、欣興等指標大廠紛紛擴張產能布局，以掌握 AI 與 HPC 帶來的長期成長機會。雖產業仍需面對消費性電子需求疲軟與庫存調整的風險，整體而言，AI 伺服器與 HPC 仍支撐著未來幾年高階 PCB 的產能與營收。

b. 低軌衛星

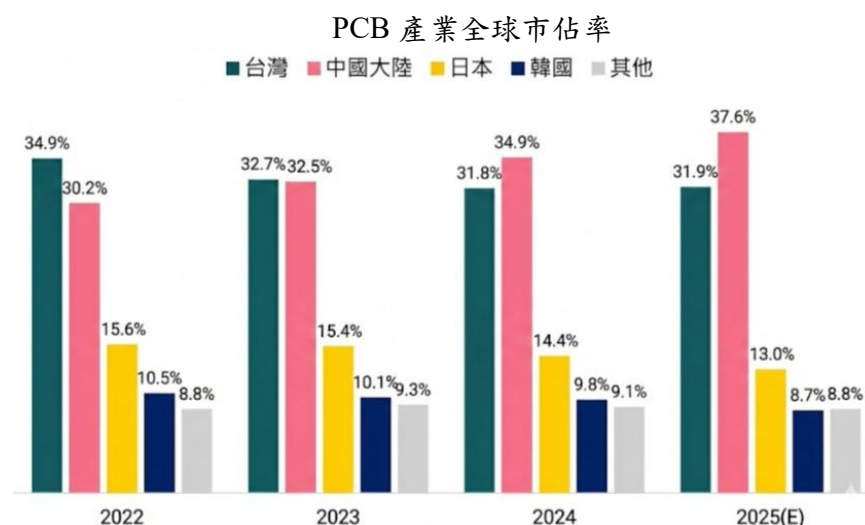
隨著全球通訊需求升級與太空基礎建設加速推進，低軌衛星（LEO）產業正由技術驗證階段邁向大規模部署，加上國際大廠如 SpaceX、亞馬遜規劃將 AI 算力中心延伸至太空等前瞻應用，進一步帶動高階 PCB 需求顯著成長。同時，由於地緣政治與供應鏈重組，也促使系統商更加重視供應來源的多元化與可靠性，進一步使具備高階製造能力的台灣供應鏈迎來新一波成長契機。

台灣 PCB 廠憑藉早期技術布局，已在衛星天線、波導及射頻模組等精密製造領域占據有利位置，其中以華通表現最為突出，不僅持續深化高階 HDI 與衛星通訊板的技術與產能布局，更成功切入供應鏈核心體系，2025 年全年合併營收達 759.96 億元，創近三年新高，其中低軌衛星（LEO）板營收預期將超過 155 億元，顯示高階衛星應用已成為重要成長動能。另一方面，為因應國際客戶對「非中非台」生產基地的需求，耀華與華通亦積極於泰國擴建產能，預計 2026 年中旬陸續量產。整體而言，隨著全球衛星布建加速與供應鏈區域化發展，台灣 PCB 廠商正逐步鞏固其在低軌衛星關鍵供應鏈中的策略地位。

C. 其他地區印刷電路板產業（中國大陸、日本、韓國）

在全球 AI 基礎建設快速擴張的帶動下，PCB 產業正迎來新一輪技術升級與供應鏈重組，中國大陸、日本與韓國亦分別展現不同發展策略與競爭優勢。中國大陸藉由 AI 基建需求與海外產能布局，加速提升產業技術門檻與供應鏈韌性；日本受惠於 AI 晶片與高階載板需求成長，積極擴充產能；韓國則在 AI 伺服器市場快速擴張的帶動下，推動本土 PCB 廠商切入高階運算與先進

封裝供應鏈。以下將針對中國大陸、日本與韓國 PCB 產業發展概況進行進一步說明：



資料來源：TPCA、工研院產科國際所（2025 年 9 月），由田整理製圖

a. 中國大陸

據 TPCA 報告顯示，2025 年中國大陸 PCB 產值約達 352.8 億美元，在全球 AI 基礎建設快速擴張的帶動下，AI 伺服器、高階資料儲存與光通訊模組需求大幅成長，成為推動產業發展的核心動能。為了在全球算力供應鏈中占據領先地位，陸系廠商正加速技術轉型，將研發重心轉向高多層板（HLC）與高階連繫板（HDI）傾斜，並持續強化高頻高速板的製造能力。儘管地緣政治與貿易關稅帶來不確定性，高性能運算的剛性需求仍支撐產業邁向全球首位，預計 2026 年產值將進一步攀升至 418.7 億美元，雖然受高基期影響成長率小幅放緩，但年增率仍可望維持在 18.7% 的高水位。

政策方面，中國大陸於 2025 年發布「電子資訊製造業 2025—2026 年穩成長行動方案」，積極推動電子製造業朝高階化與高品質發展，並以 AI 伺服器、5G/6G 通訊與 XR 裝置等新興應用為重點，進一步帶動 HDI、高頻高速板、軟板及載板等產品需求同步提升。同時，政策亦強調持續強化本土供應鏈整合，促使 PCB 廠與上游材料供應商建立更緊密合作關係，以降低對國際供應鏈的依賴並提升整體產業自主性與韌性。

觀察應用市場領域，中國已從傳統的內需生產基地轉型為全球關鍵的汽車出口國，新能源汽車的快速普及進一步帶動高階車用 PCB 需求成長。相較於傳統燃油車以單雙面板為主，電動車的電池管理系統、充電設備，以及智慧座艙與先進駕駛輔助系統等，均採用多層板與 HDI 等高階產品，使車用電子成為 PCB 產業的重要成長動能之一。隨著中國汽車品牌在全球市場影響力持續提升，加上完整供應鏈與成本優勢，使其逐漸成為全球車用電子供應鏈的關鍵樞紐。

在供應鏈布局方面，中國大陸 PCB 廠商除持續擴充本土產能外，也積極推動海外設廠，以分散地緣政治風險並提升全球供應能力，預計於 2025 至 2026 年間於泰國及越南等地陸續投產，持續強化其在全球市場中的競爭力。以下為中國大陸主要 PCB 廠商動態及近期計畫：

中國大陸主要 PCB 廠商動態

廠商	主要PCB產品	發展動態
東山精密	1.軟板(70%)	高階 PCB 與泰國廠產能預計於 2026 上半年起逐步開出，全面擴張 AI 供應鏈版圖。
深南電路	1.多層板(51%) 2.HDI (30%) 3.載板(19%)	廣州 ABF 新廠產能快速提升，同時投資 1.8 億美元建設泰國新廠，布局高階 HDI 與多層板技術，深化海外市場。
勝宏科技	1.多層板 (40%) 2. HDI (35%) 3.軟板(20%)	啟動5.2億美元的越南新廠投資案，專攻高端多層板與HDI技術，預計投產後年產值將達10億美元。
建滔集團	1.多層板 (45%) 2. HDI (40%)	PCB 業務已占集團營收三成並維持強勁成長，同步加速海外佈局，泰國與越南新廠均預計於2026年投產，合計每月將新增超過230 萬平方英尺產能。
景旺電子	1.多層板 (40%) 2. HDI (30%) 3.軟板(25%)	跨足AI伺服器與衛星通訊等新興市場。泰國廠主體已於2025年完工並進入設備安裝階段，預計於2026年上半年正式投產。

資料來源：TPCA、工研院產科國際所（2025年10月）

b. 日本

日本 PCB 在市場動能方面，2025 年主要受惠於 AI 伺服器需求強勁，使 AI 晶片與 HDD 相關應用成為成長核心，同時因應關稅變化預期所出現的提前拉貨效應，進一步推升手機與相機模組軟板需求回溫。此外，因日圓升值因素，以美元計價的產值也隨之成長，使整體產業即使在車用市場受中國低價競爭與歐洲景氣疲弱影響下，仍維持穩健增長。根據 TPCA 統計，2025 年日本 PCB 產值約達 117.3 億美元，顯示日系 PCB 仍保持穩定表現。展望 2026 年，AI 伺服器仍將是主要成長引擎，隨著載板與半導體相關應用比重持續提升，預估產值可達 127.3 億美元，年增率約 8.5%。

從產品布局來看，日本 PCB 廠商近年紛紛將重心從傳統消費電子的軟板，轉向高階運算與先進封裝載板領域，各大業者亦積極投入資本支出，擴充 ABF 等高階 PCB 產能，以鞏固在全球半導體供應鏈中的關鍵地位。在海外布局方面，日本則加速於東南亞建立生產據點，重點聚焦 AI 伺服器與車用 HDI 產線建設。同時，部分企業透過國際合資模式整合外部資源，以更快切入 AI 伺服器所需的高階多層板市場，展現更具彈性的全球化競爭策略。以下將進一步說明日本主要 PCB 廠商動態及近期計畫：

日本主要 PCB 廠商動態

廠商	主要PCB產品	發展動態
MEKTEC	1.軟板 (100%)	公司將聚歐美主要 OEM 車廠市場，以避開中國低價競爭，其中福斯汽車的電池軟板訂單預期自 2026 年起出貨將明顯成長。
Ibiden	1.載板 (100%)	受惠於AI伺服器GPU晶片需求強勁，大野新廠已於2025年Q3投產並預計提升五成產能。
TOPPAN	1.載板 (100%)	透過新潟廠2027年投產計畫與石川廠試驗產線的建置，將持續擴充高階載板產能，全面支援次世代產品量產。
MEIKO	1.HDI (55%) 2.多層板(43%)	公司透過擴建越南新廠與博智電子合資，全力加速佈局 AI 伺服器與車用高階板（HDI/HLC）產能。
日東電工	1.軟板 (100%)	手機與AI資料中心帶動軟板與HDD應用需求成長，公司正擴充越南平陽廠產能，強化數據中心與手機市場布局。

資料來源：TPCA、工研院產科國際所（2025年10月）

c.韓國

根據 TPCA 顯示，2025 年韓國 PCB 產值約為 82.2 億美元，成長動能由傳統消費性電子轉向 AI 伺服器與記憶體相關應用，其中自駕晶片與高階載板需求快速升溫，成為帶動產業升級的關鍵力量，而韓國也憑藉其在記憶體產業的全球領先優勢，進一步強化在載板與半導體供應鏈中的角色。展望 2026 年，在 AI 伺服器對高階記憶體與高速傳輸載板需求持續擴張的帶動下，相關應用比重可望進一步提升，2026 年 PCB 市場產值預估將來到 88.4 億美元，年成長率約 7.5%。然在手機市場方面，由於仍受中國大陸價格競爭與終端需求復甦疲弱影響，預期短期內難以成為主要成長來源，因此整體產業成長幅度於近年將維持相對溫和。

產業布局方面，為降低消費性電子景氣循環波動所帶來的風險，韓國主要 PCB 廠商正加速調整產品與產能結構，將資源集中於 AI 伺服器、HPC 及車用半導體等高附加價值領域。本土產線著重建構高階 ABF 載板與先進封裝相關技術能力，強化與半導體客戶的策略合作關係；海外布局則以馬來西亞為近年擴產重心，積極提升 BT 載板與相關產能，以因應全球記憶體與 AI 應用的長期需求，強化供應鏈韌性與國際競爭力。以下將進一步說明韓國主要 PCB 廠商的最新動態與發展計畫：

韓國主要 PCB 廠商動態

廠商	主要PCB產品	發展動態
SEMCO	1.載板(100%)	受惠伺服器與 PC 需求，AIGPU 與 BT 載板出貨穩健，並持續擴大對 Tesla 自駕晶片 ABF 載板供應。

廠商	主要PCB產品	發展動態
BH	1.軟板(100%)	受顯示器客戶競爭加劇影響，軟板單價承壓、短期獲利受限。但隨 Apple Inc. 摺疊機推出，公司中長期營收可望受惠成長。
Korea Circuit	1.HDI(33%) 2.軟板(31%) 3.多層板(28%)	受手機需求疲軟影響，業績短期下滑，但ABF載板隨記憶體模組需求與Broadcom訂單增加，營運動能逐步回升。
Simmtech	1.載板(73%) 2.HDI(27%)	受惠於記憶體回溫與AI伺服器需求成長，公司將於2026年量產GDDR7與SoC-AMM產品。而馬來西亞廠已完成第二期擴建，目標提升海外營收占比至20%。
ISU Petasy	1.多層板(100%)	受AI伺服器與高階網通需求推動，公司計畫自2026年起分階段提升大邱第5工廠HLC產能至12,500m ² 。

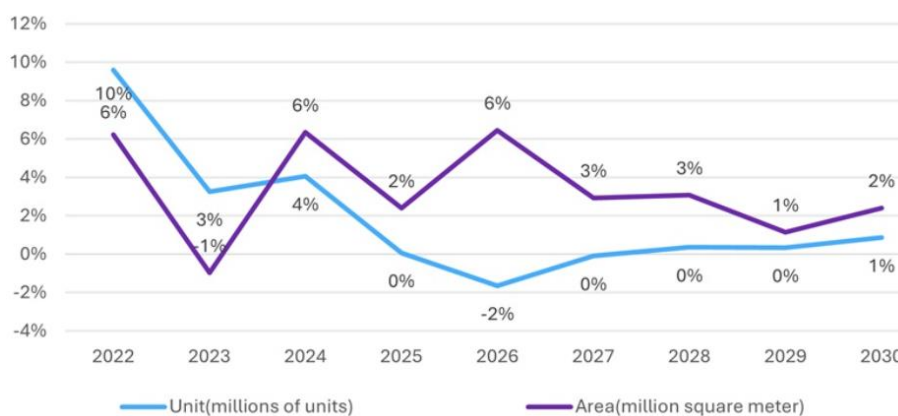
資料來源：TPCA、工研院產科國際所（2025年10月）

(2)平面顯示器(FPD)產業

A.全球平面顯示器產業

平面顯示器市場隨著2023年觸底，2024年逐季改善後，2025年主要受益於包含電視及遊戲顯示器等大尺寸面板需求提升，以及摺疊智慧型手機與AI PC等新技術產品需求增長，整體面板產業維持穩健表現。然因終端消費需求復甦不如預期，加上美國關稅政策引發供應鏈變化，導致顯示器產業供應鏈重組成本上升，品牌拉貨態度趨於保守。在此背景下，根據Global Industry Insights指出，2025年全球顯示面板市場規模雖達1,877.7億美元，然而Omda機構預估，面板面積需求成長率僅2%，低於2024年的6%，顯示面板市場成長動能趨緩。

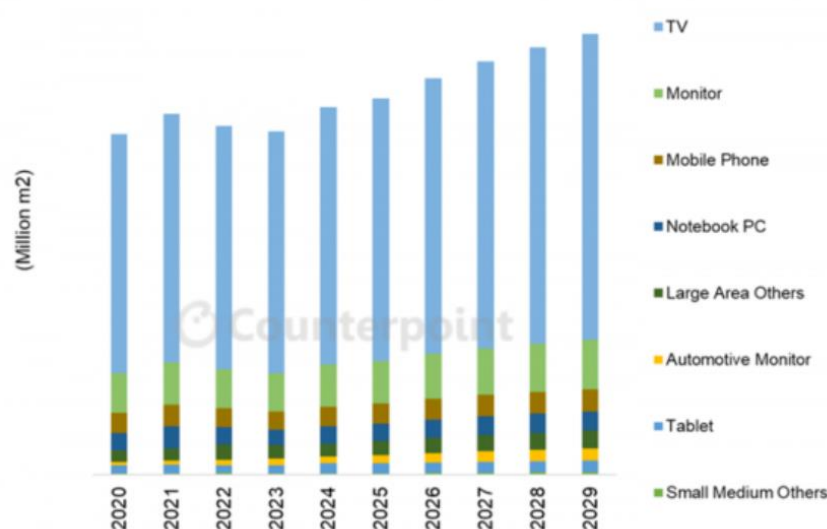
顯示面板需求年增長率



資料來源：Omda，2025年11月

綜觀全球顯示器應用領域中，電視面板仍為市場主流，佔據了顯示面板70%以上的需求，主要動能來自平均螢幕尺寸持續放大，並搭配小幅的出貨量成長，使2025年全球大尺寸液晶電視面板的出貨量提升，據洛圖科技（RUNTO）報告指出，達到2.45億片，年增3.4%。此外，Counterpoint調研機構也表示，電視面板平均尺寸自2023年到2029年間估計將增加4.4吋，成為推動整體面板需求成長的關鍵因素。以電視技術面來看，LCD電視持續保持領先定位，尤以中國超過七成的市佔穩居產業龍頭，其主要成長來自於TCL科技收購LGD廣州8.5代線，進一步擴充產能，而台廠群創、友達合併市佔則為22%；而採用Mini LED技術之電視則成為2025年出貨增長最快的產品，據Omdia預估，年增幅高達82.9%，展現高階技術在電視市場的強勁成長表現。

全球各應用顯示面板需求面積



資料來源：Counterpoint（2026年6月）

展望2026年，全球顯示面板市場在經歷2025年成長放緩後，據Omdia指出，整體面板面積需求有望回到6%的成長水準，主要增長動能除顯示器持續朝大尺寸化發展外，更因2026上半年FIFA世界盃等大型活動推升動能，電視業者紛紛提前展開策略性備貨，為支撐市場的主要助力。技術結構方面，LCD技術仍為電視應用主流，OLED則在智慧型手機、高階電視等產品中持續擴大滲透率，成為成長速度最快的顯示技術之一。

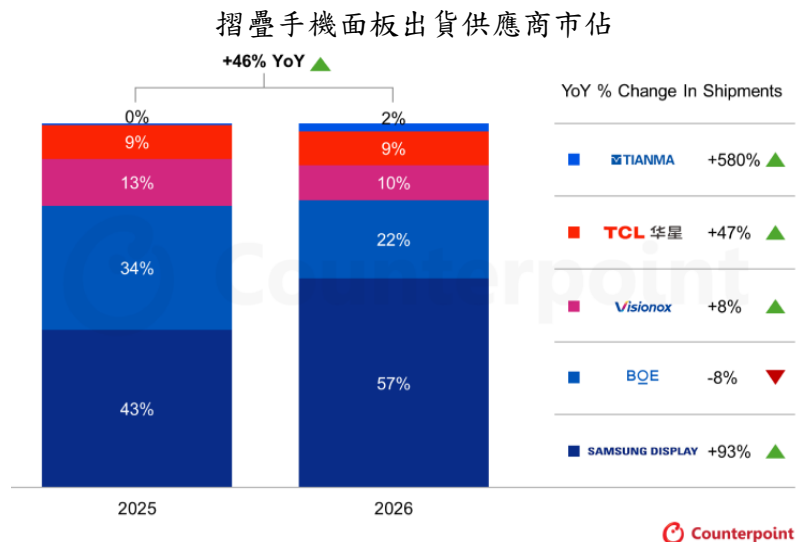
然而，雖面板面積需求預計將有所回溫，以出貨量來看仍預估會呈現下滑趨勢，主因為電視生產成本逐漸上升，相關應用之記憶體與貴金屬價格也同步漲價，預估成本推升將衝擊消費者買氣，其中TrendForce即指出，2026年電視出貨量估計為1.948億台，較2025年下滑約0.6%，象徵出貨逐步走弱。在整體出貨量趨於保守的情況下，值得注意的是，雖大型尺寸仍為出貨主流，然具備移動性與可攜性的小尺寸電視或將成為支撐2026年出貨量的因素之一，據DIGITIMES預估，移動式小尺寸電視全球市場規模有望於2030年達40億美元，2026年至2030年間複合年均成長率更有望超過五成，扭轉小尺寸電視困境並提升銷售利潤。

進一步分析 2025 年顯示器主要應用及其發展趨勢，可以分為摺疊智慧型手機、筆記型電腦、AI+AR 眼鏡三大面向，應用分析如下：

a. 摺疊智慧型手機

隨著全球智慧型手機換機週期持續拉長，產業需提供突破性創新產品，以刺激消費者換機及購買意願，而近年摺疊機與三摺機已逐漸成為關鍵解方，加上以價格而言，儘管摺疊機單價上比一般智慧型手機更高，消費者更注重其在大螢幕及類似於平板級生產力的優勢。據 IDC 預估，2025 年全球摺疊手機出貨量將達 2,060 萬支，年增 10%。此外，Global Industry Insights 也指出，折疊式智慧型手機市場規模將達 313 億美元，顯示終端消費者對摺疊手機的接受度正大幅上升。

細看供應商方面，三星顯示憑藉技術累積及多家廠商驗證，加上具備產能優勢，於 2025 年佔全球摺疊手機面板市場 43% 的比例，預估未來隨著生產及供給增加，市佔將逐漸擴大至超過 50%；京東方則以 34% 的佔比成為出貨第二名，不過其良率的穩定度目前仍為主要考驗；其餘緊追在後的廠商則為維信諾（10%）、TCL 華星（9%）、天馬（2%），顯示摺疊顯示面板目前仍是以韓國及中國供應商為主。



資料來源：Counterpoint（2026年12月）

以全球消費市場來看，據 Global Industry Insights 表示，亞太地區為全球折疊式智慧型手機最主要的市場，其中，中國同時支撐全球供應與內需市場，本土 OEM 廠商透過省級補貼擴大 8.6 代 OLED 產能；韓國則為全球人均折疊式裝置滲透率最高的市場；日本延續了輕巧裝置的使用習慣；而印度市場因人均可支配所得受限，僅都市地區展現穩定成長動能。第二大市場則為北美地區，主要受惠於電信商積極的補貼策略，尤其美國在 5G 方案推廣下維持領先地位，加拿大則呈現相對溫和成長。相較之下，歐洲除北歐及西方市場已逐漸廣泛採用折疊智慧型手機，南歐則因價格敏感度高轉型較為緩慢。總結來說，折疊智慧型手機於亞太地區未來將持續擴大市佔，不過後續成長動能會逐步轉向至北美與西方企業需求，以及新興市場中更具價格彈性的產品布局。

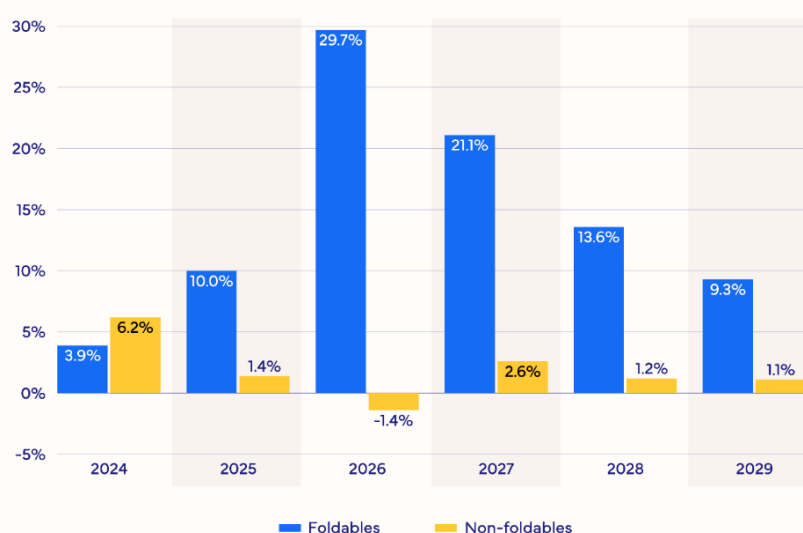
展望 2026 年，全球摺疊手機市場預計迎來關鍵成長轉折，主要原因為蘋果 (Apple) 的首款摺疊 iPhone 將強勢帶動面板出貨量，根據 Counterpoint

Research 報告指出，2026 年全球摺疊手機面板出貨量將年增約 46%，顯示市場預期因蘋果正式進軍摺疊智慧型手機市場而使需求明顯升溫。相較之下，IDC 預估，2026 年非摺疊型手機出貨將呈現負成長（-1.4%），顯示智慧型摺疊手機已逐步成為推動手機產值增長的核心產品。

進一步觀察需求結構，2026 年主要由三星、華為與蘋果三大品牌共同驅動。三星預計延續 Z Fold7 的強勢表現，透過 Galaxy Z Trifold 將三摺設計導入主流市場；華為則預期出貨量相較前一年將呈近翻倍成長；蘋果方面預計於 2026 年底推出首款摺疊機，由於其擁有強勢的品牌價值與消費市場，IDC 指出，iPhone 摺疊機首年即有機會取得 22% 的出貨市占率，並掌握高達 34% 的市場價值。整體而言，蘋果的加入將驅使智慧型摺疊機呈三強鼎立的局面。

摺疊手機與非摺疊手機年出貨成長率

2024-2029



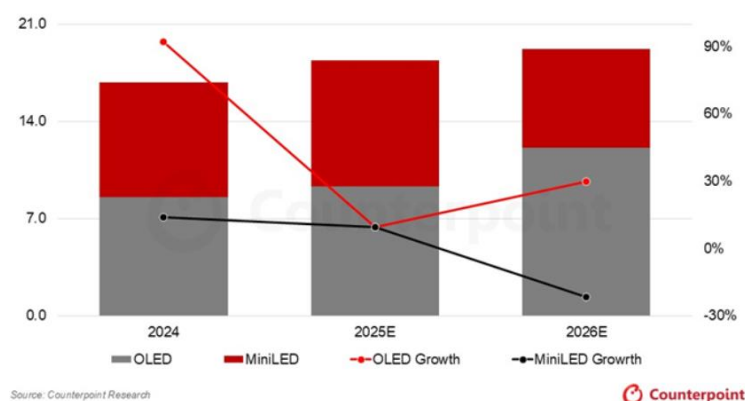
資料來源：Counterpoint（2026年12月）

b. 筆記型電腦

全球筆電面板於 2025 年主要受 AI 應用導入需求增加、企業汰換升級，以及新產品的持續推出等因素而提升整體市場動能，儘管面臨關稅政策的不確定性與相關組件漲價的消息影響，全年消費市場仍呈現緩步上升，據 Counterpoint Research 報告指出，2025 年全球筆電顯示面板出貨量將成長 4%，市調機構 Omdia 也顯示，整年筆電產品出貨量達約 2.2 億台幣，佔所有個人電腦出貨佔比的 78.87%，顯示筆記型電腦依然是主要成長動能。

技術結構方面，據 Counterpoint Research 研究顯示，搭載 OLED 與 Mini LED 的高階筆電面板出貨量預期年增 9%，市佔率提升至約 8%，象徵高階筆電市場正加速轉向先進顯示技術，面板升級已成為品牌差異化與產品溢價的重要手段。其中，尤其在 OLED 筆電面板於 2025 年累積的出貨基礎與供應鏈成熟度，都將為後續放量奠定關鍵基礎。

筆電顯示面板出貨成長及市佔
Notebook PC Panel Shipments and Advanced NB PC Growth, 2024 – 2026 (E)



資料來源：Counterpoint Research（2025年10月）

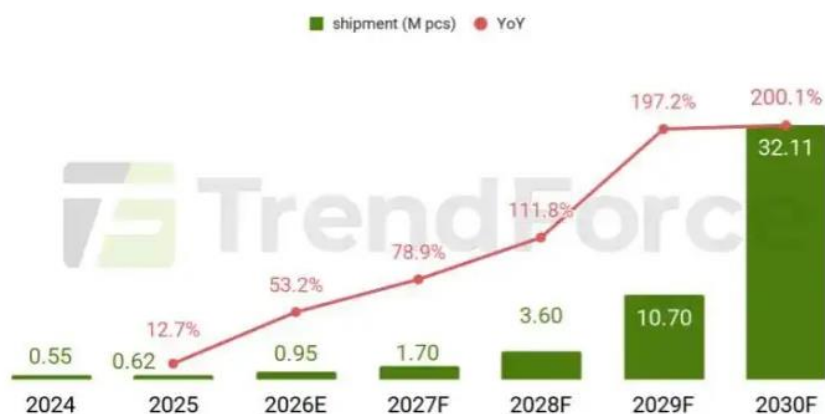
展望 2026 年，由於筆電高度依賴供應鏈與市場需求，記憶體價格上漲及成本拉升都將使全球筆電出貨量面臨走弱的困境，根據 TrendForce 預估，2026 年全球筆電出貨將年減 5.4%，甚至不排除超過 10% 年減之可能性。其中 LCD 面板將面臨較顯著的需求下修，僅 OLED 面板因蘋果即將上市的 OLED MacBook Pro 帶動，預估 2026 年將維持正成長，成為推動新高階、高效能筆電顯示面板的關鍵因素。

c.AR+AI 眼鏡

隨著 AI 技術與穿戴式裝置的融合興起，加上 Meta 於 2024 年發表的 Meta Ray-Ban Display Glasses 在市場取得優於預期的成績，驅使 AR 眼鏡市場在 2025 年持續升溫。據 TrendForce 報告指出，2025 年全球 AR 裝置出貨量預估年增 9.1%，達約 62 萬台，顯示資訊提示型 AR 應用已逐步成形。另一方面，Meta 在 AR 眼鏡的成功也將帶動包括 Samsung、Google、Apple 等大廠加入自有品牌 AR 眼鏡的戰局，然隨著消費者的新鮮感逐漸消退，實際的使用體驗及舒適度將會成為品牌競爭的關鍵。

進入 2026 年，AI 仍是推動 AR 眼鏡市場快速擴張的核心動能，加上各大品牌積極投入、產品持續推陳出新的帶動下，TrendForce 預估 2026 年全球 AR 眼鏡出貨量將達 95 萬台，年增率高達 53%，市場進入加速成長期，並展望 2030 年能朝 3,000 萬台以上規模邁進。除此之外，隨著技術成熟與量產規模提升，產品價格有望於未來兩年進一步下降，加速推動市場的規模與普及。在顯示技術方面，中系業者積極導入 AI 助理、Micro LED 與輕量化設計，如 JBD 已為 AR 眼鏡研發出支援 10,160PPI 的 Micro LED 顯示器，預計 2026 年下半年量產；韓系廠商則持續投入 Micro LED、OLED-on-Silicon 與光學模組研發；台系業者多聚焦於關鍵零組件與供應鏈角色，共同推動 AR 眼鏡走向高畫質與 AI 整合的新階段。

2024-2030年全球AR眼鏡出貨量預估



資料來源：TrendForce（2026年01月）

展望2026年顯示技術的產業趨勢，預期將有以下發展要點：

a.OLEDoS

目前隨著 VR、MR 與 AR 等近眼裝置應用快速擴展，市場對顯示技術的解析度、刷新率與體積有更高要求，而 OLEDoS 技術已成為多數品牌發展近眼顯示的核心方案之一。OLEDoS 結合半導體製程與 OLED 自發光特性，雖然在亮度表現上存在先天限制，但整體性能仍使其成為近年終端市場關注度最高的主流微顯示技術之一，其中包括蘋果的 Vision Pro MR、三星的 Galaxy XR 以及 Vivo 的 vivo Vision 皆採用 OLEDoS 顯示技術。而在應用領域中，單 2025 年 11 款 OLEDoS 近眼顯示產品，就有 6 款為 AR 眼鏡，2026 年佔比也估計會持續成長，皆展示出 AR 眼鏡為 OLEDoS 技術導入最集中的類型。

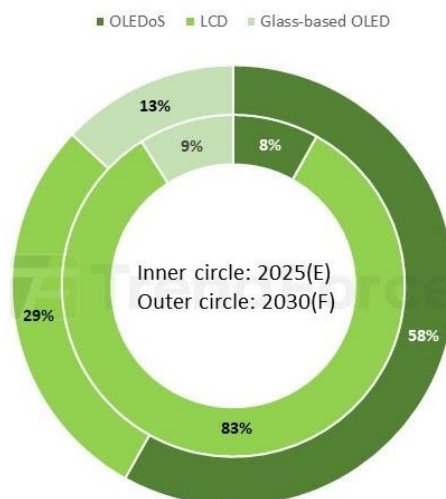
2025年OLEDoS產品

品牌/廠商	產品名稱或型號	關鍵規格與技術亮點
Apple	Apple Vision Pro (2025升級版)	雙 OLEDoS 顯示屏，2300萬像素，92% DCI-P3色域
Samsung	Galaxy XR	搭載4K級OLEDoS 顯示器
Pimax	Crystal Super	搭載高規OLEDoS 面板
BOE (京東方)	0.49 吋 AR 眼鏡 (原型)	像素密度高達4496 PPI的 OLEDoS 微顯示器
DJI	DJI Goggles 2	採用視涯科技(SeeYA)供應的 FHD 級OLEDoS面板
Samsung Display	1.3 吋 RGB OLEDoS	亮度突破 20,000 nits，4200 PPI，業界目前最高亮度規格
eMagin (三星子公司)	0.62 吋 White OLEDoS	亮度 10,000 nits，厚度僅 0.35mm

資料來源：LEDinside（2025年12月），部分摘錄

展望未來，在 VR／MR 裝置持續朝向輕量化與更高解析度發展的趨勢下，OLEDoS 的製程成熟度與成本結構正逐步改善，相較現行的 LCD 與玻璃型 OLED，具備更高的技術潛力與成長空間。TrendForce 預估，2030 年 OLEDoS 全球 VR/MR 市佔率將提升至 58%。而 AR 眼鏡方面，憑藉高畫質表現與逐步完善的供應鏈，仍可在多元應用中維持一定競爭力，預期 2030 年將保有 20% 以上市占。整體 VR、MR、AR 裝置對 OLEDoS 的需求，預計至 2030 年可達 3,150 萬片，2025 至 2030 年的年複合成長率高達 81%，顯示該技術仍處於高速成長階段。

2025年與2030年VR/MR裝置顯示技術滲透率

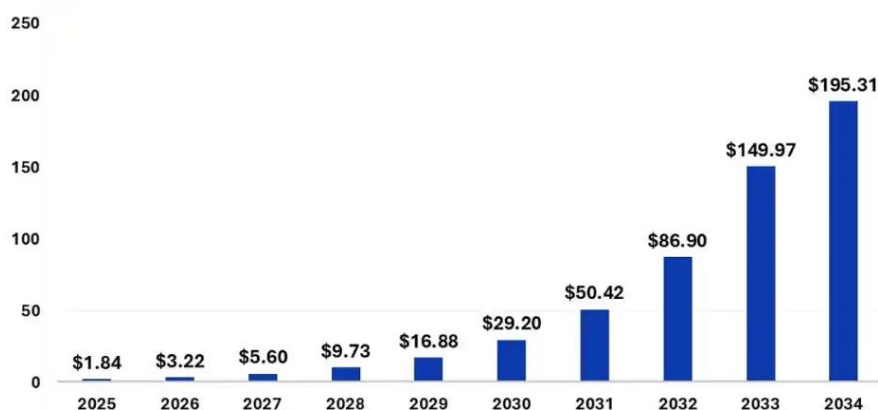


資料來源：TrendForce（2025年12月）

b. Micro LED

近年 Micro LED 技術正逐步從研發階段邁向商業化應用，隨著關鍵製程優化、供應鏈逐漸成熟等因素，其市場滲透率正持續加快。據 TrendForce 指出，雖 Micro LED 初期以消費電子與利基市場為主，也需與既有技術競爭成本與效能，但市場前景仍被看好。Precedence Research 研究即顯示，全球 Micro LED 市場規模至 2030 年可達約 290 億美元，指出目前已正式進入商業化成長初期，並具備長期發展潛力。

2025年-2034年Micro LED市場規模預測（十億美金）



資料來源：Precedence Research（2025年11月）

應用領域方面，由於 Micro LED 已正式進入商業化階段，尤其在穿戴裝置、車用顯示與智慧眼鏡顯示強勁的市場成長動能。首先，相較於 OLED 與 LCD，Micro LED 在小尺寸螢幕的穿戴裝置擁有更高對比性的優勢，為消費者帶來升級體驗，其中 Garmin 就於 2025 年推出全球首款由友達扮演關鍵供應角色的 Micro LED 手錶，象徵著穿戴裝置在高附加價值技術應用上的突破與推進；車用市場方面，搭載 Micro LED 技術的抬頭顯示器等透明顯示裝置，具備高亮度與耐環境的特性，也被視為高速成長的領域之一；最後，搭配光波導設計的 AR 智慧眼鏡同樣被視為未來重點發展方向。總結來說，小尺寸／大尺寸顯示、透明顯示與近眼裝置將共同推動 Micro LED 逐步擴大的應用版圖及市佔。

c.RGB LED

RGB LED 背光技術近年成為高階 LCD 顯示的重要升級方向，其核心概念以紅、綠、藍三色 LED 取代傳統白光 LED 作為背光源，並透過更精細的區域控光能力，提升色彩純度、對比度與能源效率。隨著 LED 持續微型化，RGB LED 可實現更高密度排列，甚至朝向以像素等級進行亮度與色彩調整，使畫面細節呈現更佳。在市場應用方面，各大品牌廠已開始積極導入相關技術，例如海信於 CES 2026 前發布新一代 RGB Mini LED 背光電視，預計率先於中國市場推出，而 Samsung、LG、Sony 等大廠也皆紛紛加入戰局，顯示 RGB 背光正逐步成為高階 LCD 差異化的重要發展方向。

在技術演進方面，RGB LED 的微型化也進一步延伸出 Micro RGB LED 概念，即將三色 LED 縮小至微米等級並提高排列密度，使背光控制更精準且更接近像素級調光。在 OLED 成本與壽命仍具挑戰、Micro LED 量產尚未完全成熟的情況下，Micro RGB LED 兼顧畫質提升、可靠度與量產可行性的特色，成為市場在能夠正式量產 Micro LED 前的過渡方案，尤其適用於高階電視與大型顯示產品。總結來說，RGB LED 未來可望朝更高解析度與更精細控光能力發展，並逐步為 Micro LED 顯示技術的普及奠定基礎。

(3)半導體 (Semiconductor)產業

A.全球半導體產業

2025 年，在人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 應用的持續挹注下，全球半導體持續擴張，展現強勁成長態勢。根據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 預估，受惠於資料中心基礎設施擴建以及邏輯晶片與記憶體市場強勢復甦，預估 2025 年全球半導體營收將上修至 7,720 億美元，年增率達 22.5%，成長幅度優於原先預期的 15.5%。此成長態勢不僅由技術及市場需求驅動，亦受各國政策影響，全球供應鏈因應關稅政策而進行的預防性備貨，也進一步推升了出貨需求。整體而言，2025 年半導體產業鏈在生成式 AI 帶動下，從晶片設計、高速傳輸、邏輯演算、記憶體到先進封裝技術，正經歷全方位的技術進化與價值重估。

全球半導體市場規模及年成長率

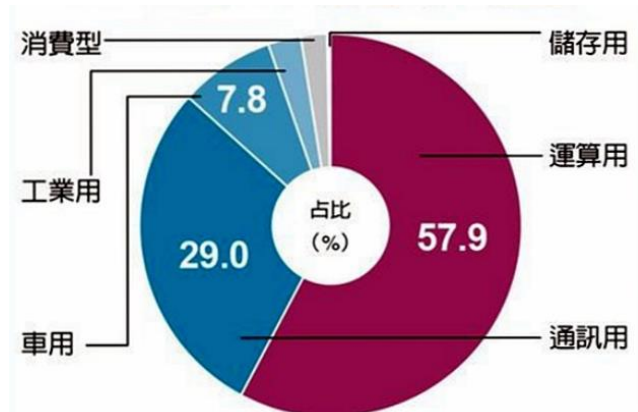


資料來源：世界半導體貿易統計組織（2025 年 12 月）

另一方面，半導體產業正同時面臨技術演進與地緣政治的複雜挑戰，各國政府為強化區域供應鏈韌性，積極推動半導體製造自主化，包含美國、台灣、中國、日韓及歐洲等地的補貼政策正加速製造重心重組，為全球產業布局帶來新變數。據工研院產科國際所表示，半導體供應鏈已由「全球化分工」朝向「區域製造韌性」轉變，在此趨勢下，產業鏈上下游的投資決策亦更加重要，未來如何在技術創新、成本控制與供應鏈安全之間取得平衡，將成為半導體企業維持長期競爭力的關鍵。

在全球數位轉型與高效能運算需求持續攀升的趨勢下，AI 在半導體市場的應用佔比逐步上升，已成為推動半導體產業的主要成長引擎之一，據研究機構 Gartner 預估，2025 年 AI 半導體市場將占全球半導體的 15.1%，尤以運算用領域的 57.9% 占比最多，第二、三名分別為通訊用 (29.0%) 及車用 (7.8%)，以下將針對此三大應用領域於 2025 年的亮點及趨勢說明：

2025 年全球 AI 半導體應用市場比重

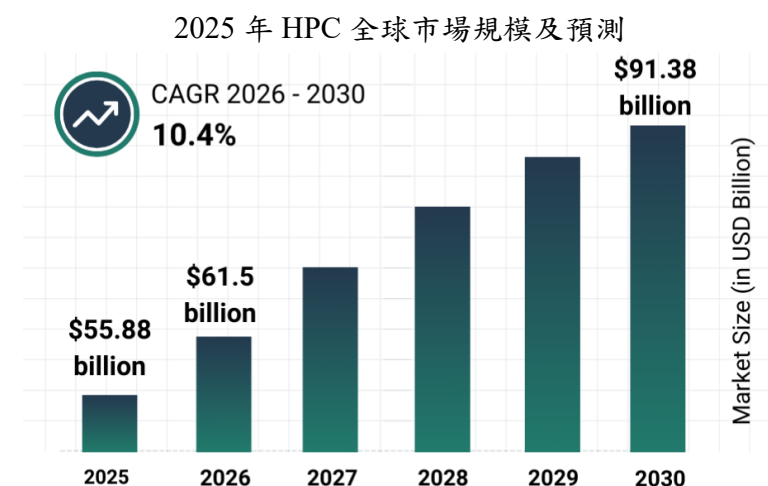


資料來源：Gartner（2025 年 10 月），工研院製圖

a. 運算用半導體 – 高效能運算 (HPC)

在 AI 快速普及算力需求爆發的帶動下，高效能運算 (HPC) 已成為支撐數位經濟與科技創新的核心基礎。從金融分析、健康預測、氣候研究、到已逐漸融入生活應用的 ChatGPT、Gemini、Claude 等生成式 AI，背後皆仰賴龐大的 HPC 基礎設施，加上企業端的運算需求持續增加、政府加碼超

級電腦的投資，以及工程模擬等科學研究需求不斷上升，都使 AI 掀起的算力革命將全球 HPC 市場推向新一波成長。根據 The Business Research Company 預估，2025 年 HPC 市場規模達 558.8 億美元，至 2030 年將成長至 913.8 億美元，年複合成長率約 10%，顯示其已成為驅動半導體長期成長的重要核心動能。



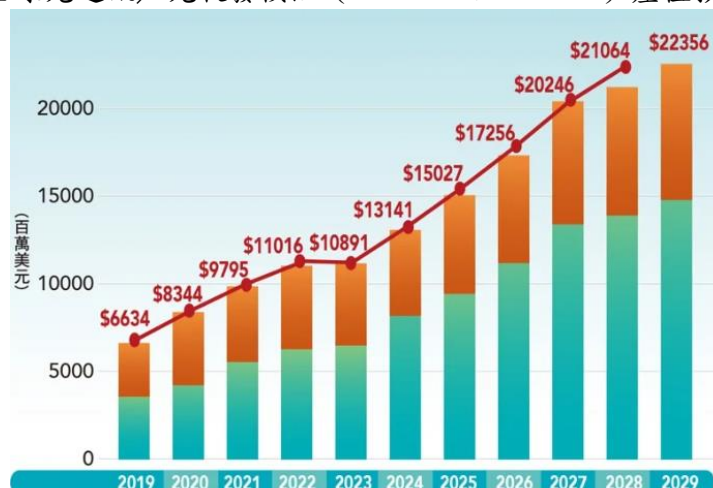
資料來源：The Business Research Company（2026 年 2 月）

從市場供應面來看，AI 所帶動的算力革命正加速 HPC 生態系重塑，CPU、GPU、儲存與伺服器等關鍵硬體需求同步提升，促使各大企業持續加碼投資超級電腦與資料中心建設。尤其在這波算力基礎設施擴張趨勢下，GPU 已成為推動 AI 運算效能的核心關鍵。其中，NVIDIA Blackwell GPU 憑藉領先的技術優勢，在基於 GPU 的 AI 伺服器領域中，市占率估計高達 90%，而 AMD 則憑藉其產品競爭力，約占 7%至 8%。相較之下，雲端服務供應商（CSP）研發的客製化 ASIC，以及中國本土晶片供應商，在美國出口管制政策的框架下，市場份額預期將維持平穩，反映出高效能運算市場目前仍高度依賴頂尖供應鏈的技術與產能支持。

b. 通訊用半導體 – 光通訊

隨著 AI、資料中心持續擴展，傳統銅線電子訊號的傳輸方式已漸漸達到寬頻與耗能上的瓶頸，加上電訊號在長距離傳輸時會有延遲與功耗增加的困境，因此，具備大寬頻、低延遲、抗干擾性的光通訊，已成為因應巨量數據傳輸的關鍵解方。除此之外，由於雲端運算、AI 應用、5G/6G 通訊、車用電子與醫療影像等數位化需求快速增加，高速資料傳輸的重要性將持續提升，也進一步推動光通訊市場成長。據 Yole Group 表示，全球光通訊與網路市場規模將由 2022 年的 213.6 億美元成長至 2032 年的 487.4 億美元，年複合成長率達 8.6%。以產品端來看，富士總研指出，2025 年全球光收發器市場規模將擴大至 3.7 兆日圓，其中，2025 年 AI 資料中心主流規格已從 400G 全面轉向 800G，TrendForce 即預估，800G 以上光收發模組於 2025 年的出貨量將達 2,400 萬，並逐年上升，顯示光通訊在 AI 等半導體領域的需求上呈現大幅度增長。

全球光通訊／光收發模組（Datacom+Telecom）產值預測



資料來源：Yole Group、穩懋（2026 年 2 月）

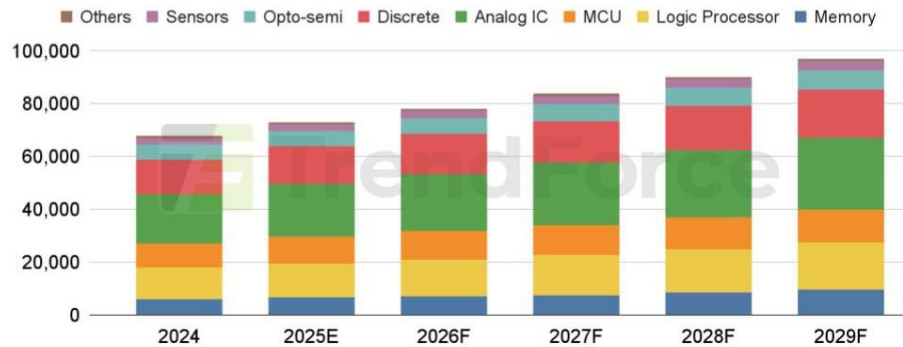
供應鏈方面，光通訊的快速發展與技術升級吸引大量雲端服務商及晶片大廠進行布局。以應用端來看，Google、Amazon、Microsoft 與 Meta 等超大型雲端服務商，為因應生成式 AI 模型動輒數百億甚至兆級參數所帶來的龐大資料交換需求，正加速導入光學互連技術。舉例來說，AWS 將於下一代 Trainium4 晶片整合 NVLink 技術，以強化大規模 AI 訓練與推論能力。核心技術端方面，NVIDIA 將光學元件與交換器 ASIC 整合，朝取代傳統可插拔光收發器的方向發展，Intel、Broadcom 與 Marvell 等網通與晶片大廠亦積極投入矽光子產品開發並逐步量產。總結來說，在頻寬與能耗限制逐漸成為瓶頸的情況下，光通訊已從輔助技術轉變為支撐超大型資料中心與 AI 基礎建設不可或缺的核心關鍵。

c. 車用半導體 — 高階晶片驅動智慧發展

隨著汽車產業邁向數位化與智慧化，全球汽車半導體市場將大幅成長，主要受先進駕駛輔助系統（ADAS）、電動車（EV）和智慧車輛的普及帶動，不論是在自動駕駛、智慧駕駛艙、動力系統及安全控制等領域，汽車半導體皆扮演不可或缺的關鍵應用角色。例如，高性能晶片可支援即時感知與決策、提升駕駛互動體驗並優化能源效率，同時支援 ADAS 和穩定性來增強安全性和控制能力，這些技術涵蓋了邏輯晶片、記憶體晶片、微處理器與類比晶片等，皆顯著提高了車輛性能和使用者的體驗。根據 TrendForce 調查，全球車用半導體市場規模預估從 2024 年 677 億美元增長至 2029 年約 969 億美元，年複合成長率高達 7.4%。尤其在電動車方面（含 BEV、PHEV、FCV、HEV）市場滲透率將上升至 29.5%。

細看車用晶片領域，其中以邏輯晶片占比最高，據 TrendForce 預估，車用邏輯處理器於 2024 年至 2029 年年複合成長率達 8.6%，高於產業平均的 7.4%，主因在於其作為核心運算與控制中樞，廣泛應用於 ADAS、座艙資訊處理與系統整合等，重要性將持續提升。除此之外，HPC、動力系統與先進駕駛則被視為未來車用半導體三大技術成長主軸，各大供應鏈業者正積極投入關鍵技術布局，透過強化軟硬體整合能力與策略合作，以搶占車用半導體的市場先機。整體而言，隨著汽車電子架構持續升級，車用晶片將成為推動汽車智慧化與電動化發展的核心關鍵。

2024-2029年車用半導體市場規模預估（單位:百萬美金）



資料來源：TrendForce（2025年12月）

從半導體產品結構來看，據世界半導體貿易統計組織預估，2025 年各項積體電路領域中，邏輯晶片與記憶體晶片為最主要的兩大產品，其中邏輯晶片最為熱門、增幅最大，全年營收達約 2,959 億美元，成長 37.1%；其次為記憶體晶片，營收估計達約 2,116 億美元，提升 27.8%。以下將針對邏輯晶片及記憶體晶片於 2025 年的亮點及趨勢進一步說明：

全球半導體產品營收及成長率

Autumn 2025	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Americas	195,123	251,926	338,574	45.2	29.1	34.4
Europe	51,250	54,127	60,429	-8.1	5.6	11.6
Japan	46,739	44,835	50,164	0.0	-4.1	11.9
Asia Pacific	337,437	421,354	526,293	16.4	24.9	24.9
Total World - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3
Discrete Semiconductors	31,026	30,900	33,436	-12.7	-0.4	8.2
Optoelectronics	41,095	42,597	45,020	-4.8	3.7	5.7
Sensors	18,923	20,894	22,713	-4.1	10.4	8.7
Integrated Circuits	539,505	677,852	874,291	25.9	25.6	29.0
Analog	79,588	85,552	91,988	-2.0	7.5	7.5
Micro	78,633	84,839	96,620	3.0	7.9	13.9
Logic	215,768	295,892	390,863	20.8	37.1	32.1
Memory	165,516	211,568	294,821	79.3	27.8	39.4
Total Products - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3

資料來源：世界半導體貿易統計組織（2025 年 12 月）

a. 邏輯晶片

隨著半導體製程技術持續演進，邏輯晶片因具備高運算能力、可程式化與高度整合的特性，已成為各類電子系統中最核心的元件之一，主要涵蓋中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、微控制器（MCU）、系統單晶片（SoC）及各類控制晶片等。根據 Stratistics MRC 預估，全球邏輯 IC 市場規模將由 2025 年的 5,388.7 億美元成長至 2032 年的 8,335.6 億美元，期間年複合成長率約為 6.43%，顯示其穩定且持續性的成長動能。

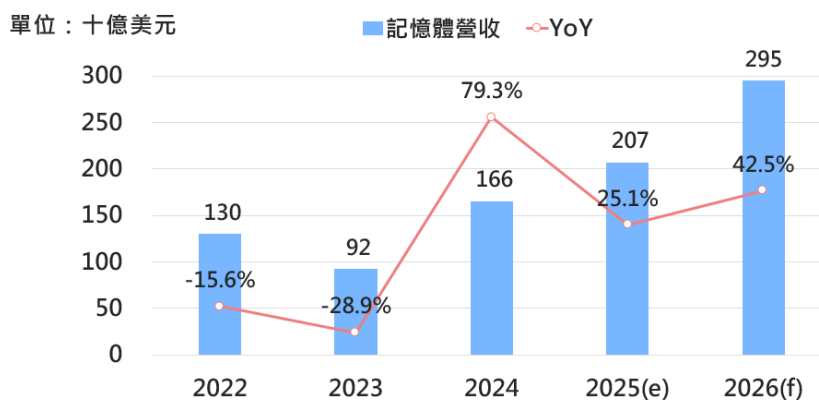
從需求面來看，消費性電子的普及是帶動邏輯晶片成長的主要動力，包含智慧型手機、筆記型電腦、智慧電視與穿戴式裝置等，皆高度依賴其進行資料處理與系統整合以節省空間並縮小尺寸。同時，在物聯網、工業自動化、電動車等新興應用快速發展下，也進一步推升了對高效能與小型化晶片的需求。隨著產品功能日益複雜、整合程度持續提升，邏輯晶片必須在有限的空間與功耗條件下承載更多運算與控制任務，這不僅提高了各元件間的設計難度，也進一步凸顯其在先進電子系統中的關鍵地位。

b. 記憶體晶片

記憶體市場在 2023 下半年開始的 AI 熱潮帶動下，原先主流的 DRAM 技術已難以滿足大型 AI 模型對記憶體的需求，為了突破此瓶頸，SK 海力士、三星與美光等記憶體大廠選擇強化 HBM（高頻寬記憶體）產能布局，然由於各大業者持續聚焦於收益性較高的 HBM，並在 2025 年逐步停產 DDR4，導致 AI 伺服器中放置在交換器內的通用型 DRAM 出現供不應求的情況，也連帶提升 DRAM 整體價格。此外，NAND Flash 也因 AI 相關固態硬碟的需求增加，價格隨之成長。根據 DIGITIMES 預估，2025 年在 HBM 需求持續上升、DRAM 與 NAND Flash 價格不斷攀升的情況下，全球記憶體營收將達約 2,070 億美元，年增率逾 25%，此趨勢也使 2026 年的記憶體營收上看到 3,000 億美元。

細看 DRAM 與 NAND Flash 領域，隨著 AI 快速滲透各類運算應用，記憶體產業正由過去以消費性電子為主，轉為支撐 AI 基礎建設的關鍵角色。而低延遲、大容量的 DRAM 與具備高速、高 IOPS 特性的 NAND Flash，即成為支援 AI 伺服器、高效能運算與企業級存儲不可或缺的核心元件，重要性持續提升。在需求升溫與產能受限的帶動下。TrendForce 預估，2025 年 DRAM 市場營收將達 1,657 億美元、年增率高達 73%；同時，生成式 AI 朝向長期推理能力的 AI Agent 發展，也進而帶動 NAND Flash 市場規模於 2025 年達 697 億美元，並有望在 2026 年迎來倍數成長。整體而言，短期內記憶體市場價格動能可望延續，定價權仍偏向供應商端。

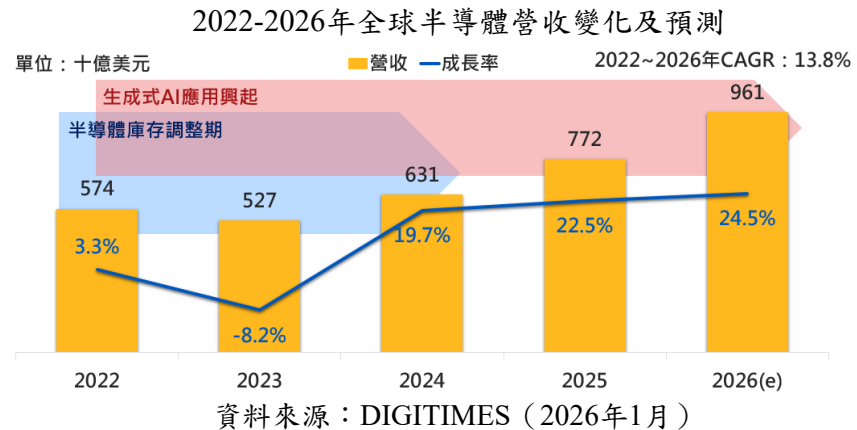
2022-2026年全球記憶體營收變化預估



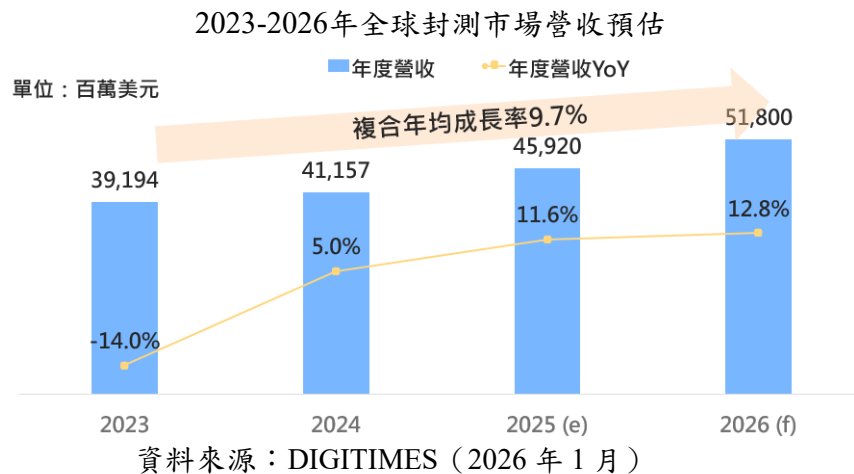
資料來源：DIGITIMES（2025年12月）

展望2026年，AI應用與記憶體將持續帶動半導體產業強勁成長。隨著全球雲端服務供應商擴大對AI基礎建設的資本支出，預期將推升AI加速器、ASIC及各類高效能記憶體的市場需求，特別是在記憶體供需吃緊帶動的價量齊揚，將成為業者營收成長的核心關鍵。DIGITIMES預估，2026年全球半導體市場規模上看9,610億美元，年增幅逾兩成，呈現顯著增長態勢。然而，2026年半導體產業仍面臨潛在挑戰，首先，關鍵原物料與記憶體成本上升，可能削弱終端消費性電子產品的需求。再者，IC載板關鍵材料T-glass的供應短缺，恐導致部分終端產品出貨預期下調，進而波及上游半導體拉貨動能。另一方面，美國針對半導體啟動之232調查結果，亦將是影響全球供應鏈及記憶體市場佈局的重要不確定因素。

面對機遇與挑戰並存的2026年，各半導體供應鏈需從波動中保持成長韌性，以適應多變的產業環境。



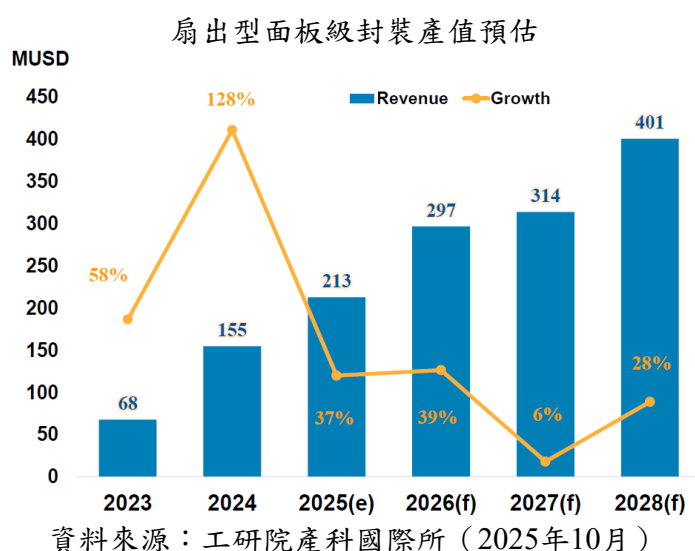
從產業鏈的角度來看，2026年全球半導體呈現上、中、下游深度連動的增長趨勢。據DIGITIMES統計及預估，IC設計方面，主要受惠於AI伺服器晶片、AI加速器及雲端業者自研AI ASIC需求推升，2025年全球營收達3,695億美。展望2026年，整體IC設計市場可望再成長逾20%、挑戰4,500億美元；晶圓代工則主要受惠於AI應用普及帶動，驅動5奈米以下先進製程維持高稼動率，加上台積電、Samsung等領導廠商在3、2奈米製程與CoWoS／類CoWoS產能的擴張下，2025年產值預估達1,994億美元，年增超過25%，2026年可望續增逾15%；封測產業方面，隨著AI訂單外溢至專業封測廠，加上CPO等技術商轉與先進封裝投資增加，預期2026年將成長12.8%，營收上看518億美元，更加速朝高毛利的先進技術轉型，不僅滿足伺服器晶片效能要求，更帶動產業整體的營收結構轉型。



聚焦於與本公司半導體業務高度相關的封測產業發展趨勢，以下將進一步說明2026年先進封裝與測試的關鍵技術方向與市場規模，包含，扇出型面板級封裝（FOPLP）、共同封裝光學（CPO）以及異質整合核心技術的小晶片（Chiplet）三大領域：

a. 扇出型面板級封裝 (FOPLP)

扇出型面板級封裝 (FOPLP) 被視為繼 CoWoS 之後備受關注的先進封裝技術之一，其核心優勢在於以方形面板取代傳統圓形晶圓進行封裝，可將面積利用率提升至約 95%，同時有效縮短電路傳輸路徑並降低整體成本。隨著高效能運算與大面積封裝需求持續攀升，工研院預估 2026 年 FOPLP 產值將達 2.97 億美元，年成長率約 39%，並可望持續擴大至 2028 年的 4 億美元，顯示技術正逐步由研發導入實際應用並邁入量產階段。就目前市場定位而言，FOPLP 與 CoWoS 暫時形成技術互補，CoWoS 主要聚焦高階 AI 晶片，而 FOPLP 則以射頻晶片、電源管理 IC 及中階 AI 與物聯網應用為主要市場，若要進一步切入高階 AI 晶片領域，仍有待技術成熟度提升與客戶驗證。



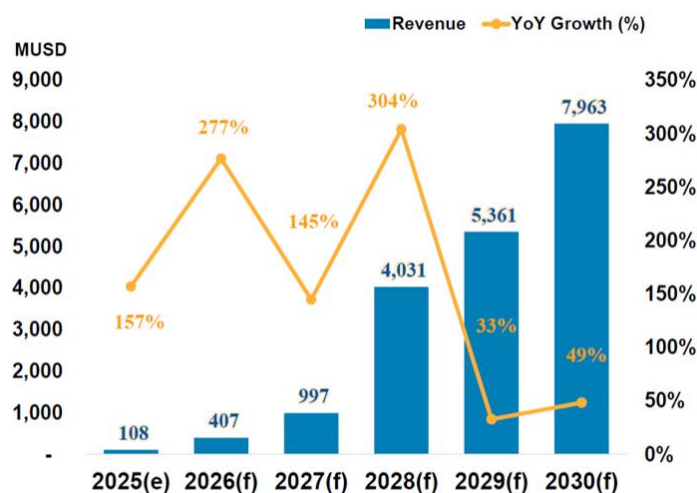
在供應鏈布局方面，全球各大廠紛紛投入 FOPLP 市場，包含日本 Rapidus、韓國 Samsung 及美國 SpaceX 皆相繼卡位。在台灣的部分，由力成率先布局，建立全球首座量產基地並確立 510mm x 515mm 面板規格，技術發展鎖定 AI 晶片、光學引擎與 CPO 等應用，預計於 2027 年導入量產，並規劃未來三年投資約新台幣 443 億元擴充產能；日月光則將 FOPLP 納入 VIPack 平台，聚焦 HPC 與通訊晶片市場，提供具量產彈性的封裝方案；而面板大廠群創方面，其近年轉型有成，FOPLP Chip-First 產線已達滿載，並同步投入 RDL 與 TGV 等關鍵技術開發。整體而言，FOPLP 預計將於 2026 年至 2027 年間逐步放量，而獲利影響則在 2028 年後更為顯著，反映 FOPLP 已逐步成為全球先進封裝的重要發展主軸之一。

b. 共同封裝光學 (CPO)

隨著人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 需求激增，資料中心內部傳輸速率正由 800G 邁向 1.6T 甚至 6.4T，為解決傳統銅線在頻寬與功耗上的瓶頸，以矽光子為基礎的共同封裝光學 (CPO) 技術應運而生。透過縮短傳輸距離與優化封裝結構，有效達成低能耗、低損耗之目標，以應對雲端運算及巨量資料處理等需求。其中，整合電子積體電路 (EIC) 與光子積體電路 (PIC) 的光引擎模組為 CPO 核心製程環節，能有效達成伺服器內部與伺服器之間互連，為帶動整體產業成長的重要動能。根據工研院預估，光

引擎市場在 2026 年的成長率將高達 277%，顯著優於 2025 年的 157%，並預期至 2030 年市場規模可達約 79 億美元，顯示產業正由技術驗證階段快速邁向規模化應用。

光引擎市場規模預估



資料來源：工研院產科國際所（2025年10月）

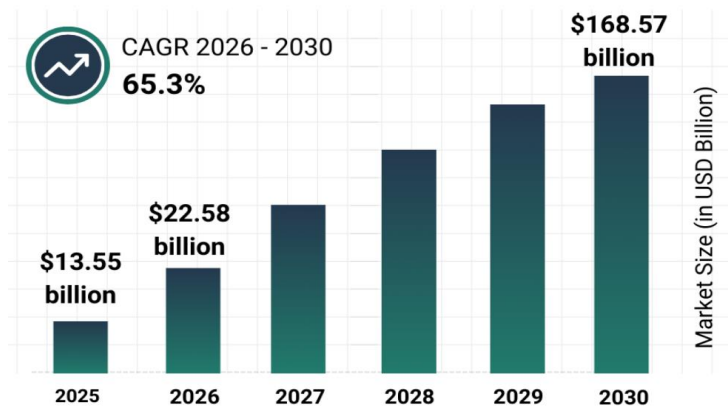
在關鍵技術方面，目前已逐步形成以 NVIDIA 與 Broadcom 為核心的兩大陣營，分別推動 Spectrum-X 與整合 CPO 技術的 Tomahawk 交換器，並高度仰賴台積電先進製程與 COUPÉ 封裝技術進行晶片整合，而台積電也計畫於 2026 年起陸續放量。除此之外，隨著日月光、Intel 等國際大廠亦相繼投入 CPO 光引擎（EIC-to-PIC）封裝的研發與測試，預計待技術成熟以及科技巨頭產品量產後，CPO 供應鏈將正式進入高速成長期。

c. 小晶片（Chiplet）

隨著半導體製程持續微縮、系統效能需求不斷提升，目前廣泛採用的單晶（monolithic）設計在面積擴展與成本控制上逐漸面臨瓶頸。在此背景下，小晶片（Chiplet）已成為近年半導體產業高度關注的技術之一。Chiplet 透過將原本整合於單一 SoC 的技術拆分為多個具備特定功能的模組化裸晶，並安裝於共用基板上整合成單一封裝，形成多晶粒系統架構。此方法不僅能顯著提升良率、降低研發成本，更允許設計者靈活混搭不同製程節點，有效突破摩爾定律的物理限制，成為推動高效能運算與異質整合發展的重要基礎。

在市場規模方面，由於 Chiplet 與 AI 半導體高度相輔相成，且仰賴先進封裝技術提升晶粒間的高速互連能力，各大廠商紛紛投入研發與量產布局，帶動市場快速升溫。根據 The Business Research Company 預估，Chiplet 市場規模將由 2025 年的 135.5 億美元成長至 2026 年的 225.8 億美元，加上受惠於高效能運算、模組化半導體設計、以及資料中心需求持續擴大，預計到 2030 年市場規模將達約 1,680 億美元，展現出強勢的市場擴張與成長潛力。

Chiplet市場規模預估



資料來源：工研院產科國際所（2025年10月）

B. 台灣半導體產業

回顧2025年，台灣半導體產業迎來顯著的爆發期，隨著AI應用由雲端延伸至終端，台灣在先進製程與先進封裝領域憑藉高階且穩定的技術實力，持續鞏固全球半導體供應鏈中的關鍵地位。尤其在3奈米製程持續滿載生產，以及2奈米製程逐步導入量產規劃的帶動下，晶圓製造動能顯著提升。同時，異質整合、2.5D／3D封裝與CPO等先進技術也進一步強化台灣在AI晶片效能與系統整合能力。儘管IC設計產業面臨短期市場波動，但受惠於AI手機與車用電子等新興應用需求，全年仍具穩健成長動能。據工研院預估，2025年台灣半導體產業產值將達新台幣6.4兆元，年成長率高達22%，展現強勁的市場動能。

進入2026年，工研院預估台灣半導體產值將突破新台幣7.1兆元大關，成長幅度為10%，產業動能將因2奈米正式貢獻營收成為主要驅動力量。除了製造端的技術領先外，政府也積極投入半導體產業發展，並已於2026年編列300億新台幣，致力於推動「AI新十大建設」政策，旨在創造AI新生活圈、創造更多就業機會的同時，持續提升台灣在國際間半導體技術的影響力，尤以矽光子、無人機與智慧機器人等領域為重點發展方向，盼能持續引領全球半導體產業邁入長期穩定的成長階段。

台灣半導體產業產值預估



資料來源：工研院產科國際所（2025年10月）

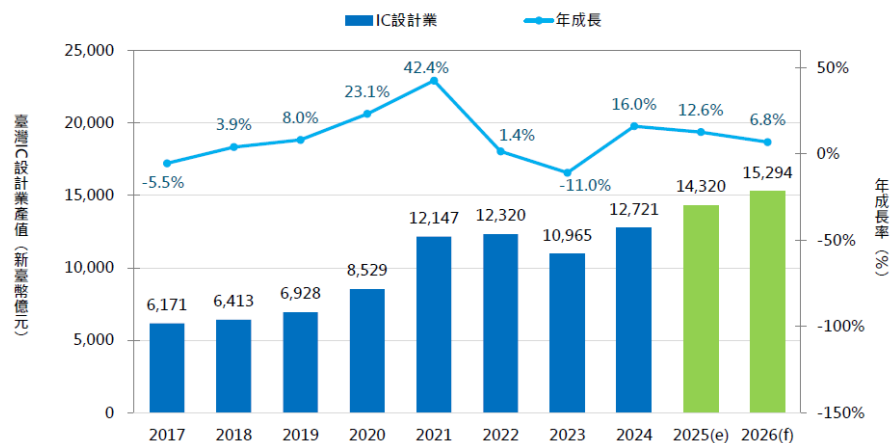
依據台灣半導體產業鏈，以下將針對IC設計業、IC製造業，以及IC封測業近一步說明2025年趨勢與未來展望：

a.IC 設計業

2025 年台灣 IC 設計產業整體呈現先強後穩的發展走勢，首季受惠於中國刺激政策及供應鏈提前備貨，需求顯著回升，然隨著急單效應減弱以及新台幣升值造成的匯損壓力，營收成長一度暫時放緩。進入下半年，由於邊緣 AI 與網通晶片需求升溫、旗艦手機晶片與 AI ASIC 訂單穩定，加上車用與 PC 晶片跨國合作效益顯現，使營運重拾成長動能。據工研院預估，台灣 IC 設計業全年產值突破 1.4 兆元新台幣，年增達 12.6%，創下歷史新高。放眼全球供應鏈，台灣在全球 IC 設計產業中仍居第二的地位，雖高皆 AI 晶片主要依然由美國主導，但台灣憑藉強大的研發實力與高度開發彈性，持續朝高附加價值產品轉型，並在手機晶片、網通以及 AI ASIC 等領域取得成長機會。

展望 2026 年，工研院預估，台灣 IC 設計產值預計將續創新高，突破 1.5 兆元新台幣，主要的成長動能仍來自於 AI PC 與 AI 手機的滲透率提升，以及車用電子與物聯網需求穩健向上。然而隨著 AI 基礎設施佈建趨於常態化，年成長率預估將放緩至 6.8%。另一方面，台灣 IC 設計業者於 2026 年也將面臨多項挑戰，包含中國的本土化政策，以及記憶體等零組件價格上漲對消費性電子獲利空間的擠壓，皆對營收造成壓力。為因應挑戰，領先大廠如聯發科預計將啟動 ASIC 專案量產，中小型業者則積極耕耘智慧眼鏡、無人機及 AIoT 等利基市場，整體策略重心將由中國轉向歐美市場開發，透過分散市場風險並強化高利基領域布局，驅動產業進入多元化的成長新局。

台灣IC設計業年產值成長趨勢



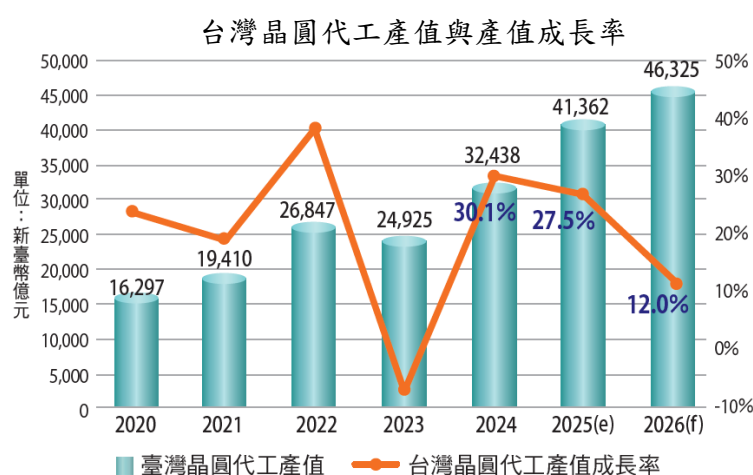
資料來源：工研院產科國際所（2025年10月）

b.IC 製造業

據工研院預估，2025 年台灣晶圓代工業全年產值逾 4.1 兆新台幣，年成長達 27.5%，展現強勁增長動能，其主要受惠於 AI 與 HPC 相關需求持續強勁，加上因應美國貿易政策之不確定性，供應鏈自第二季起展開預防性備貨，帶動整體營收大幅成長。此外，台積電年營收成長超過 30%，也成為推升台灣晶圓代工產值的主因。進一步看向製程技術，由於 AI 加速器、AI ASIC 與高階手機處理器持續推進至 5 奈米以下節點，使先進製程產能長期

維持滿載，成為晶圓代工的核心成長動能；成熟製程方面，主要增長來自於車用、工控及部分 AI 周邊應用，台廠多透過調整產品組合、協助客戶製程升級等多元解決方案來維持產能與營收表現。整體而言，2025 年台灣晶圓代工產業在先進與成熟製程雙軌並進下，維持高度成長趨勢，並持續鞏固於全球供應鏈中的關鍵地位。

展望 2026 年，AI 應用仍將是驅動晶圓代工產業成長的關鍵動力，市場主軸將從雲端運算延伸至生成式 AI 與實體 AI 的融合，應用範疇擴大至機器人、智慧型手機及 AI PC 等終端裝置，也進而帶動 3 奈米與 2 奈米製程。據工研院報告顯示，2026 年台灣晶圓代工業全年產值有望提升至超過 4.6 兆新台幣，成長率雖較 2025 年下滑至 12%，但仍呈現穩步攀升。技術發展方面，製程重心正式從奈米時代跨入埃米（Å）世代、背面供電、低溫製程與散熱技術應用等，而矽光子也將成為發展重心。綜觀而言，台灣晶圓代工產業憑藉深厚的技術與產業鏈優勢，在全球經濟不確定性與競爭加劇的環境下，仍展現高度韌性並穩健發展。



資料來源：工研院產科國際所（2025年10月）

在晶圓代工廠的經營表現上，產業結構呈現明顯的分化態勢，台積電憑藉在 6 奈米以下先進製程擁有全球 61% 市佔率，並透過產能擴張與報價調整維持高獲利。相較之下，二線代工廠因 AI 業務佔比有限，轉型成效尚未完全顯現，加上成熟製程面臨紅色供應鏈的價格競爭，仍處於轉型升級的陣痛期。為分散地緣政治風險，各台廠皆積極展開全球布局，如台積電熊本廠已進入放量階段，美國廠也持續布建中；聯電與世界先進規劃在新加坡陸續開出新產能；力積電則調整策略，除強化成熟製程布局外，也與美光合作推動先進記憶體與封裝相關發展。台灣晶圓代工產業在龍頭領軍與業者轉型並進下，逐步強化全球競爭力與長期發展基礎。

2025-2030年台積電先進製程產能布局概況

業者	投資地點	廠區	製程	規劃月產能 (千片/12吋)	量產時點
台積電	新竹	Fab 20 P1, P2	N2/A16	100~120	4Q25
		Fab 20 P3, P4	A14		2028年
	台灣 高雄	Fab 22 P1, P2, P3	N2/A16	120~150	4Q25~2027
		Fab 22 P4, P5	N2/A16		2028年起
		Fab 22 P6	A14	新案評估中	待定
	台中	Fab 25 P1~P4	A14/A10	100~120	2028年起
		Fab 21 P1	N4		4Q24
		Fab 21 P2	N3/N2		2027/2028年
	美國 亞利桑那州	Fab 21 P3	N2/A16	200~250	2029~2030年
		Fab 21 P4	N2/A16		待定
		Fab 21 P5、P6	A14/A10		待定
	日本 熊本	Fab 23 P2	N6	50	2027→2028年

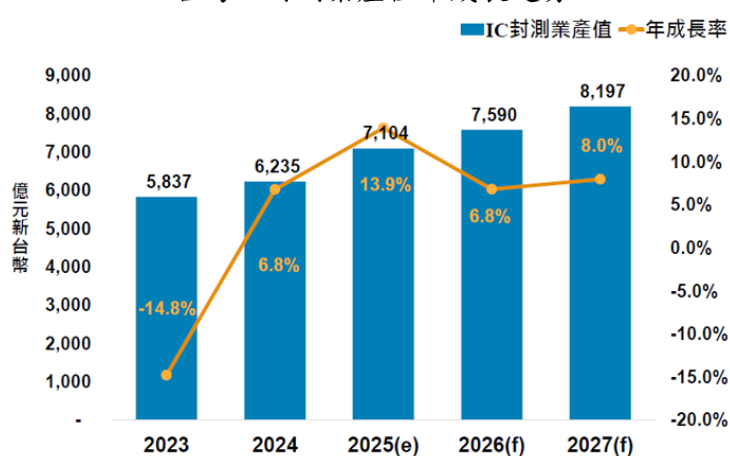
資料來源：DIGITIMES（2025年11月）

c.IC 封測業

2025 年，在 AI 與 HPC 應用快速擴展帶動下，CoWoS 等 2.5D 與 3D 封裝技術持續深化，包括 RDL、矽穿孔、凸塊等關鍵製程比重持續增加，為應對此一技術變革與市場需求的雙重驅動，台灣封測業者亦積極發展異質整合技術，以承接高階封裝訂單，進一步推升整體產業規模。工研院預估，台灣 IC 封測年產值將達 7.1 兆新台幣，以 13.9% 的成長率持續大幅增長，展現強勁動能。在 OSAT 廠營收方面，台灣以 33.42% 的市佔率位居全球領先地位，其中日月光憑藉約 16 億美元的先進封裝營收穩坐龍頭，然而，若將台積電約 130 億美元的先進封裝業務納入比較，其規模更躍居全球之首，顯示先進封裝已成為後摩爾時代，以提升系統效能為關鍵核心。

展望2026年，隨著AI晶片量產進一步加速及CoWoS等先進封裝需求持續升溫，部分訂單將逐步外溢至OSAT業者，帶動封測廠營收朝雙位數成長邁進。根據工研院預測，台灣IC封測產值將穩定成長至約新台幣7,590億元，年增率6.8%。然AI市場是否過熱，以及記憶體價格上漲可能壓抑消費性電子需求，仍對封測市場帶來潛在變數。不過整體而言，只要具備同時掌握AI晶片與記憶體兩大封測產線的企業，在這一波雲端到邊緣運算的擴張中，將有更佳的營收與獲利成長動能。

台灣IC封測業產值年成長趨勢



資料來源：工研院產科國際所（2025年10月）

在供應商布局方面，封測三雄日月光、京元電與力成皆持續擴大資本支出，形成與晶圓代工龍頭並行的成長格局。其中，日月光持續加碼先進封裝與系統級封裝產能，並受惠於 CoWoS 需求外溢效應，預期 2026 年先進封裝營收可望年增逾六成、突破 26 億美元；京元電則積極擴充三至五成產能，特別是在高功率預燒老化測試（Burn-in）等關鍵領域鞏固地位，以承接更多由晶圓大廠轉向外包的先進測試訂單。力成方面，採取穩健的中長期布局策略，深耕高階測試與利基型產品，尤以擴充 FOPLP 產能作為未來兩年投資重點。綜合來看，隨著先進製程與異質整合快速推進，封裝與測試的重要性持續提升，台灣封測業者透過擴產與技術升級，逐步鞏固其在全球供應鏈中的關鍵地位。

設備產業之發展

1. 未來整體趨勢

(1) 高科技產業需求有增無減

自動光學檢測是一個能自動提供控制信號的影像分析器，經由影像偵測器，從目的物擷取原始影像，再將取得的影像資料藉由電腦內所設計的演算法則軟體計算處理與特性分析，最後再將取得的運算結果，以數位或類比方式輸出，提供生產者做品質的決策判斷。因此隨著高科技快速發展及奈米科技的創新，產業對精密量測與檢測設備的需求不斷提升，業界將持續研發更高精度、智能化的自動光學檢測技術，以提高檢測效率與準確度，在半導體、顯示器、電子組裝等領域的需求有增無減。

(2) 設備國產化

自動光學檢測設備主要應用在平面顯示器、印刷電路板、半導體、先進封裝等領域，而台灣正是這些產業的生產重鎮，過去這些設備主要是掌握在國外少數大廠手中，價格昂貴，且維修不易。但隨著國內設備業者越來越多的投入，加上政府量測中心積極投入AOI技術的研發，成立「自動光學檢測設備聯盟」，將可加速推動上、中、下游之分工與整合。除此之外，隨著各國貿易壁壘加速成形，設備本土化及技術國有化需求殷切，為了降低採購成本、維修成本等等因素，使政府推動設備倍增計畫，扶植本土機械轉型，使設備自給率及零組件自給率日益提昇，進一步強化產業國際競爭力。

(3) 設備功能多樣化

隨著光學檢測技術蓬勃發展，以及半導體製程與電動車等科技的不斷創新，單一功能的設備將逐漸不符合市場需要，自動光學設備未來除了檢驗瑕疵之外，將朝設備多功能演變，如需要同時進行尺寸量測、瑕疵自動分類或是修補瑕疵、Mura檢測、Mura修補等多功能之設備機台，加上晶片與封測產業對精密量測的高標準下，設備必須提供更全面的解決方案，以應對全製程站點，以及製造業日益多元且複雜的需求。

(4) 客製化開發

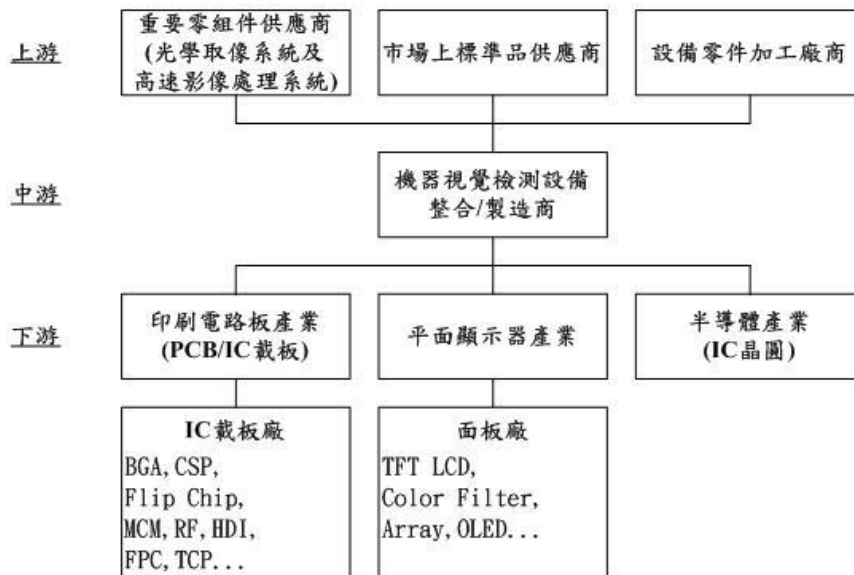
由於現在自動光學檢測設備都是在製程中檢驗，須與其他生產設備相容，而設備採購商各自的發展經驗不同，發展出自有的快速提升製程良率的技術，對於檢測設備的應用方式亦逐漸差異。有關檢驗的重點及範圍，由設備採購商提供需求資訊，供設備製造者研發，協助採購者做生產製程技術的改善，利用雙方資源，達成互補的效果。

(5) AI驅動檢測智能化

隨著AI技術進步，自動光學檢測（AOI）正從傳統的高速自動化發展為更智能的檢測系統。相較於需人工定義瑕疵特徵的傳統AOI，AI深度學習技術大

幅提升缺陷辨識的準確性，並能進行缺陷分析與追蹤，同時優化傳統演算法，解決通用性低及對操作人員依賴度高等問題。此外，生成式AI透過模擬各類瑕疵加速模型訓練與應用，未來將進一步提升檢測的可靠性，推動檢測設備技術邁向更高層次的智能化發展。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢

(1) 從檢查標的物來看

A. 檢查面：針對印刷電路板及半導體微小細線化的發展，將從微米(Micrometer)檢測晉升至奈米(Nanometer)檢測；封裝製程演變造成檢測需求趨向 3D 立體或機械手臂多元應用。而另一方面，針對 TFT-LCD 的檢測，則要兼顧微觀及巨觀(micro 及 macro)的檢查，須檢測缺陷之精度亦不斷提升。

B. 輸送面：印刷電路板因應電子產品的日趨輕薄短小，以及軟性電路板的易於翹曲，在傳輸承載上，需擁有穩定精準之傳送功能，及創新高度張力控制傳動機構；TFT-LCD 玻璃基板尺寸朝向大型化發展，則著重大型化玻璃基板移載功能的開發；半導體晶圓則以其高精密度，針對出料/入料機構、移載手臂與載台平整度等皆需求高規格。

(2) 從產業別的涉入來看：已從電路板產業(PCB)，跨足光電產業(TFT-LCD/ OLED/ 觸控面板產業)，近年更進入半導體產業(IC 晶圓及封測)及其他如自動光學導引製造設備等具開創性高科技產業之自動光學檢測設備領域。

4. 競爭情形

本公司是國內極少數全力投入此一專業自動光學檢測設備整合/製造領域的公司，隨AOI市場重要性日漸增加，目前產業競爭者來自世界各地，包括日本的Inspec、Shirai、Takano、Kubotek，韓國的ATI、Ajuhitek，臺灣的牧德、聯策，以及國際大廠KLA、Orbotech、Onto、Camtek...等，加上近年中國大陸亦開始大力投入此檢測領域，主要廠商包含南京協辰、宜美智、凌雲、武漢精策...等皆實力不可小覷。

面對如此強勁的競爭對手，本公司除了不斷強化產品的研發及推陳出新外，也善用地利之便(台灣為全球IC載板、半導體封裝、TFT-LCD、觸控面板生產重鎮之一)，提供國內及亞太地區客戶勝出的品質、合理的價格及迅捷的服務，包括領先的檢出能力、新功能的開發、技術支援及維修保固等，充分提升本公司的整體

競爭能力。

經過市場長期的測試與考驗後，產品品質穩定性目前已經獲得國內外市場的肯定，打破國際知名大廠獨占且壟斷市場的局面。並於2003年成功銷售至日本及新加坡，2005年開始銷售至韓國及中國大陸，2012年開始銷售至泰國及菲律賓，2020年銷售至德國等，在檢測設備的國際舞臺上獲得海內外客戶高度評價，並且持續積極布局，開發更多新市場與應用領域。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

本公司114年度及截至115年3月31日止之研發費用分別為266,678仟元及55,440仟元。

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研發成果
114 年度	半導體螢光光阻殘留檢測設備
	半導體 RDL 細線路檢測設備
	半導體 IR Saw 檢測設備
	半導體 Particle 檢測設備
	半導體3D 量測設備
	半導體各尺寸面板級封裝檢測設備
	半導體巨觀/微觀/側面檢測設備
	半導體應力檢測設備
	半導體 CPO 封裝檢測設備
	半導體複拍檢測設備
	載板2D+3D量測設備
	載板阻抗分析設備

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

(1)行銷策略方面

- A.加強完善的售後服務制度，鞏固國內現有客源。
- B.蒐集海外市場資訊，積極開拓國際市場。
- C.積極參展提高公司知名度。
- D.搭配不同溝通管道及媒體露出等，強化由田曝光度及口碑。
- E.經由行銷資訊分析、客戶名單管理、後續效益追蹤等，深化由田優勢形象。

(2)生產政策方面

- A.重新檢視生產作業流程，提高採購效率，充分掌握原物料動態。
- B.建立衛星加工體系，除可彈性調度加工生產，亦可減少直接人力，保有知識工作者的生產型態。
- C.推行全面品質管理政策，進行有效成本控管，創造產品利潤，提高競爭力。
- D.緊密維繫與外包商、合作夥伴與相關團體的關係維護，創造多贏局面。

(3)產品研發方向

- A.積極研發新產品，使產品多角化，以開發新市場。
- B.持續投入軟硬體研發人力，從產品機構設計、軟體開發到製造生產，均自行開發，以提高產品附加價值。
- C.加強與上、下游廠商合作，以積極研發高階產品。

D.持續延伸觸角至 SMT 檢測、車用產品檢測、IC 產品外觀檢測、COF 檢測設備、半導體後段封裝自動光學檢測設備、自動光學導引製造設備等。

(4)營運管理方面

A.導入全面電腦化作業系統，簡化工作流程，提高管理績效。

B.積極培訓研發、技術、業務及經營管理人才，厚植公司人力資源，強化公司競爭力。

C.公司已為上櫃公司，以吸引人才及資金，使公司之營運更為穩健。

D.強化「機器視覺」之廣泛研發與創意應用整合，培養相關視覺、光學、軟體、機械...等專業人才，並加強與產官學界之技術交流。

(5)財務管理方面

A.與往來金融機構建立密切關係，掌握金融市場脈動，提高財務運用績效。

B.根據中長期資金需求計劃，在安全穩健的原則下，進行短期財務規劃。

C.於資本市場上獲取公司成長所需之長期資金，擴展公司之營運規模。

D.積極配合政府相關計畫，獲得政府補助開發及租稅減免，並申辦政府低利研發貸款。

2.長期發展計畫

(1)行銷策略方面

A.以利基型產品導入市場，獲取較高利潤。

B.以多角化之產品進入印刷電路板(PCB 及 IC Substrates)、TFT-LCD/OLED/觸控面板及半導體(Semiconductor)等各大產業，分散獲利來源及投資風險。

C.積極與國外廠商建立合作關係，開拓海外市場。

(2)生產政策方面

A.有效整合原物料的供應，以期自原物料採購到上線生產乃至品質檢驗、交期配合及各項流程均能順利進行。

B.與外包廠商及原物料供應商策略聯盟，確保產能及原料取得之無虞。

C.深植外包廠商品質檢驗觀念，確保加工品質無虞，以利後續製程順利進行，配合交期準時出貨。

D.整合上下游供應鏈及廠商，達成有效又緊密的合作夥伴關係。

E.秉持生產程序標準化、產品品質標準化之目標，提高各段流程效能。

(3)產品研發方向

A.拓展機器視覺技術在半導體及太陽能相關產業檢測上的應用。

B.加強產品研發人力及資源投入，提升產品品質、拉大與競爭廠商之利基差異。

C.針對工業 4.0 及大數據盛行，提供有效檢測數據統整及追蹤。

D.持續聚焦高附加價值產品之開發，同時對現有產品進行優化以維持高市場競爭力。

(4)營運管理方面

A.定期人員培訓，提升工作效率及專業技能累積。

B.提供安全舒適之工作環境，使員工能安心發揮所長。

C.提供完善的福利及管理制度，秉持永續經營的理念，建立企業文化，凝聚公司團隊向心力。

D.掌握外部環境變化，靈活創新搭配需求，憑藉地緣關係，在台灣、中國、韓國、日本、及東南亞地區不斷深化合作關係。

E.提高客戶依存度，達成擴大市佔率及維持公司成長之目標。

F.持續開發代理商以深耕各區域事業發展。

(5)財務管理方面

- A.除以獲利創造營運資金外，並搭配金融機構之貸款，挹注未來發展所需資金。
B.加強公司全面性財務規劃，以降低營運風險，提升市場競爭優勢。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

銷售地區 \ 年度	114 年度	
	金額	%
內銷	771,413	46.05
外銷	903,931	53.95
合計	1,675,344	100.00

(1)印刷電路板產業(PCB/IC 載板)的自動光學檢測設備市場。

銷售對象主要為印刷電路板產業（PCB/IC載板）的載板、軟板、HDI、覆晶基板、COF等各大廠，客戶遍佈台灣、中國大陸、日本、泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡…等地區。

(2)平面顯示器產業的自動光學檢測設備市場

銷售對象主要為TFT-LCD產業之面板廠及觸控面板廠，最終客戶主要分布在台灣及中國大陸地區。

(3)半導體自動光學檢測設備市場

銷售對象主要為半導體委外封測(OSAT)廠商，客戶遍佈台灣、中國大陸及東南亞等地，並積極開拓其他海外市場。

2.市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

(1)市場占有率

本公司為研發、產銷自動光學檢測設備之專業廠商，在PCB/IC載板檢測設備類產品主要有IC載板自動光學檢測設備、覆晶載板自動光學檢測設備、PCB(HDI)自動光學檢測設備、軟板自動光學檢測設備等，在平面顯示器檢測設備類產品則有TFT-LCD點燈檢測設備及CF(彩色濾光片)、PI(配向膜)、Seal(框膠)、Array自動光學檢測設備、Mura自動檢修設備…等，於半導體檢測則專注晶圓級、面板級封裝之相關高階檢測設備。目前國內外未有針對明確分類之市場占有率調查報告，故本公司就往來客戶與其同業之機台採用情形，說明公司產品於國內之市場約略占有率及相關同業之競爭情形如下：

A.PCB/IC 檢測設備類產品

a.IC 載板出貨前成品自動光學檢測設備

IC載板出貨前成品自動光學檢測設備方面，兩岸主要廠商均向本公司採購，例如南亞電、景碩、欣興、日月光、臻鼎、深南…等採用該類檢測機台之情形，本公司產品占有極高市占率。而在國外市場方面，日本及韓國係IC載板主要生產國，惟客戶共同特性均偏向使用其國產化設備，故初期不易打入該市場，之後透過當地代理商搭配本公司累積之檢測能力，而有銷售至日本、韓國及新加坡大廠之成。

b.覆晶基板自動光學檢測設備

國內主要覆晶基板生產廠商如南亞電及景碩等所使用之該檢測設備，均全數為本公司所生產，故可推論本公司在國內占有極高之市占率。在國際市場上，已成功導入日本大廠及韓國SAMSUNG，但以日韓市場對來自海外檢測設備之保守採購態度而言，估計其市場占有率仍低。在同業方面，國內市場尚無競爭者，日本及韓國市場之競爭對手計有Santec、Inspec及

ATI。

c.PCB 自動光學檢測設備

PCB產品包含主機板、汽車板、音響板等，本公司主打高階細線路PCB檢測設備，目前兩岸主要板廠已陸續導入本公司檢測設備，競爭對手包含日本Shirai、牧德、聯策、南京協辰、宜美智...等。

d.軟板自動光學檢測設備

軟板因應產品材質特性，在機構及檢測上皆要求更高精準度，國內軟板大廠臻鼎、台郡等皆採用本公司所生產之機台，擁有極高之市場占有率，國內外競爭對手包含日本Shirai、牧德、聯策...等。

B.平面顯示器檢測設備類產品

a.TFT-LCD 點燈自動檢測設備

以面板廠中對檢測段之製程而言，LCD點燈自動檢測設備取代傳統人工目視檢查是一個創新的製程改善方式，國內市場中，已大量導入LCD製程包含Cell段及Module段等製程，而2008年開始本產品亦已導入中國大陸面板大廠。

b.彩色濾光片、配向膜、框膠自動光學檢測設備

本公司已成功導入群創、友達、中國大陸各大高世代面板廠包含京東方、天馬、惠科及華星光電等，現階段最大尺寸為10.5代。主要競爭者含日商Takano、Kubotek、韓商DIT，國內尚有晶彩及宏瀨為LCD自動化光學檢測設備競爭者。

c.觸控面板/保護玻璃檢測設備類產品

本公司觸控面板及保護玻璃自動檢測設備，已成功導入群創、宸鴻、勝華、昊信、雅士等兩岸大廠。目前市場主要競爭廠商包含Orbotech、日商SHIBAURA，國內尚有德律、晶彩、宏瀨、均豪等檢測設備競爭者。

C.半導體檢測設備類產品

a.晶圓級封裝檢測設備

本公司針對高階晶圓級封裝、Fan-Out扇出型封裝、CoWoS、Bumping等開發一系列自動檢測設備，成功導入台灣一線封裝大廠體系，並挾帶產品優勢快速複製成功經驗，於兩岸及東南亞進行銷貨。市場主要競爭者包含Onto、Camtek、牧德等。

b.面板級封裝檢測設備

本公司聚焦於高階面板級封裝、Fan-Out PLP等開發一系列自動檢測設備，成功導入台灣一線封裝大廠體系，並憑藉產品優勢積極拓展兩岸、東南亞及東北亞市場版圖，強化區域布局與交付能力。市場主要競爭者包含國際大廠Onto、Camtek等。

(2)市場未來之供需狀況與成長性

台灣印刷電路板廠商及平面顯示器廠商在面對南韓、大陸廠商之價格競爭，應對策略不外乎朝生產尖端科技產品及降低單位生產成本以維持產品毛利的方向發展，其中降低生產設備成本及減少直接人工成本即是大宗。

本公司為一本土化之公司，隨未來市場需求逐步成長，以技術服務優勢提供具價格競爭力的客製化創新研發產品，大量取代直接人工，降低廠商生產成本，正可迎合未來相關產業發展的市場需求。

本公司在PCB檢測領域之主要產品，係針對PCB、軟板及各式IC載板及覆晶基板，包含BGA(Plastic BGA、Cavity Down BGA、Tape BGA、Tiny BGA、Flip Chip PBGA)、Flexible Print Circuit、Flip Chip、CSP、MCM、RF Module、

FPC、TCP、TCSP、COF...等均可檢測。且市場亦由台灣跨入日本、韓國、馬來西亞、泰國，並已銷售至PCB產能最大的中國大陸市場。

隨著景氣循環，國內外高世代大尺寸面板產業擴產及升級優化商機仍在，本公司TFT-LCD製程的PI、Seal、Burr Check以及Color Filter各世代檢測機台和各尺寸API自動點燈檢查機，已提供現有客戶最佳解決方案，Mura自動檢修設備更輕鬆協助達成高產能、高良率的目標。另外近年快速崛起的OLED面板、Mini LED顯示，本公司亦有一系列對應解決方案可協助有效進行品質把關。在既有市場的占有率及品質的優勢下，除了持續開拓台灣市場外，亦積極將觸角延伸至中國大陸面板廠，目前深耕加強在地化周全的客服系統，設備之品質與服務之專業已獲得客戶高度肯定。

台灣於封測產業具全球領先地位，本公司看準此市場推出半導體檢測設備，包含InFO RDL、CoWoS、FOPLP、TGV及Bumping等皆有對應檢測站點，以獨家光學技術與高端邏輯演算能力，打破歷年來外資廠商獨大半導體檢測市場之格局，率先打入一線封裝大廠，檢測能力已獲客戶認證，並於2025年大幅提升半導體設備之營收占比，可望隨高階封裝需求持續擴大，進一步推升整體營運成長動能。

3.競爭利基

本公司是國內極少數全力投入此一領域-「自動光學檢測設備整合／製造的公司，茲就本公司之競爭利基分析如下：

(1)技術

本公司在影像處理領域中Vision辨識的技術開發，已累積了二十年經驗。後經結合了機械、控制、光學及軟體模組而成為自動光學檢測設備研發整合／製造商，不僅提高了自製水準，更大幅提升了自行研發的能力。目前結合軟硬體技術所開發出之多項裝置也已取得了國內外的專利。

(2)人才

無論是技術職或管理職，本公司均積極提供員工專業的教育訓練，增進各職位所需之專業知識，以面對不斷進步變遷的大環境，達到理論與實際結合應用的目標。而這些專業的人才，正是公司不斷開創新產品的原動力，並和公司之發展一起與時俱進。

(3)產品

本公司累積豐富之自動光學檢測設備研發整合／製造技術，跨足多項科技產業，可隨時視其產業景氣變動，彈性調整產品行銷策略，可有效避免因單一產業景氣循環波動而影響營運的風險。

(4)價格

本公司經不斷地研發及引進新技術提高自製率，目前量產已達規模經濟，可有效降低生產成本，以合理的利潤反應價格。

(5)服務

本公司從產品之研發、設計、整合到銷售，除了有形的設備產品外，更積極培養專業的客服工程師提供客戶無形的技術服務，以Total Solution達成解決客戶問題的全方位服務，為公司在市場競爭力上再加一分。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.全球資訊及通訊市場蓬勃發展

近年來隨著網際網路興起，多媒體應用領域擴大，以及世界各國推動資訊化基礎建設並開發通信、高效能運算市場，帶動了全球個人電腦及行動電

話等資訊、通訊產品及其週邊產業蓬勃發展。IC、PCB、IC 基版、TFT-LCD 模組等均是電子產品中必要之相關元件，其中半導體其製程技術與良率表現更是直接影響終端產品效能與可靠度。為了節省龐大的目檢人員費用及維持精確之檢驗標準，全面化的自動光學檢測設備將是未來品質管理的趨勢。

B. 跨足多項國內重點發展之科技產業

本公司產品所跨足之產業涵蓋素有「電子產品之母」之稱的電路板產業、半導體產業及光電產業中現正炙手可熱的平面顯示器產業，未來將持續進行相關產品之研發。

C. 擁有多次研發創新技術經驗之優秀研發團隊

為因應不斷創新及開發新產品的需求，本公司致力招募並培育研發人才，積極參與政府鼓勵中小企業開發新技術推動計畫，計有「基板檢測及出貨管理機開發計畫」、「全自動捲帶式軟性電路基板外觀檢測機台開發計畫」及「FCBGA 外觀檢測機台開發計畫」等。目前各計畫均已開發完成，導入量產階段。PCB 產業中之「Flip Chip Substrate 雙面高速檢測設備」及 LCD 產業之「TFT LCD Array 瑕疵檢測設備」與「LCD Seal 製程多功能檢測設備」與「Flip Chip 高速雙面自動外觀檢測設備」亦獲得經濟部工業局主導性計畫的認可，奠定本公司另一利基型事業。

本公司主要經營階層及研發人員均長期投入自動光學檢測設備的領域，對於此產業環境及趨勢有深刻之瞭解，且具有依客戶需求自行研發製造多元化產品的能力，可充分滿足客戶市場之需求。

D. 符合國家發展新興重要策略性產業

本公司之崛起，不僅滿足國內廠商在機器視覺檢測功能上及降低成本上的需求，並改變國內生產廠商長期仰賴國外壟斷報價的進口設備及動輒耗時等待數月的技術服務。自動光學檢測設備的本土化也使得想建立國內自給自足設備供應鏈的目標更向前邁進一步。本公司於民國九十年經經濟部審核通過為「自動化工程服務機構」，正式成為國家發展新興重要策略性產業的一員。

E. 快速即時的服務效率

由於本公司身處電子及通訊產業元件大量生產的亞洲，而台灣、日本和韓國更是主要目標客戶群的所在地，所以本公司向來能以最快速及時的服務效率提供客戶最佳的解決方案，此地利之便乃競爭對手迄今望塵莫及的一大優勢。

(2) 不利因素與因應對策

A. 重要原材料需自國外進口

自動光學檢測設備之關鍵零組件均需自國外進口，如光源照明裝置、取像影像處理器(影像擷取卡)及 CCD/CMOS 攝影機(類比/數位)等均是直接向國外廠商採購，無論新購或維修，交期可能較長，且成本較高。

因應對策：

- a. 和供應商保持良好之關係，達到即時的訊息流通及穩定的貨源供應。
- b. 尋求相近功能及品質之替代品，以分散貨源遭壟斷或不足之風險。
- c. 搭配生產計劃下單採購，並維持彈性庫存量，以因應臨時需求時之使用。
- d. 加強與國內廠商的研發合作，提供需求資訊，以期能就地採購。

B. 需要投入大量研發資金以保持競爭力

本公司所處之產業和各相關產業均為高科技發展的產業，是技術高度密集的產業，面對的市場環境變遷迅速，所以需不斷的投入大量研發資金以保持競爭力。

因應對策：

a.積極參與國家發展計劃，申請開發新技術補助經費，達到國家與產業雙贏的目標。

b.從資本市場獲取長期資金投入研發，保持公司競爭力。

C.國內廠商投入者日益增加，恐造成價格競爭的壓力

由於近來 PCB/IC 載板及半導體產業景氣看好，國內設備業者紛紛看好而投入研發，導致投入者日益增加，未來可能有削價競爭的可能性。

因應對策：

a.持續投入研發新產品，以技術能力創造智慧財，以避免與同業的競爭。

b.與客戶保持良好關係，以期使能取得客戶現在和未來需求，以便掌握產業脈動與時間，領先同業推出新產品。

D.產業特性造成應收帳款收現時間較長，不利資金運作

設備業一般按交機及驗收完成收款，驗收時間將達一年以上，本公司目前之資本規模尚小，在營收成長的過程中，恐面臨大量的營運資金需求。

因應對策：

a.利用銀行的資金彌補資金的需求。

b.從資本市場獲取低成本的長期資金，以滿足公司的營收成長所需。

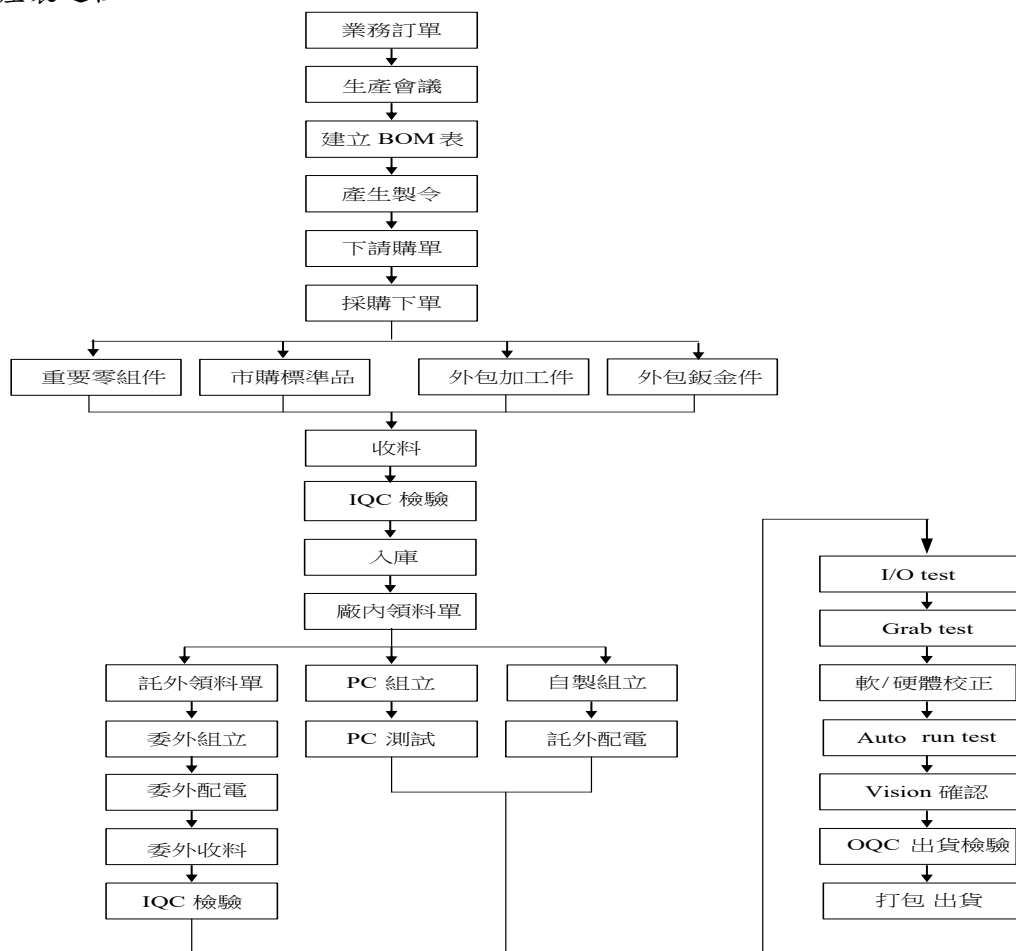
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品項目	主要功能
IC 載板出貨前成品(Strip Type)自動光學檢測設備	IC 載板(Strip Type)表面瑕疵檢查
Flip Chip 自動光學檢測設備	IC 載板(Flip Chip)表面瑕疵檢查
堆疊式/彈匣式兩用 SiP 自動光學檢測設備。	IC 載板(SiP)堆疊式/彈匣式外觀瑕疵檢查
IPQC 跨製程自主檢查模組	PCB 跨製程智慧檢查
PCB 製程中自動光學檢測設備	PCB 表面瑕疵檢查
PCB AFVI 自動最終檢測系統	PCB 最終出貨前表面瑕疵檢查
PCB 在線/離線線路檢查設備	PCB 製程中線路檢查
PCB 高速檢孔設備	PCB 雷射盲孔/通孔檢查
半自動 PCB 外觀檢查機	PCB 外觀瑕疵檢測
類載板自動光學檢測設備	SLP 外觀瑕疵檢測
Mini LED 載板檢量測複合機	Mini LED 載板檢測量測
CWV 雷射銅面清潔機	雷射銅面瑕疵清潔
全板線寬線距量測機	2D 全板線寬線距量測
全板線寬線距線高量測機	2D/3D 全板線寬線距線高量測
COF Tape 卷對卷自動外觀檢查機	COF Tape 外觀瑕疵檢測
COF Chip 卷對卷自動外觀檢查機	COF Chip 外觀瑕疵檢測
Roll to Roll 軟板線路檢查設備	捲對捲軟板線路檢查
Roll to Roll 軟板檢孔設備	捲對捲軟板盲孔/通孔檢查
半導體自動光學檢測設備	半導體外觀暨線路檢測/量測設備
晶圓級/面板級封裝檢測設備	半導體 IR 內層缺陷檢測設備
半導體後段封裝視覺檢查系統	IC Lead Frame 斷腳檢測系統
Array 自動光學檢測設備	LCD 顯示器 Array 段檢查
Color Filter 彩色濾光片自動光學檢測設備	LCD 顯示器 Color Filter 檢查
Color Filter 彩色濾光片自動複檢系統	LCD 顯示器 Color Filter 自動複檢系統
PI 配向膜自動光學檢測設備	LCD 顯示器 Cell 段 PI 檢查
Seal 框膠自動光學檢測設備	LCD 顯示器 Cell 段 Seal 檢查

主要產品項目	主要功能
偏光膜自動光學檢測系統	偏光膜自動缺陷檢測
Digital Macro Mura 自動光學檢測系統	Mura 瑕疵檢測
Mura 自動檢修設備	Mura 自動檢測及補償
Burr Check 毛邊檢測機	毛邊檢測
Bare Glass AOI 表面檢/端邊檢。	素玻璃表面/端邊瑕疵檢測
AKKON 自動光學檢測設備。	導電粒子檢測
OLED 面板自動光學檢測設備	OLED 面板瑕疵檢測
觸控面板檢測設備	Touch Panel ITO 玻璃線路區/玻璃區缺陷檢測
保護玻璃檢測設備	素玻璃、網印玻璃缺陷檢測
自動/半自動點燈檢測設備	API 自動/半自動點燈檢測
面板點燈檢測模組	模組段面板檢查模組
LCM 來料檢查機/最終成品檢測設備	來料及最終成品缺陷檢測
外觀光學六面檢測設備	最終成品外觀多面瑕疵檢查
OD/膜厚/色度量測設備	In-Line / Off line 色度膜厚量測
自動光學導引製造設備	傳統產業智慧製造
AI 自動拍照機	AI 影像深度學習及缺陷分類功能
AI 深度學習系統	缺陷分類判讀與問題溯源

2.產製過程



(三)主要原料之供應狀況

主要原料	供應情形
電腦系統設備	良好
線性滑軌及螺桿	良好
燈源攝影機	良好

(四)主要進銷貨客戶名單

- 1.最近二年度任一年度中曾占進貨百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例，及其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率%	與發行人之關係
1	B001	54,700	9.55	無	B001	65,161	10.31	無
	其他	517,778	90.45		其他	567,026	89.69	
		572,478	100.00			632,187	100.00	

變動說明：

本公司最近二年度僅一家進貨廠商金額達百分之十以上，進貨供應廠商較為分散，進貨來源尚稱穩定，不致過度集中。

- 2.最近二年度任一年度中曾占銷貨百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，及其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率%	與發行人之關係
1	A003	569,052	30.73	無	A003	325,697	19.44	無
2	A002	170,722	9.22	無	A028	265,642	15.86	無
3	A028	106,655	5.76	無	A002	34,185	2.04	無
	其他	1,005,544	54.29		其他	1,049,820	62.66	
		1,851,973	100.00			1,675,344	100.00	

變動說明：

本公司銷售自動光學檢測設備，均是以客戶之需求為主，故若當年度該客戶有無擴廠或汰換設備計劃，將影響銷售金額。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年度		113 年度	114 年度	截至 115 年 4 月 30 日止
員工 人數	經理人員	24	30	28
	間接員工	331	288	276
	直接員工	38	34	35
	合計	393	352	339
平均年歲		37.87	38.96	39.10
平均服務年資		7.65	8.28	8.24
學歷 分布 比率 %	博士	—	0.28	0.29
	碩士	27.23	28.69	28.91
	大學(專)	71.5	69.89	69.62
	高中職	1.27	1.14	1.18

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止未有因污染環境而遭受之損失。

五、勞資關係

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施、進修及訓練

- (1)本公司員工一律參加勞保、健保，退休金給付等一般福利，另公司提供之福利計有：發給年節各項獎金、提案獎金、員工酬勞分配、伙食費補助、實施員工教育訓練、團體保險(住院、醫療、癌症、職災)、年度健檢。
- (2)本公司依法成立職工福利委員會，遴選福利委員辦理職工福利，而每年皆訂定年度計畫及預算編列、舉辦尾牙活動、辦理年節贈禮、舉辦每季員工聚餐、員工年度旅遊活動、舉辦健康促進活動、生日禮金、生育及婚喪補助等活動，期使員工無後顧之憂地共同為公司發展而努力。
- (3)建立員工認股權制度，使員工成為公司股東，加強員工對公司的向心力，使勞資雙方共享盈虧。
- (4)教育訓練：本公司以機器視覺與機電整合技術為核心技術，秉持著「We serve with vision」的信念，全面提升員工專業技能、工作效率及產品品質為目標，制定年度教育訓練計劃，並依核心、管理、專業職能模組，在兼顧公司發展及同仁滿足的需求下，分別展開標準化、階層別與部門別之訓練課程，依照個人及職涯所需與公司發展及職涯需要，提供多元豐富的學習管道與發展資源。本公司 114 年度舉辦之內/外部教育訓練課程列舉如下：

性質	課程名稱
外部教育訓練	董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度
外部教育訓練	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班
外部教育訓練	勁爆學習視覺化簡報與稽核報告設計
外部教育訓練	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班
外部教育訓練	營運系統稽核之聚焦與跨循環及作業之整合
外部教育訓練	GitHub Copilot 全方位實戰：協作×進階×代理人
外部教育訓練	職業安全衛生管理員安全衛生教育訓練
外部教育訓練	資訊安全分析實務-方法、流程與工具
外部教育訓練	ISO27001資安制度宣導與資安新知課程訓練
內部教育訓練	NVIDIA CUDA TM圖形處理器高速平行運算
內部教育訓練	LIZO裝機訓練
內部教育訓練	ISO 9001 2015條文介紹

2.退休制度

本公司配合法令規定，自民國 94 年 7 月 1 日起按規定為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，依員工每月工資適用級距 6%之提繳率，提撥至勞保局退休金個人專戶，另依自願提繳率自員工每月薪資中代扣繳至勞保局退休金個人專戶。同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之員工及選擇新制退休金條例之員工的舊制保留年資，按勞動基準法提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶，保障員工之權益。

員工退休規則：

- (1)適用範圍以本公司不定期契約之正式員工為限。臨時契約、定期契約或特聘人員不適用。
- (2)員工合於下列情形之一者，得自請退休。(a)工作 15 年以上，年滿 55 歲者。(b)工作 25 年以上者。(c)工作 10 年以上，年滿 60 歲者。
- (3)員工有下列情形之一者，本公司得強制退休。(a)年滿 65 歲者。(b)心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整，但不得少於五十五歲。
- (4)員工工作年資以服務本公司為限，但受指派至本公司關係企業者，其年資應予併計。
- (5)公司應給付員工適用勞動基準法退休金規定之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

3.勞資間之協議與各項員工權益維護措施

本公司勞資雙方關係和諧，溝通管道暢通，並以相關法令為基礎，每個部門主管與部屬之間，透過管理會議、電子郵件、教育訓練、社團活動之意見交流，維持勞資雙方良好互動關係，無重大勞資糾紛事項。

本公司依勞基法及其他相關法規維護勞工合法權益，透過完善的內部網站，載明各項管理辦法，明訂員工權利義務及福利項目，提供員工申訴管道，並增加多元化教育訓練、強化員工健康，提升檢查品質及保障、提供優質上班環境及增進同仁良性關係。

- (二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止未有因勞資糾紛所遭受之重大損失。
- (三)本公司有目前有使用派遣勞工及/或勞務承攬(委外)合作情形，本公司針對將合作之派遣(勞務承攬)廠商，均先行瞭解其勞動法遵情形，以作為是否同意合作之評估，且本公司於履約期間，針對派遣(派駐)勞工之勞動條件是否合法，均主動進行調查、稽核或其他作為。

六、資通安全管理

- (一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1.資通安全風險管理架構

為提升資訊安全管理，本公司已成立資安專責單位，負責制定資安治理政策，監督資安管理運作情形，並每年至少一次向董事會報告資安治理情況。

2.資通安全政策

- (1)目的：為了強化資安管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之業務持續運作之資訊環境，並符合相關政府法規與內外部利害相關者之要求，使其避免遭受內、外部的蓄意或意外之任何威脅，達到資訊安全。

(2)目標：

- A.確保本公司資訊作業能正確、完整、可用的持續營運。
- B.確保本公司重要資訊之機密性，落實資料存取控制，資訊須經授權人員核可方能存取，不得逾越。
- C.符合法令與法規要求。

3.管理方案

- (1)新進同仁須參與資訊安全教育訓練以提昇資訊安全防護之認知觀念，公司定期執行資訊安全宣導作業。
- (2)建立安全、可靠的資訊系統環境，使本公司業務得以永續經營。
- (3)重要資訊系統或設備應建置適當之備援或監控機制並定期演練，維持其可用性。
- (4)裝設有防火牆及其他相關資訊安全設備及必要的安全防護措施，以防止網路非法入侵、破壞或資料竊取。
- (5)同仁之個人電腦應安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權軟體。
- (6)同仁個人持有之帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置。
- (7)設計適當之資訊安全事件的回應及通報程序，以能適當對資訊安全事件做立即反應，避免傷害擴大。
- (8)公司已每年定期進行資訊安全風險評估及資訊安全稽核作業，確保管理有效性並符合法令規範，故資安風險非屬公司重大營運風險，暫無投保資安險之需求。
- (9)為提升資訊安全管理的強度，公司已於 112 年取得 ISO 27001「資訊安全管理系統國際標準」驗證，將相關標準衍生出的資訊安全作業模式與準則化成日常資訊作業的遵守原則落實執行，使資訊安全防護臻於完善。

4.投入資通安全管理之資源

- (1)網路硬體設備更新新世代防火牆、提供入侵防護系統、病毒偵測與攔截、郵件

防毒、網頁過濾、上網行為分析、IoT 偵測服務、產業攻擊資料庫等。

(2)軟體系統更新企業端點安全解決方案、提供防毒，應用程式、周邊、上網行為控管、完整磁碟加密等。

(3)投入人力如：每日各系統狀態檢查、每週定期備份及備份媒體異地存放之執行、每年系統災難復原執行演練、每年對資訊循環之內部稽核。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止未有因重大資通安全事件所遭受之損失。

七、重要契約

列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款	彰化銀行	109.05.05~124.05.05	抵押借款	提供土地、房屋質押
長期借款	國泰世華銀行	109.09.02~124.09.02	抵押借款	提供土地、房屋質押
長期借款	兆豐銀行	111.07.06~126.07.06	抵押借款	提供土地、房屋質押

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	差異	
			金額	%
流動資產	2,460,492	2,236,436	(224,056)	(9.11)
不動產、廠房及設備	1,256,896	1,332,465	75,569	6.01
無形資產	1,803	2,033	230	12.76
其他資產	489,203	408,976	(80,227)	(16.40)
資產總額	4,208,394	3,979,910	(228,484)	(5.43)
流動負債	970,419	932,699	(37,720)	(3.89)
非流動負債	569,908	480,884	(89,024)	(15.62)
負債總額	1,540,327	1,413,583	(126,744)	(8.23)
股本	598,507	598,507	0	0.00
資本公積	375,669	255,967	(119,702)	(31.86)
保留盈餘	1,732,063	1,744,417	12,354	0.71
其他權益	(38,172)	(32,564)	5,608	(14.69)
權益總額	2,668,067	2,566,327	(101,740)	(3.81)
重大變動項目說明(前後期變動達20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)：				
1.資本公積：本期資本公積較去年減少，主係因資本公積配發現金股利所致。				

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	1,851,973	1,675,344	(176,629)	(9.54)
營業成本	850,643	774,277	(76,366)	(8.98)
營業毛利	1,001,330	901,067	(100,263)	(10.01)
營業費用	810,912	771,183	(39,729)	(4.90)
營業淨利	190,418	129,884	(60,534)	(31.79)
營業外收入及支出	131,473	37,268	(94,205)	(71.65)
繼續營業部門稅前淨利	321,891	167,152	(154,739)	(48.07)
所得稅費用	5,333	7,240	1,907	35.76
繼續營業部門稅後淨利	316,558	159,912	(156,646)	(49.48)
其他綜合損益稅後淨額	(2,061)	7,677	9,738	(472.49)
綜合損益總額	314,497	167,589	(146,908)	(46.71)
增減變動比例變動達20%，且增減變動金額達新台幣一千萬元者之分析說明：				
1.營業淨利、繼續營業部門稅前淨利及綜合損益總額：本期營業收入較上期減少，致本期營業淨利、繼續營業部門稅前淨利及綜合損益總額皆較上期減少。				
2.營業外收入及支出：本期因受匯率波動影響，由上期之兌換利本期轉為兌換損失，且本期權益法認列之投資由上期利益轉為損失，惟本期處分投資利益較上期增加，致整體其他利益及損失為正數但較上期減少。綜合上述，本期營業外收入及支出較上期減少。				

三、現金流量

(一)114 年度現金流量情形分析說明

單位：新台幣仟元

	113 年度	114 年度	變動金額	變動率%
營業活動	345,613	389,305	43,692	12.64
投資活動	(60,156)	41,920	102,076	169.69
籌資活動	(382,805)	(225,643)	157,162	41.06

- 1.營業活動淨現金流入增加：主係因本期應收帳款收款較上期增加，故本期營業活動之淨現金流入較上期增加。
- 2.投資活動淨現金流入增加：主係因處分採用權益法之投資-晶彩科增加，以致本期投資活動淨現金流入較上期增加。
- 3.籌資活動淨現金流出減少：主係因本期短期借款增加及股利發放總額較上期減少及短期借款增加以致本期籌資活動現金流出較上期減少。

(二)流動性不足之改善計劃

1.流動性分析

年度 項目	113 年度	114 年度	增(減)比例%
現金流量比率	35.61	41.74	6.13
現金流量允當比率	95.19	86.93	(8.26)
現金再投資比率	1.38	3.78	2.40

增減比例變動分析說明：

本期因應收帳款收款增加，故營業活動淨現金流入較上期增加，致本期現金流量比率較上期增加。因最近五年度營業活動淨現金流量總額較上期減少，致本期現金流量允當比率較上期減少。另，因114年度發放現金股利總額較113年度減少，故114年度現金再投資比率較上期增加。

2.流動性不足之改善計劃

本公司目前營業活動現金流量呈現淨流入狀態，且公司現金及約當現金尚屬足夠，故並無流動性不足之問題。惟本公司仍將持續追蹤期間較長之應收款項，並適時與客戶洽談較佳之收款條件，以降低現金流動性之風險。

3.未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	預估現金流出	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
705,682	(450,000)	(400,000)	(144,318)	—	銀行借款 200,000 仟元

流動性分析說明：

本公司預估114年淨現金流出850,000仟元，致現金不足數額144,318仟元。本公司擬向銀行舉借資金以改善現金不足之情事。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無此情事。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資政策

本公司對轉投資之管理訂有明確之政策，對關係企業及特定公司訂有「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」，另針對子公司之管理，除於本公司投資循環作

業有規範外，另訂有「子公司監督及管理辦法」以規範子公司之各項作業。子公司除定期需提供財務報表及分析報告，且不得有背書保證及資金貸與他人情事，使本公司得以充分掌握子公司之財務及業務運作。未來隨著子公司之營運規模日益擴增，本公司亦將不定期指派財務及稽核人員前往子公司實際作業情形及營運狀況，並抽核內控作業之執行情形，並向母公司報告以落實管理。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計劃

單位：新台幣仟元

被投資公司	說明	實際投資金額	政策	本期認列投資損益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
UTECHZONE GLOBAL CORP.		371,452	投資業務	(11,714)	該公司主係從事轉投資事業，費用部分僅有年費及銀行手續費等費用產生，所認列之投資損益主係因認列轉投資公司之損益。	無
科吉凱亞(股)公司		105,000	電子相關設備銷售	(784)	主係外幣兌換損益所致。	無
學文科技(股)公司		34,569	投資業務	—	該公司主係投資公司，尚無投資收入產生。	無
宙福投資(股)公司		5,000	投資業務	(18)	該公司主係投資公司，尚無投資收入產生。	無

(三)未來一年度投資計劃：無重大投資計劃。

六、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動對公司營收獲利之影響及公司因應利率變動之具體措施

本公司利息收入及利息支出佔營業收入之比率甚微，對公司損益尚無重大不利影響。本公司與往來銀行保有良好之授信往來關係，未來公司將密切注意利率之變動，並積極與往來銀行爭取最低之利率。另本公司未來除仍基於保守穩健原則，審慎運用閒置資金外，並將持續致力改善財務結構，以有效控制資金成本。

2.匯率變動對公司營收獲利之影響及公司因應利率變動之具體措施

本公司匯兌損益大部分來自外幣資產及外幣負債依資產負債表日之匯率重新評估後，所產生之未實現兌換利益或損失。本公司外匯政策以保守穩健為原則，重大外銷、外購均以外幣報價，除採外幣收支互抵之自然避險方式外，並將與金融機構保持密切關係，針對外幣淨資產部位，隨時參酌銀行分析報告，持續觀察匯率變化，以有效因應匯率變動對公司損益之影響。

3.通貨膨脹對公司營收獲利之影響及公司因應通貨膨脹之具體措施

本公司產品非一般民生消費性產品，因此通貨膨脹對本公司並無重大影響，且本公司隨時掌握上游商品的價格變化情形，以減少因成本變動而對公司損益的影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.高風險、高槓桿投資之執行情形及未來因應措施

本公司專注於本業之經營，不從事高風險、高槓桿之投資。

2.資金貸與他人之執行情形及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人之情事，未來若因業務需要而遇有需進行資金融通之必要，亦將依本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項資金貸與他人之資訊。

3.背書保證之執行情形及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無為他人背書保證之情事，未來若遇有需進行為他人背書保證之必要，亦將依本公司訂定之「背書保證作業程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項為他人背書保證之資訊。

4.衍生性商品交易之執行情形及未來因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無衍生性商品交易之情事，未來若遇有需進行衍生性商品交易之必要，亦將依本公司訂定之「衍生性商品交易處理程序」辦理，並依法令規定及時且正確的公告各項交易資訊。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司研究發展計畫請參閱本年報肆、營運概況。本年度將持續朝產品多元化之目標邁進，並積極開發各項新技術以擴展客戶群。本年度預計投入研發成本將維持於營業額之 5~15%。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司無受國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之情事；本公司管理階層將隨時注意國內外重要政策及法律變動之訊息，並適時提出因應措施。

(五)科技改變(包含資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司鼓勵員工從事與職務相關之創作發明，訂有「智權管理辦法」及「智財獎勵辦法」進行專利之管理及針對創作發明予以獎勵，未來仍將持續主動配合客戶同步開發，順應相關產業技術發展演變，充分掌握視覺檢測設備研發之趨勢與脈動，故科技改變及產業變化對本公司之財務業務尚無重大之影響。

本公司為維護競爭優勢與智慧財產，陸續強化資安基礎建設，將網路速度升速，提升人員作業效率，並不定期更新防火牆，以提供 NGFW 次世代防火牆、深度封包檢測 (DPI)、入侵預防系統(IPS)、SSL/SSH 檢測、網站過濾以及 QoS/頻寬管理、防毒、防間諜軟體，以強化對外網路的防護及管制。同時，亦嚴格落實資料存取控制，導入郵件歸檔管理系統及機敏檔案存取軌跡稽核系統，確保資訊安全管理系統之有效運行，維護重要資訊資產的機密性、完整性及可用性，經評估本公司應非屬重大營運風險。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司係專業自動光學檢測設備供應商，自成立來均專注本業經營，經營狀況及信譽良好，市場上無任何不利本公司企業形象之報導，目前無企業形象改變之疑慮。

(七)進行併購之預期效應、可能風險及因應措施

本公司無併購他公司之計畫，未來若有進行併購計畫時，將秉持審慎評估態度，考量合併是否能為公司帶來具體綜效，確實保障原有股東權益。

(八)擴充廠房之預期效應、可能風險及因應措施

本公司目前並無擴充廠房之計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨風險

本公司在重要關鍵零組件的採購上，均維持兩家以上之供應商為原則。雖本公司與各供應商間已建立長期且良好之合作關係，但仍會定時針對各供應商之供貨品質狀況、交期及準確性做評核，確保其供貨品質。

2.銷貨風險

本公司之營收來源為自動光學檢測設備產品之銷售，主要銷售領域包含了印刷

電路板產業及平面顯示器產業之各式自動光學檢測設備領域。就產業面而言，本公司以銷售多元化及跨產業之產品分散獲利來源及投資風險，降低受單一產業景氣循環因素之影響；就客戶面而言，積極研發客製化產品，開拓國內外相關產業客戶，分散營收來源，亦可降低受單一客戶景氣影響之風險。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：請至公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區查詢<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10>。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情事。

由田新技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115年03月12日

本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年03月12日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

由田新技股份有限公司



董事長：鄒嘉駿



簽章

總經理：張文杰



簽章

由田新設股份有限公司

114 股東常會議事錄

時 間：中華民國 114 年 6 月 25 日(星期三)上午 9 時。
地 點：新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)。
出 席：親自出席及委託出席股東股份總計 36,414,661 股(含以電子方式行使表決權股數 6,982,192 股)，佔本公司已發行股份總數 59,850,750 股之 60.84%。

出 席 董 事：鄒嘉駿、張文杰、林芳隆

出席獨立董事：呂英誠、丘邦翰、蔡熊光

列 席：許智超律師、安侯建業聯合會計師事務所 楊樹芝會計師

主 席：鄒嘉駿 董事長

記 錄：嚴晨心

壹、宣 佈 開 會：出席股數已達法定股數，主席宣佈開會

貳、主 席 致 詞：(略)。

參、報告事項

第一案：本公司113年度營業報告，請參閱附件一。全體出席股東洽悉。

第二案：審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告，請參閱附件二。全體出席股東洽悉。

第三案：本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告，全體出席股東洽悉。

第四案：本公司113年度盈餘分派情形報告，全體出席股東洽悉。

第五案：本公司資本公積發放現金情形報告，全體出席股東洽悉。

第六案：本公司現金增資私募普通股情形報告，全體出席股東洽悉。

肆、承認事項

第一案

(董事會提)

案 由：承認本公司113年度決算表冊案。

說 明：(一)本公司113年度個體財務報表暨合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師及洪士剛會計師查核完竣，連同營業報告書經本公司審計委員會委員查核完畢在案。

(二)本公司113年度營業報告書請參閱附件一，會計師查核報告及財務報表請參閱附件三，盈餘分派表請參閱附件四。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數36,414,661權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：35,225,879權 (含電子投票權數5,803,410權)	96.73%
反對權數：8,608權 (含電子投票權數8,608權)	0.02%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：1,180,174權 (含電子投票權數1,170,174權)	3.24%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

說 明：(一)配合證券交易法第14條第6項修訂以年度盈餘分派酬勞予基層員工，及配合董事會設置及行使職權應遵循事項要點修訂獨立董事連任及席次之規定予以修訂。

(二)修訂「公司章程」條文對照表請參閱附件五。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數36,414,661權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：35,242,006權 (含電子投票權數5,822,537權)	96.77%
反對權數：8,688權 (含電子投票權數8,688權)	0.02%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：1,163,967權 (含電子投票權數1,150,967權)	3.19%

本案照原案表決通過。

第二案

(董事會提)

案 由：本公司辦理現金增資私募普通股案，提請 決議。

說 明：(一)本公司為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證券交易法第43條之6等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，發行條件如下：

- 1.私募資金對象：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，惟目前並無已洽定之應募人。
- 2.私募股份種類：普通股。
- 3.私募股數：發行股數不超過12,000,000股。
- 4.得私募額度：視發行價格及實際發行股數而定。
- 5.每股面額：新台幣壹拾元整。

(二)私募價格訂定之依據及合理性。

- 1.以定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價日前30個營

業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上二基準計算價格較高者為參考價格。

2.本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，並擬請股東會以不低於參考價格之八成授權董事會訂定實際發行價格。

3.前述價格訂定方式係依據相關法令辦理，應屬合理。

(三)特定人選擇方式

本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限進行私募，特定人以策略性投資人為限。

(四)應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益

1.方式與目的

本次係選擇策略性投資人為應募人，應募人之選擇為可協助本公司擴展業務、投資新事業及完成策略聯盟等之對象，並可幫助本公司提升競爭優勢。

2.必要性

有鑑於自動光學檢測技術於各產品應用端上仍具高度成長性，為提升本公司之競爭優勢及擴大市場規模，擬引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。

3.預計效益

藉由策略性投資人之加入，應可加速本公司在特定產品銷售及掌握相關市場發展契機，並有助於公司營運穩定成長。

(五)辦理私募之必要理由及預計達成效益

1.不採用公開募集理由

考量募集資本之時效性、便利性及發行成本等因素，且限制三年內不得轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，故擬透過私募方式向特定人籌募款項。

2.得私募之額度

於不超過普通股12,000,000股(含)之額度內，於股東會決議通過之日起一年內分三次辦理。

3.辦理私募資金用途及預計達成效益

(1)私募資金用途

三次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金。

(2)預計達成效益

三次辦理私募之預計達成效益皆為充實營運資金將強化公司經營體質及競爭力，預計將改善財務結構、有助公司營運穩定成長，對股東權益並有正面助益。

(六)本次私募普通股案，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內預計分三次辦理。

(七)本次私募普通股之權利義務

原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再轉讓。

(八)本次私募普通股自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況若符合相關規定時，先向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上櫃標準之同意函後，據以向主管機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上櫃申請。

(九)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募資金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響需變更或修正時，擬請股東會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。

決 議：本議案投票表決時，出席股東總表決權數36,414,661權。

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：33,885,397權 (含電子投票權數4,465,928權)	93.05%
反對權數：1,362,164權 (含電子投票權數1,362,164權)	3.74%
無效權數：0權	0.00%
棄權/未投票權數：1,167,100權 (含電子投票權數1,154,100權)	3.20%

本案照原案表決通過。

陸、選舉事項：

案 由：增額補選獨立董事。

(董事會提)

說 明：(一)因應「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條第五項規定，董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應設置獨立董事人數不得少於四人，故本次股東會增額補選獨立董事一人。

(二)本公司董事之選舉，依公司法第192條之1及「公司章程」規定採候選人提名制度，新任獨立董事於114年股東常會補選後即就任，其任期自114年股東常會補選當選日至115年6月15日止。本公司獨立董事候選人名單業經114年5月12日董事會檢查通過，請參閱附件六。

選舉結果：增額補選獨立董事一席，當選名單及得票權數如下。

身份別	戶號及身分證統一編號	姓名	當選權數
獨立董事	E22047XXXX	端木玉	33,126,299

柒、臨時動議：無

捌、散會：民國一一四年六月二十五日上午九時二十五分

本次股東會無股東提問

由田新技股份有限公司
審計委員會查核報告書

董事會造具本公司114年度個體財務報告(含合併財務報告)，業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及洪士剛會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分派表等，經本審計委員會查核完竣認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定繕具報告，報請 鑒察。

此 致

本公司114年股東常會

由田新技股份有限公司

審計委員會召集人：呂英誠



中 華 民 國 1 1 5 年 3 月 1 2 日

由田新技股份有限公司



董事長：鄒嘉駿

